

公司代码：688396

公司简称：华润微

华润微电子有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人李虹、主管会计工作负责人彭庆及会计机构负责人（会计主管人员）吴从韵声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7373元（含税），预计派发现金红利总额为97,330,372.91元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.10%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2020年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

公司治理特殊安排情况：

本公司为红筹企业

本公司存在协议控制架构

本公司存在表决权差异安排

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	45
第六节	股份变动及股东情况.....	70
第七节	优先股相关情况.....	78
第八节	董事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	88
第十一节	财务报告.....	89
第十二节	备查文件目录.....	229

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、华润微电子、CRM、华润微	指	China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）。在用以描述公司资产、业务与财务情况时，根据文义需要，亦包括其各分子公司
董事会	指	华润微电子有限公司董事会
股东大会	指	华润微电子有限公司股东大会
《章程》	指	《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》
中国华润、实际控制人	指	中国华润有限公司，本公司的实际控制人
华润股份	指	华润股份有限公司
CRH、华润集团	指	China Resources (Holdings) Company Limited（华润（集团）有限公司）
CRH (Micro)、华润集团（微电子）、控股股东	指	CRH (Microelectronics) Limited（华润集团（微电子）有限公司），本公司的控股股东
无锡华微	指	无锡华润微电子有限公司
华润华晶	指	无锡华润华晶微电子有限公司
无锡华润上华	指	无锡华润上华科技有限公司
华润安盛	指	无锡华润安盛科技有限公司
华润微集成	指	华润微集成电路（无锡）有限公司
华润矽科	指	无锡华润矽科微电子有限公司
迪思微电子	指	无锡迪思微电子有限公司
华润芯功率	指	无锡华润芯功率半导体设计有限公司
华晶综服	指	无锡华晶综合服务有限公司
华润矽威	指	华润矽威科技（上海）有限公司
华微控股	指	华润微电子控股有限公司
华润半导体	指	华润半导体（深圳）有限公司
华润赛美科	指	华润赛美科微电子（深圳）有限公司
重庆华微	指	华润微电子（重庆）有限公司，原名为中航（重庆）微电子有限公司，于 2017 年无偿划转至华微控股
重庆润芯微	指	重庆润芯微电子有限公司
矽磐微电子	指	矽磐微电子（重庆）有限公司
杰群电子	指	杰群电子科技（东莞）有限公司
润科基金	指	润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国务院	指	中华人民共和国国务院
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
工业和信息化部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本报告期、报告期	指	2020 年度
传感器	指	一种检测装置，能感受到被测量的信息，并按一定规律变

		换为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录、控制等要求
光电耦合器	指	光电隔离器,是由发光二极管和光敏电阻组成的电路
光罩、光掩模	指	制造芯片时,将电路印制在硅晶圆上所使用的模具
分立器件	指	单一封装的半导体组件,具备电子特性功能,常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等
功放	指	功率放大器,在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器,包括 AB、D、数字功放。其中 AB 类功放通过晶体管放大电流从而放大信号,D 类功放用脉冲宽度对模拟音频幅度进行模拟,数字类功放用数字信号进行功率放大
功率 IC	指	为了操作功率元器件,通常须将一个电压施加于栅极。栅极驱动与达林顿驱动向功率器件施加电压并提供驱动电流
功率半导体	指	功率器件与功率 IC 的统称
双极工艺	指	双极工艺是一种基于硅基的典型制造工艺,主要用于双极型晶体管或集成电路的制备
屏蔽栅 MOS	指	在沟槽内栅多晶硅电极下面引入另一多晶硅电极,并使之与源电极电气相连,采用氧化层将上下二个多晶硅电极隔开,具有导通电阻低、栅电荷低、米勒电容低等特点
摩尔定律	指	半导体行业的经典定律,由戈登·摩尔于 1965 年提出:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔 18-24 个月便会增加一倍,性能也将提升一倍
数字芯片	指	基于数字逻辑设计和运行的,用于处理数字信号的集成电路,包括微元件,存储器和逻辑芯片
晶圆	指	半导体制作所用的圆形硅晶片。在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构,成为有特定电性功能的集成电路产品
晶闸管	指	一种开关元件,能在高电压、大电流条件下工作
模拟芯片	指	处理连续性模拟信号的集成电路芯片。电学上的模拟信号是指用电参数,如电流和电压,来模拟其他自然物理量而形成的连续性的电信号
氮化镓、GaN	指	一种第三代半导体材料,具有禁带宽度大、临界磁场高、电子迁移率与电子饱和迁移速率极高等性质
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功,必须进行流片,即从一个电路图到一块芯片,检验每一个工艺步骤是否可行,检验电路是否具备所需要的性能和功能
短路能力	指	功率器件发生短路后的承受与控制能力,是器件可靠性的一种重要参数
线性稳压 IC	指	线性稳压 IC 是一种重要的稳压 IC,其主要通过输出电压反馈,经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管的管压降压差来达到稳压的目的
超结 MOS	指	高压超结金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种新型功率器件,在平面垂直双扩散金属-氧化物半导体场效应晶体管的基础上,引入电荷平衡结构
金属势垒	指	金属势垒即肖特基势垒,是一种由势垒金属与轻掺杂半导体接触所形成的具有一定势垒高度的整流结构
铜片夹扣键合工艺、Copper Clip	指	指用铜块替代打线的工艺的一种新型的封装工艺,类似的有铝带/铜丝/金丝键合工艺
雪崩耐量、UIS	指	向半导体的接合部施加较大的反向衰减偏压时,电场衰减电流的流动会引起雪崩衰减。此时元件可吸收的能量称为

		雪崩耐量，表示施加电压时的抗击穿性
碳化硅、SiC	指	一种第三代宽禁带半导体材料，具有禁带宽度大、临界磁场高、电子饱和迁移率较高、热导率极高等性质
AC-DC	指	电源是输入为交流，输出为直流的电源模块。在模块内部包含整流滤波电路、降压电路和稳压电路
BCD	指	Bipolar-CMOS-DMOS 的简称，BCD 是一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极管 bipolar，CMOS 和 DMOS 器件，称为 BCD 工艺
BiCMOS	指	BiCMOS 技术是把双极型晶体管 (BJT) 和 CMOS 器件同时集成在同一块芯片上的新型的工艺技术，它集中了上述单、双极型器件的优点
BJT	指	Bipolar Junction Transistor，双极结型晶体管，是通过一定的工艺将两个 PN 结结合在一起的器件，有 PNP 和 NPN 两种组合结构
BMS	指	电池管理系统，能够提高电池的利用率，防止电池出现过度充电和过度放电
CDMOS	指	Complementary and Double-Diffusion MOS，互补型 MOS 和双扩散型 MOS 集成工艺是将 LDMOS 功率器件与传统的 CMOS 器件集成在同一块硅片上的工艺
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，互补式金属氧化物半导体，一种在同一电路设计上结合负信道及正信道的集成电路
DC-DC	指	在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的电源模块，其采用微电子技术，把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成
DMOS	指	双扩散金属氧化物半导体，主要有垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管 VDMOSFET 和横向双扩散金属氧化物半导体场效应管 LDMOSFET
EMI	指	Electromagnetic Interference，即电磁干扰。指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象
ESD	指	Electro-Static discharge，静电释放。静电防护是电子产品质量控制的一项重要内容
Fabless	指	无晶圆厂集成电路设计企业，只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成，也代指此种商业模式
FC 工艺	指	FLIP CHIP，倒装工艺，是一种新型封装工艺
FRD	指	快恢复二极管，是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管
HVIC	指	高压集成电路
IDM	指	IDM 模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试在内全部或主要业务环节的经营模式
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管，同时具备 MOSFET 和双极性晶体管的优点，如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点
IPM	指	智能功率模块，由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成
LDMOS	指	横向扩散金属氧化物半导体，在高压功率集成电路中常采用高压 LDMOS 满足耐高压、功率控制等要求
LED	指	Lighting Emitting Diode，发光二极管，是一种半导体固体发光器件

LV Trench MOS、Trench MOS、沟槽型 MOS	指	低压沟槽型 MOSFET，是低压 MOS 的一种，在体硅表面刻蚀沟槽形成栅电极，将传统平面 MOS 沟道由表面转移到体内
智能控制、MCU	指	微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机
MEMS	指	微机电系统。指集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统
MOSFET	指	金属氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
MTP	指	Multiple Times Programmable，是可编程逻辑器件的一类，多次可编程
OTP	指	One Time Programmable，是可编程逻辑器件的一类，一次性可编程
QFN	指	Quad Flat No-leadpackage，方形扁平无引脚封装
QFP	指	Quad Flat Package，方形扁平式封装
RF	指	Radio Frequency，表示可辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300kHz~300GHz 之间
SBD	指	Schottky Barrier Diode，肖特基势垒二极管，利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作
Sensor Hub	指	智能传感集线器，是一种基于低功耗 MCU 和轻量级 RTOS 操作系统之上的软硬件结合的解决方案
Sigma-Delta ADC	指	Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter，模拟数字转换器，是模数变换器的一种
SoC	指	System-on-a-Chip，又称为芯片级系统，是在单个芯片上集成 CPU、GPU 等整个电子系统的产品
SOP	指	System-on-a-Chip，又称为芯片级系统，是在单个芯片上集成 CPU、GPU 等整个电子系统的产品
SOT	指	小外形晶体管贴片封装，是 5 脚或以下器件的贴片封装形式
Trench-FS	指	沟槽型场截止结构，沟槽型将表面沟道变为纵向沟道，场截止指击穿时电场是穿通型的

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	华润微电子有限公司
公司的中文简称	华润微
公司的外文名称	China Resources Microelectronics Limited
公司的外文名称缩写	CRM
公司的法定代表人	李虹
公司注册地址	Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
公司注册地址的邮政编码	KY1-1111
公司办公地址	地址一：江苏省无锡市梁溪路14号 地址二：上海市静安区市北智汇园汶水路299弄12号
公司办公地址的邮政编码	214061、200072
公司网址	www.crmicro.com
电子信箱	crmhc_hq_ir_zy@crmicro.com

说明：公司注册地在开曼群岛，无法定代表人，公司负责人李虹。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	吴国屹	邓加兴
联系地址	江苏省无锡市梁溪路14号	江苏省无锡市梁溪路14号
电话	+86-510-85893998	+86-510-85893998
传真	+86-510-85872470	+86-510-85872470
电子信箱	crmhc_hq_ir_zy@crmicro.com	crmhc_hq_ir_zy@crmicro.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	华润微	688396	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心

		39 层
	签字会计师姓名	汪娟、王巍
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	魏先勇、王健
	持续督导的期间	2020 年 2 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	6,977,259,188.03	5,742,784,130.70	21.50	6,270,796,546.92
归属于上市公司股东 的净利润	963,661,634.37	400,755,536.42	140.46	429,441,345.91
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	853,147,747.43	206,311,510.92	313.52	322,189,448.00
经营活动产生的现 金流量净额	1,832,059,827.37	576,258,618.29	217.92	1,482,436,862.52
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东 的净资产	10,582,787,885.23	5,423,131,165.33	95.14	4,148,183,267.04
总资产	16,532,495,766.97	10,095,287,650.34	63.76	9,992,053,434.32

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.8362	0.4559	83.42	0.4886
稀释每股收益(元/股)	0.8362	0.4559	83.42	0.4886
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.7403	0.2347	215.42	0.3665
加权平均净资产收益率(%)	10.3388	8.0281	增加2.3107个百分点	10.6112
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	9.1531	4.1329	增加5.0202个百分点	7.9611
研发投入占营业收入的比例(%)	8.11	8.40	减少0.29个百分点	7.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、归属于上市公司股东净利润同比上升 140.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 313.52%，主要系因行业景气度较高，公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比上升 217.92%，主要系因市场景气度较高，客户回款较好。
- 3、归属于上市公司股东的净资产同比上升 95.14%，总资产同比上升 63.76%，主要系因报告期内公司于上海证券交易所科创板上市，募集资金 42.36 亿元。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,382,423,958.02	1,680,710,701.38	1,825,633,161.8	2,088,491,366.83
归属于上市公司股东的净利润	113,658,557.37	289,434,754.41	283,556,424.43	277,011,898.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,049,723.06	254,743,284.03	256,093,734.45	252,261,005.89
经营活动产生的现金流量净额	270,682,164.68	240,493,754.49	520,344,926.44	800,538,981.76

说明:公司第一季度受春节假期及疫情影响,销售收入占比较小,利润也较低。第四季度净利润比二、三季度略有下降,主要系年底计提奖金等各项费用较多所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	45,476.79		1,821,601.52	9,434,573.46
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	127,082,612.49		238,776,694.27	91,086,261.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,478,526.08			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				10,592,096.66
因不可抗力因素,如遭受自然灾害				

而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,266,217.65		287,715.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,112.00		20,798,606.88	23,876,454.13
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,964,312.51		28,191,395.91	4,971,539.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-19,688,887.47		-47,494,836.81	-9,065,714.60
所得税影响额	-28,636,483.11		-47,937,152.02	-23,643,312.51
合计	110,513,886.94		194,444,025.50	107,251,897.91

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	507,535,344.46	901,191,461.19	393,656,116.73	1,191,461.19
应收款项融资	484,906,398.42	525,446,921.08	40,540,522.66	
合计	992,441,742.88	1,426,638,382.27	434,196,639.39	1,191,461.19

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。

目前公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司产品与方案业务板块聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。公司制造与服务业务主要提供半导体开放式晶圆制造、封装测试等服务。此外，公司还提供掩模制造服务。

(二) 主要经营模式

公司产品与方案板块业务目前主要采用 IDM 经营模式，同时制造与服务板块业务向国内外半导体企业提供专业化服务。

IDM 模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试在内全部或主要业务环节的经营模式。公司产品及方案板块采用 IDM 经营模式，主要因为 IDM 模式在研发与生产的综合环节长期的积累会更为深厚，有利于技术的积淀和产品群的形成。另外，IDM 企业具有资源的内部整合优势，在 IDM 企业内部，从芯片设计到制造所需的时间较短，不需要进行硅验证，不存在工艺对接问题，从而加快了新产品面世的时间，同时也可以根据客户需求进行高效的特色工艺定制。功率半导体领域由于对设计与制造环节结合的要求更高，采取 IDM 模式更有利于设计和制造工艺的积累，推出新产品速度也会更快，从而在市场上可以获得更强的竞争力。该模式对企业技术、资金和市场份额要求较高。公司主要经营模式如下：

1、产品与方案业务板块

(1) 研发模式

针对产品与方案板块的开发，公司制定流程控制文件《新产品开发控制程序》。研发流程主要包括立项、设计、样品试制及评价、试生产和量产五个阶段，每个阶段均有专门的评审委员会进行评审。

①立项阶段：综合考量市场调研、客户需求、技术趋势等因素启动产品立项，立项评估报告包括市场可行性、技术可行性、工艺及生产可行性、财务可行性、项目计划及预算等方面。评估报告提交评审委员会评议通过后进入设计阶段。

②设计阶段：产品立项后，研发人员依据《设计开发技术评估报告》和《设计开发任务书》正式进入产品设计阶段，其中包括线路设计、版图设计、工艺设计及验证方案等步骤。在设计过程中，需要时可根据产品规模、设计难度等进行次数不定的设计审查。研发人员会围绕设计目标，进行芯片仿真、失效模式分析，确定产品的雏形，初步确定材料规格及工艺流程，进行单项工艺开发。产品设计方案经委员会评审通过后，将根据方案制作相应光刻版，准备工程批流片试验。

③样品试制及评价阶段：该阶段将依据产品性能与功能要求选择合适的设计验证流程。工程试验批在流通后对芯片进行中测评价与封装成品测试评价，若不达标则进行新一轮的工艺调整或版图调整，直至相关参数达标，同时进行可靠性评价、无有害物质评价、应用评价以及客户送样评价。样品通过上述全部评价后，进行扩批验证稳定性。在完成工艺流程固化、关键窗口拉偏完成、可靠性考核、客户认定通过等程序后，样品提交评审委员会评审，通过后进入试生产阶段。

④试生产阶段：研发人员继续优化改进产品，提升产品的良率，及时解决客户反馈，在达到一定产量后提交评审委员会评审，通过后进入量产阶段。

⑤量产阶段：运营中心按订单计划安排生产，工厂按照流程单、控制计划进行生产，在生产过程中各部门持续协同改进，通过技术革新与产品升级不断提升客户满意度。

(2) 采购和生产模式

产品与方案板块依托公司全产业链制造资源，主要采取 IDM 经营模式经营，同时根据实际需要，对少量阶段性产能或工艺不匹配的生产环节选择进行外协加工生产。

IDM 模式下，市场部门根据市场及客户需求制订销售计划，综合计划部根据销售计划制定生产计划，晶圆生产由公司制造中心完成，制造中心会根据内外部整体需求进行原材料采购计划。

晶圆生产完成后通过公司封测平台进行封装测试。如有需要外协加工的情况，公司在严格遴选委外供应商的基础上，严格管理和跟踪外协加工全过程，保证产品的质量和性能要求，同时高度重视核心技术的保密工作。

（3）销售模式

公司产品与方案板块采取直销与经销相结合的模式，公司制定了《营销业务管理规定》《经销商通用规则》《市场部订单管理规定》等制度，具体规定和流程如下：

①接受订单与计划：市场部门将客户订单录入系统，包括产品规格型号、订购数量、价格、交货日期等，市场部门与运营中心根据库存情况确认可达成的交期，确认后对客户进行回复。市场部门根据客户提供的计划，提交运营中心，由运营中心按照需求组织制造生产。

②发货：对于款到发货的客户，公司确认收到客户的付款单后进行发货；对于授信客户，在授信条件内发货。发货时产品直接由公司发送至客户指定地点。

③开具发票：发货后，系统根据发货单自动生成销售发票，市场部门审核后开发票发送客户。

④对账及收款：公司会每月与客户进行对账确认，对于授信客户，市场部门按照相应的授信账期在发货后跟踪货款结算情况，以保证按期收款。

公司产品的终端客户数量众多，部分销售需要通过经销商提供销售渠道以及日常的客户维护工作。公司选定的经销商具有丰富的销售网络及深厚的客户积累，是公司客户的重要组成部分。公司对经销商管理建立并执行全套的严格管理措施，经销商需提供终端客户资料，签订《经销商通用规则》《销售协议书》，再进行送样、报价、接单交易，公司会不定期对经销商进行实地拜访和核实。公司一般通过经销区域范围、客户资源、推广能力、技术支持、资金实力等方面综合考察经销商。公司主要经销商皆为行业内知名经销商，具有较强的营销管理能力，同时自身的技术水平和团队也能为终端客户提供一定的售前和售后技术支持服务，从而有效地满足终端客户的需求。

2、制造与服务业务板块

（1）研发流程

公司制造与服务板块工艺技术研发遵循业界标准的研发流程，具体包括立项评估、工程开发、产品验证、试生产、量产等重要环节，每个阶段均有专门的评审委员会进行评审。公司制造与服务板块工艺技术研发简要流程如下：

①立项评估阶段：市场部门根据市场及客户发展需求以及公司产品发展战略需求，确立工艺技术发展目标，在公司内产、销、研等部门展开全面立项评估，针对市场、商业、技术、生产、财务等维度进行量化打分，最终由评审委员会进行评议后确定是否立项，并明确项目目标与负责人。

②工程开发阶段：基于立项需求及项目目标，项目负责人在公司范围内成立项目团队，规划项目开展计划与配套资源，组织实施项目研发工作。以晶圆制造为例，具体技术开发流程包括工艺物理设计规则文件定义、工艺流程架构定义、器件架构及参数目标定义、工程开发阶段工程掩模版的规划与制作、工程试验方案的制定与流片、工艺及器件开发结果测试与评价等工作。工艺及器件开发达标后，研发中心负责总结阶段成果并提交评审委员会评审阶段技术交付。通过技术评审后，由市场部门结合市场及客户发展状况判定项目是否进入下一研发阶段。

③产品验证阶段：基于工程开发阶段交付，由研发中心完成器件模型参数提取与设计服务套件文件建立，并提交给设计单位进行相应产品设计。产品导入后由研发中心开展产品工程流片并保证工艺及器件参数达标。产品功能验证评价由设计单位负责，研发中心配合进行工程改善以及产品工程窗口验证。产品验证达标后，由研发中心负责总结阶段成果并提交评审委员会评审技术交付。通过技术评审后，市场部门结合市场及客户发展状况判定项目是否具备进入试生产阶段的条件。

④试生产阶段：通过工艺平台可靠性考核及客户产品可靠性考核，客户产品进入小批量生产阶段。该阶段主要包括产品良率提升、生产工艺能力提升、生产产能拓展等工作。产品试生产各项交付指标达标后，研发中心负责总结阶段成果，并提交评审委员会评审。通过技术评审后，公司结合市场及客户发展状况判定项目是否进入下一阶段。

⑤量产阶段：运营中心主要负责产品生产，并管控产品良率提升、生产能力改进、生产效率提升等工作，使研发效益最大化。

（2）采购模式

公司制造与服务板块主要采用“以产定采”的采购模式。晶圆制造服务主要采购原材料有硅片、化学品等；封装测试服务主要采购原材料有引线框、塑封料等。同时，公司采购部门会根据市场供应情况、价格变化情况及供应商交货周期等因素，结合生产计划对主要的原材料，进行适当的安全库存备货。

公司采购方式分为招标采购方式和非招标采购方式，公司经过多年发展，已和多数主要原材料供应商建立了良好的合作关系，建立了合格供应商名录，采购部门按采购计划在《合格供应商名录》中选择合格供应商进行采购。采购部门会根据采购类别和采购金额选择相应的采购方式，并与供应商签订相应的采购合同，内容包括采购金额、数量和供货日期等，货物经质检验收后入库。

(3) 生产模式

公司具备完善的生产运营体系，由运营中心综合考虑市场需求、原材料供应和产能情况制定生产计划。

对于晶圆制造业务，在接到客户的产品订单后，公司首先根据客户的需求确定客户产品所需的制程、规格并制定工艺路线和工艺流程等相关资料。综合计划部负责制造生产过程控制、订单交期确认和生产计划安排，智能与信息化部负责提供生产自动化及生产系统方面的技术支持，质量管理部评价产品质量控制能力并提出质量控制方案，订单通过评审后由制造部门负责落实生产。对于新客户或是新产品，制造中心与研发中心将协同公司相关部门进行立项评审，确定产品开发项目及相关的工艺路线、工艺流程，安排流片实验并完成相关的技术测试分析、封装测试分析、客户试用评估、可靠性考核评估等新品综合实验。通过客户验证评估后，公司对新产品进行试生产、小批量生产以评估产品的稳定性、一致性以及是否具备量产所需的工艺窗口。通过这些验证后，产品可以开始根据客户需求进入量产。公司质量管理部负责各环节产品质量的跟踪检测，所有产品经质量管理部验收合格后才会交付给客户。

对于封装测试业务，公司生产流程如下：客户有新产品封装测试需求，公司将先评估封测是否能承接并安排工程试验批，流程通过后进入量产阶段。客户提供封测代工需求计划，综合计划部依据产能情况评估计划承接量。公司在接到客户订单并收到客户圆片后，进行生产安排，并负责管理订单交期确认、生产计划安排、订单交付等事项。在具体的生产过程中，综合计划部负责封测生产过程控制、订单交期确认和生产计划安排，智能与信息化部负责提供生产自动化及生产支持系统方面等技术支持，质量管理部评价产品质量控制能力并提出质量控制方案，订单通过评审后由制造中心负责落实生产，质量管理部负责各环节产品质量的跟踪检测，所有产品经质量管理部验收合格后才会交付给客户。

(4) 销售模式

目前公司制造与服务板块以直销作为主要销售方式，由市场部门负责销售管理，公司制造与服务板块主要客户是半导体企业，公司与国内众多半导体企业建立了稳定的合作关系，并与其在产品交期、质量控制、交货方式、付款方式等方面形成了标准化、系统化、合同化约束，客户一般会与公司签订框架性合同，根据具体的生产计划以订单方式向公司发出采购计划，公司生产完成后发货。发货后，系统根据发货单自动生成销售发票，市场部门审核后将发票发送客户。公司会每月与客户进行对账确认，对于授信客户，市场部门按照相应的授信账期在发货后跟踪货款结算情况，以保证按期收款。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体是电子产品的核心，信息产业的基石。半导体行业具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。自 2000 年以来，我国政府颁

布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展，如 2011 年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2014 年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，2016 年国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、2017 年工信部颁布的《物联网“十三五”规划》、2020 年 8 月 4 日，国务院颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化半导体产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇，预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。

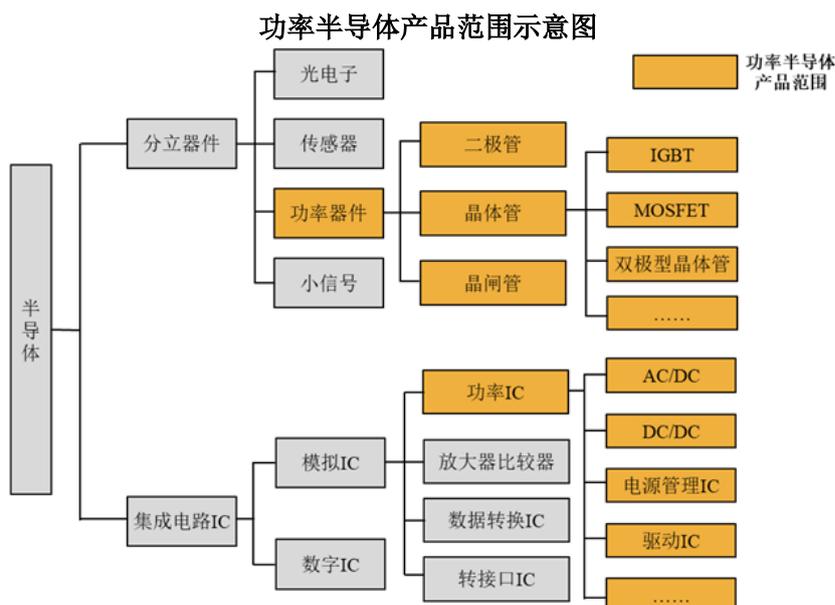
随着物联网、5G 通信、人工智能等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。全球集成电路行业市场规模大且保持较快增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2020 年全球半导体市场销售额为 4,390 亿美元，同比增长了 6.5%。根据 IBS 数据，未来五年，半导体行业将迎来一波快速增长，预计 2022 年市场规模突破 5,000 亿美元，2024 年将达到 6,060 亿美元。到 2030 年，全球集成电路产业规模预计达到 1 万亿美金。

我国本土半导体行业起步较晚。但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，中国半导体行业不断发展。步入 21 世纪以来，我国半导体产业市场规模得到快速增长。根据海关统计，2020 年中国进口集成电路 5,435 亿块，同比增长 22.1%；进口金额 3,500.4 亿美元，同比增长 14.6%。2020 年中国集成电路出口 2,598 亿块，同比增长 18.8%，出口金额 1,166 亿美元，同比增长 14.8%。整体来看，半导体市场增长前景可观，我国集成电路自给率仍较低，依然有很大的成长空间。

我国由于疫情控制较好，2020 年 GDP 实现了 2.3% 的增长，首次突破 100 万亿元，达到了 101.6 万亿元。在中国经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。半导体行业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造半导体行业产业链，实现更加健康和可持续的发展。随着 5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR 等新一轮科技逐渐走向产业化，未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度，中国半导体行业发展迎来了历史性的机遇。

近年来，功率半导体的应用领域已从工业控制和消费电子拓展至新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多市场，市场规模呈现稳健增长态势。根据 Omdia 数据，2019 年全球功率半导体市场规模约为 456 亿美元，预计至 2021 年市场规模将增长至 461 亿美元。2019 年中国的功率半导体市场占全球功率半导体市场 38% 的份额，达到 173 亿美元，2024 年市场规模有望达到 190 亿美元，具有广阔的国产替代空间。随着国家政策为大陆半导体行业创造了良好的发展环境及半导体产业重心向中国的转移，中国功率半导体行业有望率先实现国产替代，进入高速发展的黄金时期。中国功率半导体企业有望在消费电子、工业控制、汽车电子等领域实现依次突破，国产替代进程正不断加速。

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体分为功率 IC 和功率分立器件两大类，功率分立器件主要包括二极管、晶闸管、晶体管等产品。



2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。经过多年发展及一系列整合，公司是目前国内领先的运营完整产业链的半导体企业。

公司是中国本土领先的以 IDM 模式为主经营的半导体企业，同时也是中国最大的功率器件企业之一。在功率半导体领域，公司多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。其中，MOSFET 是公司最主要的产品之一，公司是国内营业收入最大、产品系列最全的 MOSFET 厂商。公司是目前国内少数能够提供 -100V 至 1500V 范围内低、中、高压全系列 MOSFET 产品的企业，也是目前国内拥有全部主流 MOSFET 器件结构研发和制造能力的主要企业，生产的器件包括沟槽栅 MOS、平面栅 VDMOS 及超结 MOS 等，可以满足不同客户和不同应用场景的需要。根据 Omdia 的统计，2019 年度以销售额计，公司在中国 MOSFET 市场中排名第三，仅次于英飞凌和安森美，是中国本土最大的 MOSFET 厂商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 第三代半导体材料带来发展新机遇

半导体行业经过近六十年的发展，目前已经发展形成了三代半导体材料，第一代半导体材料主要是指硅、锗元素等单质半导体材料；第二代半导体材料主要是指化合物半导体材料，如砷化镓、锑化铟；第三代半导体材料是宽禁带半导体材料，其中最为重要的就是 SiC 和 GaN。和传统半导体材料相比，更宽的禁带宽度允许材料在更高的温度、更强的电压与更快的开关频率下运行。SiC 具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高热导率等特点，使得其器件适用于高频高温的应用场景，相较于硅器件，可以显著降低开关损耗。因此，SiC 可以制造高耐压、大功率电力电子器件如 MOSFET、IGBT、SBD 等，用于智能电网、新能源汽车等行业。与硅元器件相比，GaN 具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高的电子迁移率的特点，是超高频器件的极佳选择，适用于 5G 通信、微波射频等领域的应用。未来，随着第三代半导体材料的成本因生产技术的不断提升而下降，其应用市场也将迎来爆发式增长，给半导体行业带来新的发展机遇。根据 Omdia 数据，2019 年 SiC 应用市场规模约 6.5 亿美元，受新能源汽车行业庞大的需求驱动，以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升的影响，预计到 2025 年 SiC 应用市场规模将超过 24 亿美元，2019-2025 年的复合增速接近 24%。

(2) 新兴科技产业的发展孕育新的市场机会

随着物联网、5G 通信、人工智能等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。如在汽车电子领域，相比于传统汽车，新能源汽车需要用到更多传感器与制动集成电路，新能源汽车单车半导体价值将达到传统汽车的两倍，同时功率半导体用量比例也从 20% 提升到近

50%。新兴科技产业将成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内半导体行业将会出现发展的新契机。

(3) 先进封装技术的升级迭代与创新

随着半导体产业进入后摩尔时代，制造端的成本不断上升，产品功能集成更加复杂，因此得益于对更高集成度的广泛需求，以及下游 5G、消费类、存储和计算、物联网、人工智能和高性能计算等大趋势的推动，先进封装将成为推进封装产业的主推动力。根据 Yole 的预测，2018-2024 年，先进封装市场的年复合增长率将达到 8%，到 2024 年达到近 440 亿美元。虽然中国本土供应商在传统封装领域已占据较高比例的全球市场份额，但在先进封装领域仍需持续提升国际竞争力，2020 年我国先进封装占全球市场比例预计约为 14.8%，仍有较大的提升空间。先进封装技术的演进，一方面提升封装测试环节在半导体制造产业链中的地位与价值量，另一方面也给现有市场格局带来了新技术要求的挑战。先进封装包括倒装芯片 (FC)、硅通孔 (TSV)、嵌入式封装 (ED)、扇入 (Fan-In)/扇出 (Fan-Out) 型晶圆级封装、系统级封装 (SiP) 等先进技术演进形式，相较于传统封装技术能够保证质量更高的芯片连接以及更低的功耗。其中，扇外型封装技术是顺应半导体产品小型化、薄型化、功能强而发展起来的新一代封装技术，是封装技术最重要的发展方向之一。面板级封装 (PLP) 是一种从晶圆和条带级向更大尺寸面板级转换的方案。由于其潜在的成本效益和更高的制造效率，吸引了市场的广泛关注，该技术有望带来了相较传统封装更高规模的经济效益，并且能够实现大型封装的批量生产。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

1、主要核心技术

公司业务包括产品与方案业务及制造与服务业务两大业务板块，公司在主要的业务领域均掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，大部分核心技术均为国内领先，其中沟槽型 SBD 设计及工艺技术、光电耦合和传感系列芯片设计和制造技术及 BCD 工艺技术国际领先。上述核心技术已成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司主要核心技术情况如下：

(1) 产品及方案业务相关核心技术

序号	产品类别	核心技术名称	技术/产品特点	技术来源
1	MOSFET	沟槽栅 MOS 器件设计及工艺技术	1) 较优的单位面积导通电阻值及优值系数 (FOM) 2) 抗短路能力强 3) 可靠性高	自主研发
		平面栅 VDMOS 设计及其工艺技术	1) 高的功率密度 2) 更好的 EMI 和效率折衷表现 3) 高可靠性和高抗冲击能力 4) 集成低漏电超快恢复 FRD 的产品，适用于更高功率的全桥拓扑应用类市场 5) 超高压系列 1000V-1700V 拓展到更宽应用	自主研发
		多层外延超结 MOS 器件设计及工艺技术	1) 自主专利保护的采用非掺杂多层外延技术 2) 更高的功率密度 3) 更高的开关效率 3) 高 ESD 保护能力 4) 工业类可靠性 5) 集成快恢复 FRD 的产品，适用于更高功率的 ZVS、LLC 拓扑应用类市场，如充电桩，通讯电源等	自主研发
2	IGBT	IGBT 设计及工艺技术	1) 采用 Trench-FS 工艺及超薄晶圆加工技术 2) 导通电压低、开关损耗小 3) 可靠性高、适用性强	自主研发
3	功率二极管	沟槽型 SBD 设计及工艺技术	1) 采用 8 英寸 Trench 结构 2) 电压覆盖 30V-200V 3) 多种金属势垒、满足不同性能要求	自主研发
		FRD 设计及制备技术	1) 采用重金属掺杂工艺 2) 较快的反向恢复特性	自主研发

序号	产品类别	核心技术名称	技术/产品特点	技术来源
			3) 较优的软度系数、高雪崩耐量	
4	物联网应用专用 IC	烟雾报警 IC 的设计技术	1) 丰富的产品规格、多种控制方式 2) 具有智能联网功能 3) 通过美国 UL 认证	自主研发
		MEMS 信号采样处理设计技术	1) 采用高精度 Delta-Sigma ADC 技术, 功耗低、灵敏度高 2) 可同时处理多个、多种 MEMS 传感器, 实现 MEMS 传感器信号同步采样、信号实时处理和校准	自主研发
5	功率 IC	无线充专用 IC 的设计技术	1) 满足国际无线充电联盟 (WPC) 的 Qi 标准 2) 高充电效率、低待机功耗、低 EMI 3) 支持过温过压过流保护、异物检测和动态电流调整 4) 适合无线充应用的 PD 快充技术	自主研发
		锂电管理系统专用 IC 的设计技术	覆盖绝大多数锂电系统的应用需求, 包括单节锂电保护、2-7 节锂电硬件保护、5-8 节以及 10 节及以上锂电保护模拟前端	自主研发
		LED 驱动 IC 的设计和制造技术	1) 采用公司特色 700V 工艺 2) 产品规格齐全 3) 性能稳定、可靠性高	自主研发
		通用开关电源控制技术 & 高可靠三端稳压电路的设计、工艺及测试技术	1) 采用公司特色工艺 2) 产品规格齐全 3) 产品可靠稳定、一致性好	自主研发
6	光电耦合及传感	光电耦合和传感系列芯片设计和制造技术	1) 采用公司特色工艺 2) 较优的重复峰值电压及产品开关速度 3) 高抗干扰能力、高光耦隔离电压、高产品可靠性	自主研发
7	SiC	SiC JBS 系列产品设计和制造技术	1) 采用公司自主研发的 SiC 工艺和封装技术 2) 优异的导通压降 V_f 、 Q_c 及漏电, 系统性能达到国际一线品牌水准 3) 抗浪涌能力强 4) 工业级可靠性	自主研发

(2) 制造与服务相关核心技术

序号	工艺类别	核心技术名称	技术/工艺特点	技术来源
1	BCD 工艺技术	硅基高压 BCD 工艺技术、硅基高密度 BCD 工艺技术、SOI 基 BCD 工艺技术	1) 覆盖 1.0-0.18 μ m 的各个技术节点 2) 支持超大范围的工作电压 5V-700V 3) 低导通电阻、高可靠性 4) 同步提供 200-600V SOI 基 BCD 工艺选项	自主研发
2	MEMS 工艺技术	麦克风 MEMS 工艺技术、压力 MEMS 工艺技术、光电传感器工艺技术、温湿度 MEMS 工艺技术	1) 提供完整的标准 MEMS 工艺模块, 能够灵活调整组合 2) 提供多样化的表面或体硅加工技术及客制化的平台 3) 丰富的平台组合, 包含压力、麦克风、光电、温湿度等 MEMS 工艺制程	自主研发
3	功率封装技术	IPM 模块封装工艺技术	提供金属框架、铝基板 (IMS) 和陶瓷基板三种 IPM 封装技术解决方案	自主研发

序号	工艺类别	核心技术名称	技术/工艺特点	技术来源
		PQFN/PDFN 封装工艺技术	1) 齐全的封装类型 2) 多种工艺组合, 满足不同器件性能的需要 3) 掌握主流的功率封装先进工艺技术, 包括超薄芯片封装、铝丝和铝带键合、CopperClip Bond 技术和倒装 (FC) 技术等	自主研发
4	面板级扇出封装技术	单层板双面散热封装技术	1) 提供完整的面板级扇出封装产品结构设计, 仿真与加工方案 2) 双面散热工艺, 有效降低器件工作温度 3) 产品适用于大电流, 降寄生, 高散热产品	合作研发
		1.5 层扇入扇出结合面板封装技术	1) 产品扇入, 扇出相结合, 最小化封装设计, 有效提升芯片与封装尺寸占比 2) 可提供多层布线产品加工方案	自主研发
		超薄产品封装技术	封装产品厚度 300um, 产品厚度可自由调整, 不受设备与治具限制	自主研发

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内, 公司加大技术研发的投入力度, 通过配置先进设备、引入高端人才、加强对外合作、充分利用产业链一体化的生产能力及技术资源, 提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平, 巩固和保持公司产品和技术领先地位, 取得较好成效。报告期内, 公司主要取得的研发成果如下:

(1) 公司充分利用 IDM 模式优势和在功率器件领域雄厚的技术积累开展 SiC 功率器件研发, 向市场发布第一代 SiC 工业级肖特基二极管(1200V、650V)系列产品, 国内首条 6 英寸商用 SiC 晶圆生产线正式量产。产品可广泛应用于太阳能、UPS、充电桩、储能和车载电源等领域。

(2) 公司中低压功率 SGT MOSFET 产品实现关键核心技术突破, 器件性能达到对标产品的国际先进水平。

(3) 报告期内, 公司完成 5A-43A 系列化超结 MOS 器件产品的开发, 多颗产品实现批量生产。

(4) 公司向市场推出了 30V 系列新一代沟槽栅 MOS 产品, 整体性能达到国内领先水平。

(5) 公司多芯片封装集成 IPM 模块实现批量销售, 同时向家电市场推出多颗不同电流和电压的系列化产品。

(6) 公司推出全新的平面高压 MOSFET 第七代产品, 该产品具有电流密度高、开关速度快、浪涌能力强、制造成本低等多种优势, 可以广泛用于 LED 电源、适配器、充电器等领域。

(7) 公司自主研发的采用国产 32 位 CPU IP 的 MCU 产品实现客户导入, 并持续开发系列化产品方案。

(8) 公司成功推出适用于电动自行车、平衡车的 7 节、10 节硬件保护产品 PT6007B、PT6010, 以及用于电池包二级保护的产品 PT6605M, 并实现全系列硬件保护产品, 支持铁锂电池应用。

(9) 公司完成光电高压可控硅成品平台研发, 推出过零触发和随机相位触发等多颗产品。

(10) 公司光电及硅麦克风传感器工艺平台从 6 英寸升级到 8 英寸, 实现批量生产, 产品性能及良率水平优秀; 整体提升了公司 MEMS 工艺技术水平 and 竞争能力。

(11) 公司成功完成面板级封装技术从研发到量产化导入工作, 可为客户提供面板级封装技术解决方案, 封装产品可靠性满足工业电子元器件应用需求, 封装阻抗可小于 0.5 毫欧。

(12) 自主实现 PD 快充调压技术, 完成 60W 高功率发送方案开发。

(13) 自主研发的 SuperJunction 多层外延技术实现突破, 功率密度进一步提升 20% 以上, 效率进一步提高, 并拓展到集成 ESD 保护系列产品和集成快恢复 FRD 系列产品, 达到工业级可靠性, 性能对标业界先进水准。

(14) IGBT 技术从 6 英寸升级到 8 英寸, 自主研发的 8 英寸 1200V、650V IGBT 工艺平台已建立完成。

(15)高精度模拟集成电路工艺技术平台实现量产。该工艺平台采用国内领先的0.153微米技术，自主研发了多项新型器件结构，可提供丰富的IP，具有具有优秀的线性度、低的噪声和更低的功耗，非常适用于高精度测量和传感器应用，核心器件可以达到车规级可靠性要求。

(16)报告期内，公司“0.153um CMOS EN 高精度模拟技术平台研发与产业化”、“新一代驱动型低压大电流 Trench-MOSFET”获得第十四届（2019 年度）获中国半导体创新产品和技术奖，“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”获“江苏省科学技术一等奖”等。

序号	获奖项目名称	奖项名称	颁奖单位
1	0.153um CMOS EN 高精度模拟技术平台研发与产业化	第十四届（2019 年度）中国半导体创新产品和技术奖	中国半导体行业协会等
2	新一代驱动型低压大电流 Trench-MOSFET	第十四届（2019 年度）中国半导体创新产品和技术奖	中国半导体行业协会等
3	一种 e-flash Cell 可靠性寿命分析模型建立	2020 年中国质量技术与创新成果发表赛可靠性管理组“示范级”奖项	中国质量协会
4	业绩领先的0.153 CMOS EN 工艺平台开发	2020 年中国质量技术与创新成果发表赛质量创新组“示范级”奖项	中国质量协会
5	叠层芯片封装品质提升	2020 年中国质量技术与创新成果发表赛六西格玛组“改进级”奖项	中国质量协会
6	带 4×32LCD 驱动和 24 位 ADC 的测温专用微控制器（CS77P25）	第十五届“中国芯”“优秀支援抗疫产品”奖	工业和信息化部与集成电路促进中心
7	8~10 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片（PT6010）	第十五届“中国芯”“优秀技术创新产品”奖	工业和信息化部与集成电路促进中心
8	智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用	江苏省科学技术一等奖	江苏省人民政府

报告期内，公司新增境内专利申请 319 项，PCT 国际专利申请 54 项，境外专利申请 43 项；截至 2020 年末，公司已获得授权并维持有效的专利共计 1,711 项，其中境内专利 1,492 项、境外专利 219 项。

报告期内获得的知识产权列表如下：

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	363	154	3,318	1,355
实用新型专利	52	59	611	572
外观设计专利	1	2	15	14
软件著作权	0	0	4	4
其他	1	9	344	344
合计	417	224	4,292	2,289

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	566,077,973.66	482,615,725.08	17.29
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	566,077,973.66	482,615,725.08	17.29
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.11	8.40	下降 0.29 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	硅基氮化镓功率器件设计及工艺技术研发	24,354.00	3,745.30	3,745.30	自主开发的第一代 650V 硅基氮化镓 Cascode 器件静态参数达到国外对标样品水平，产出工程样品，可靠性考核通过，已送样客户	完成 650V 硅基氮化镓器件的研发，建立相应的材料生产、产品设计、晶圆制作和封装测试能力	国内领先	应用于智能手机充电器、电动汽车充电器、电脑适配器等领域
2	SiC 功率器件设计及工艺技术研发	14,217.00	3,277.66	3,277.66	第一代 6 英寸 650V、1200V SiC JBS 系列产品正式发布，并实现量产；第二代 SiC JBS 产品设计和工艺开发完成，产出工程样品，并通过可靠性考核评估，性能指标达到对标水平；第三代和第四代 SiC JBS 产品设计和工艺开发完成，产出工程样品，正在进行可靠性考核评估。平面型 MOSFET 产出 1200V 160mΩ 样品，并完成摸底考核	完成四个代次 SiC JBS 产品及平面型 MOSFET 产品的研发，建立相应的产品设计、晶圆制造和封装测试能力	国内领先	应用于光伏逆变器、风电逆变器，UPS 电源、电动汽车、充电桩、车载充电机，轨道交通驱动，电信和服务器电源
3	IGBT 产品设计及工艺技术研发	5,954.71	1,114.51	1,114.51	完成 650V/1200V 高性能 IGBT 芯片和沟槽 FS-IGBT 芯片工艺平台开发。代表器件 650V 75A，650V 40A，1200V 40A 产品可靠性考核摸底初步通过，直流参数达到技术指标	通过自主开发和技术合作，开发先进的 650V/1200V 高性能 IGBT 芯片和沟槽 FS-IGBT 芯片，建立相应的产品设计、工艺制造能力	国内领先	应用于消费类白电、工控类变频器、伺服、机器人、光伏逆变、风力发电等
4	单片智能功率集成电路设计及工	4,364.08	933.82	933.82	完成单片智能功率集成电路产品和工艺的优化，168h 可靠	完成电机应用 500V 单片智能功率集成电路的研	国内领先	应用于白电室内风机，室外风机，

	艺技术研发				性考核通过，并送样客户	发，同步研发和建立完成支持该系列产品的 SOI-BCI 工艺技术和封装测试技术平台		空气净化器，风扇，塑封电机等
5	20-30V DrMOS 器件研发	2,000.00	51.67	51.67	完成市场调研和竞品测试分析，开始 Driver、MOS 以及封装的研发	整合内外部资源，开发具有业界先进水平的 20-30V DrMOS 产品	国内领先	应用于服务器/通讯系统/PC 等领域
6	AC-DC Fly-back 电源模块芯片研发	2,000.00	72.19	72.19	完成原、副边 IC 功能特性定义,完成副边 I2C 读写寄存器设计及原边 IC 功能框图设计, IC 设计开发进行中	开发具有业界先进水平的、面向 USB PD 快充应用的 AC-DC Fly-back 原、副边控制集成电路	国内领先	应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的充电器；多输出电压的 LED 照明整流器、工业电源设计
7	基于 GaN 的快充方案及芯片研发	3,948.00	240.50	240.50	完成系统方案原型机设计，并通过系统设计评审，芯片架构设计进行中	采用新型的 GaN 器件控制及驱动技术，开发 GaN 器件的驱动芯片及基于 GaN 器件的快充电源系统方案	国内领先	应用于手机、平板、笔记本等充电器及适配器，具有功率密度高、效率高、体积小等特点
8	0.11 微米 BCD 工艺平台研发	7,875.00	1,085.40	1,085.40	完成单项模块工艺开发，低压逻辑器件参数达标，高压器件的开发进行中	提升 BCD 工艺技术水平，巩固在 BCD 技术领域的竞争优势	国内先进	应用于 PMIC、sub-PMIC 等传统消费类产品线，并涵盖工控（安防、通讯等）、车用电子产品（BMS、电源控制等）范围
9	面板级封装技术研发	55,000.00	15,768.18	36,271.92	已建成国内领先的高性能低成本的面板级封装专用生产线，通过国内外客户产品考核认证，并进入量产阶段	建立专用生产线，研发高性能、低成本的面板级封装技术解决方案	国内领先	提供更轻，薄，短，小的封装方案，用于代替现有 FC QFN,LGA 封装形式，提高产品性价比和可靠性

10	MEMS 数字传感器产品研发	1,500.00	389.51	389.51	新一代小尺寸压力芯片开发完成, 并实现小批量生产; 温湿度传感器完成工程设计, 流片验证中; 多传感处理芯片已产出样品送客户试用	研发新一代高性能压力传感器和温湿度传感器, 配合多传感处理芯片, 实现多颗单体和复合智能数字传感器产品, 配套建立新一代压力和温湿度传感器工艺平台	国内先进	应用于空气净化器, 无人机, 手机, 环境检测仪, 便携式产品等, 满足更小、更薄、多传感功能应用需要
11	32 位电机控制 MCU 系列产品研发	4,200.00	491.99	491.99	完成第一颗基于 arm-cortex m0 32 位电机专用 MCU 产品工程开发, 进入样品试制。启动第二颗基于 RISC-V 32 位电机专用 MCU 产品研发, 已构建初期 FPGA 原型, 完成典型策略初期验证	以简化电机控制方案、提升电机控制效率为目标, 围绕电机引擎模块研发两代 32 位电机控制产品	国内领先	应用于电动工具, 电动自行车、风扇及家电场景中的电机控制
12	工业级 200V 大功率肖特基芯片及封装技术研发	1,000.00	285.72	285.72	完成芯片工艺技术平台研发; 大功率芯片设计完成, 正在流片验证中	完成工业级 200V 大功率肖特基芯片研发及封装开发, 填补国内空白	国内先进	应用于轨道交通, 大功率电源
13	超高压 MOS 晶圆及封装技术和产品研发	450.00	230.44	230.44	工业级超高压 4500V VDMOS 工艺平台基本建立完成, 首颗样品电性参数满足客户需求; 并已完成可靠性考核平台搭建, 开始可靠性试验	开发生产符合电网需求的工业级超高压 4500V VDMOS 器件, 实现国产替代	国内领先	应用于工业级电网系统
合计	/	126,862.79	27,686.90	48,190.63	/	/	/	/

情况说明

结合公司前瞻性技术和产品升级募投研发项目的实施计划, 将公司主要在研项目以上市当年度作为新起始(阶段)期进行披露。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	697	653
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	7.7	8.3
研发人员薪酬合计	16,374.96	16,403.67
研发人员平均薪酬	23.49	25.12

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士及博士后	5	0.72
硕士	225	32.28
本科	369	52.94
专科	78	11.19
专科以下	20	2.87
合计	697	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
<25岁	57	8.18
25岁—35岁	361	51.79
35岁—45岁	223	31.99
45岁—55岁	42	6.03
>55岁	14	2.01
合计	697	100

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元

主要财务指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
货币资金	6,865,693,381.17	1,930,674,620.44	255.61
交易性金融资产	901,191,461.19	507,535,344.46	77.56
长期股权投资	190,508,576.87	81,713,330.37	133.14

其中:境外资产 647,961,675.85(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 3.9%。

说明:

- 1、本公司于 2020 年 2 月 19 日首次公开发行人民币普通股股票(A 股)每股面值为 1.00 港元,初始发行数量 292,994,049 股,发行价格为每股人民币 12.80 元,首次公开发行募集资金 3,750,323,827.20 元。
- 2、本公司首次公开发行人民币普通股股票(A 股)超额配售选择权于 2020 年 3 月 27 日全额行使,超额配售 43,949,000 股,每股配售价格为 12.80 元,超额配售募集资金 562,547,200 元。
- 3、由于首次公开发行股票及超额配售,报告期末的货币资金比上年末大幅增加。

4、报告期内本公司对润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的长期股权投资额增加 1.07 亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、国内领先的拥有全产业链一体化运营能力的半导体企业

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。经过多年发展，公司在半导体设计、制造、封装测试等领域均取得多项技术突破与经营成果，已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业，自 2004 年起连续多年被工信部评为中国电子信息百强企业。

公司是中国本土领先的以 IDM 模式为主经营的半导体企业，同时也是中国最大的功率器件企业之一。对于功率半导体等产品，其研发是一项综合性的技术活动，涉及到产品设计端与制造端研发多个产业链环节的综合研发，IDM 模式经营的企业在研发与生产各环节的积累会更为深厚，更利于技术的积淀和产品群的形成与升级。作为拥有 IDM 经营能力的公司，公司的产品设计与制造工艺的研发能够通过内部调配进行更加紧密高效的联系。受益于公司全产业链的经营能力，相比 Fabless 模式经营的竞争对手，公司能够有更快的产品迭代速度和更强的产线配合能力。基于 IDM 经营模式，公司能更好发挥资源的内部整合优势，提高运营管理效率，能够缩短产品设计到量产所需时间，根据客户需求进行更高效、灵活的特色工艺定制。

2、丰富的产品线组合与先进的特色化制造工艺

经过多年发展，公司在功率半导体等产品领域积累了系列化的产品线，能够为客户提供丰富的产品与系统解决方案。公司合计拥有 1,100 余项分立器件产品与 500 余项 IC 产品，拥有 CRMICRO、华晶、IPS 等多个功率器件自主品牌，自主开发的 SGT MOS、SJMOS、SBD、FRD、IGBT 工艺平台及相应模块和系统应用方案技术水平处于国内领先。公司是国内产品线最为全面的功率分立器件厂商之一，丰富的产品线能够满足不同下游市场的应用场景以及同一细分市场中不同客户的差异化需求，产品面向消费电子、计算机、网络通信、工业控制、医疗电子、汽车电子等市场的电机、电池、电源三大应用领域，广泛应用于电动车、通用开关电源、手机快充、照明、电动工具、家电、电焊机、储能、消防、智能电网、仪表、UPS、变频器、充电桩、太阳能光伏以及工控和汽车电子等细分市场。

公司具有全国领先的半导体制造工艺水平，BCD 工艺技术水平国际领先、MEMS 工艺等晶圆制造技术以及智能功率 IPM 模块封装等封装技术国内领先。先进全面的工艺水平使得公司提供的服务能够满足丰富产品线的多项工艺需求。同时，公司的制造资源也在国内处于领先地位，目前拥有 6 英寸晶圆制造产能约为 248 万片/年，8 英寸晶圆制造产能约为 144 万片/年，具备为客户提供全方位的规模化制造服务能力。

3、专业的技术团队与强大的研发能力

公司一直以来高度重视技术团队的建设与研发能力的提升。2018 年至 2020 年，公司研发投入分别为 44,976.10 万元、48,261.57 万元和 56,607.80 万元，占营业收入的比例分别为 7.17%、8.40% 和 8.11%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 9,060 名员工，其中包括 3,238 名研发技术人员，合计占员工总数比例为 35.73%。公司的核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年，在不同的技术方向具有丰富的研发经验，并对行业未来的技术发展趋势具有前瞻性的创新能力。公司核心技术人员研发能力保证了公司的市场敏锐度和科研水平，确保了公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，亦满足客户终端产品的创新需求。

公司领先的科研实力受到了社会的认可，公司积极承担国家科技重大项目，共牵头承担了 5 项国家科技重大专项项目，并参与了 2 项国家科技重大专项项目和 2 项国家重点研发计划项目。截至 2020 年底，公司 7 个研发机构被各级政府授予 13 项资质。其中授予省级工程技术研究中心 1 项，省级企业技术中心 1 项，省级重点实验室 1 项，省级功率半导体技术创新中心 1 项，省级工程研究中心 3 项；市级企业技术中心 2 项，市级重点实验室 1 项，市级先进封装工程技术研究中心 1 项，市级技术研究院 2 项。同时，公司拥有 2 个博士后工作站，与多家国内知名高校合作建立了联合实验室。在大力投入研发的同时，公司也持续完善专利布局以充分保护核心技术，为业务开展及未来新业务的拓展创造了坚实的基础。2020 年度，公司新增境内专利申请 319 项，PCT

国际专利申请 54 项，境外专利申请 43 项；截至 2020 年末，公司已获得授权并维持有效的专利共计 1,711 项，其中境内专利 1,492 项、境外专利 219 项。

4、覆盖了庞大且高粘性的客户基础

悠久的历史底蕴、民族品牌形象、良好的质量控制、先进的产品技术与服务为公司打下了坚实的客户基础。公司客户覆盖工业、汽车、消费电子、通信等多个终端领域，客户基础庞大多元。公司秉承本土化、差异化的经营理念，深刻理解不同专业应用领域用户的需求，能够为客户提供专业、高效、优质且性价比较高的产品及服务，保证了较高的客户粘性。

公司目前已积累了世界知名的国内外客户群，产品及方案被不同终端领域广泛应用，市场认可度高。同时，公司亦为国内外知名半导体企业提供制造及服务支持。公司与众多客户拥有多年的合作经验，长期以来与之共同成长，通过产品工艺的共同开发与客户积累了深厚且紧密的合作关系。

5、经验丰富的管理团队

公司主要管理团队具有丰富的半导体行业经验，通过对行业趋势的深入观察，结合丰富的经营经验，能够准确地把握行业和公司的发展方向，制定合适的战略决策，帮助公司保持行业领先地位。

公司首席运营官李虹博士在半导体行业拥有近 30 年的行业经验，是公司各项技术发展和产业化的推动者。李虹博士曾先后工作于美国硅谷 Intel 技术与制造中心、上海宏力半导体制造有限公司（曾任副总裁）、无锡华润上华科技有限公司（曾任总经理）、无锡华润华晶微电子有限公司（曾任副总经理）。2018 年，李虹博士被重庆大学特聘为客座教授。李虹博士自 2017 年起，任华润微电子（重庆）有限公司总经理；自 2020 年起，任中国半导体行业协会副理事长，任公司董事、首席运营官、功率器件事业群总经理、技术研究院院长。

此外，公司管理团队的其他人员也均在半导体行业具有长时间的经验，对于行业发展具有深刻的理解。同时，公司的管理团队时刻保持锐意进取精神与创造力，带领着公司不断创新发展。

6、完善的质量管理体系

公司建立了完整的质量管理体系，依托产品研发和工艺技术的综合实力提升和保证产品品质。

目前公司及子公司已经获得了 ISO/IATF16949 质量管理体系、ISO9001 质量管理体系、QC080000 有害物质过程管理体系标准认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO50001 能源管理体系认证、索尼 GP 认证、欧盟 RoSH 认证等诸多国际认证，产品已经海内外客户的认可。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2020 年全球半导体市场销售额为 4,390 亿美元，同比增长了 6.5%。随着 5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR 等新一轮科技逐渐走向产业化，未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位，公司也将充分受益于集成电路行业发展，受益于进口替代、半导体产业自主可控等历史性机遇。

从终端应用来看，疫情之下，居家消费电子产品如智能设备、穿戴设备等销售提振，远程工作和在线访问需求的增加，数据中心建设和通信基础设施建设将加快。在“新基建”带动下，5G、数据中心、人工智能、特高压、充电桩、工业互联网、高铁轨交等领域的建设将一定程度上驱动需求增长，为半导体产业发展带来新的历史机遇。同时，国内疫情进入常态化管理，工厂产能恢复，而国际大厂受疫情影响的停工停产将给国内厂商带来供应链重塑的机会，国产替代有望进一步加速。

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线，公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司是中国本土领先的以 IDM 模式为主经营的半导体企业，同时也是中国最大的功率器件企业之一。

（一）报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 697,725.92 万元，较上年同期增长 21.50%；实现利润总额 108,565.21 万元，较上年同期增长 114.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 96,366.16 万元，较上年同期增长 140.46%；报告期末公司总资产 1,653,249.58 万元，较期初增长 63.76%；归属于母公司所有者权益为 1,058,278.79 万元，较期初增长 95.14%。

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 123,447.51 万元，同比增长 21.50%，主要系因功率器件事业群和代工事业群营业收入增加。

2、报告期内，公司整体毛利率较上年同期增长 4.63 个百分点，主要系因公司单位成本下降、产品获利能力好于上年同期。

3、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 56,290.61 万元，同比增长 140.46%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 64,683.62 万元，同比增长 313.52%，主要系因公司营业收入同比增长 21.50%、同时制造与服务业务板块产能利用率提升较大、毛利率提升 4.63 个百分点。

4、报告期内，公司研发费用 56,607.80 万元，同比增长 17.29%，公司新增境内专利申请 319 项，PCT 国际专利申请 54 项，境外专利申请 43 项；公司新增获得授权专利 215 项。

（二）报告期内公司业务发展情况

1、产品与方案业务板块

公司积极采取系列化举措，通过技术创新、产品升级，提高产品性能，以市场需求为引领，丰富产品系列、优化产品结构，抓住国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，提升细分市场占有率，推动产品与方案业务发展。报告期内，公司产品与方案实现销售收入为 31.04 亿元，占比 44.8%，与去年同期相比提升 0.6 个百分点，公司的产品与方案业务板块收入占比持续提高。

（1）报告期内，组织整合后的功率器件事业群运用以产品线为基础的业务组织模式，下设中低压 MOSFET 产品线、高压 MOSFET 产品线、双极和特种器件产品线、IGBT 产品线等四条产品线以及系统应用事业部，聚焦功率器件业务领域，通过提供自主品牌的高可靠性、高性能功率器件产品、模块和系统应用方案，持续为客户创造价值。

报告期内，受益于新基建、大消费、国产化等积极因素，以及公司功率器件业务一体化整合以及内部效率提升，功率器件事业群销售收入同比增长 25%。

报告期内，功率器件事业群成品单管、模块、系统方案销售规模进一步增长，销售收入同比增长 35%，产品品牌影响力在市场端进一步扩大。

报告期内，功率器件事业群 MOSFET 产品通过技术迭代和创新，不断提升产品性能，同时丰富产品线，保持产品的领先竞争力，支撑业绩成长和质量发展，销售额超过 20 亿元。

报告期内，功率器件事业群在 IGBT 器件设计开发和制造工艺领域积累了多项具有自主知识产权的核心技术，建立了一整套工业级产品的设计开发、生产制造标准和流程，不断丰富产品系列，为电焊机、逆变器以及变频器等应用领域的客户提供更为丰富的产品选型空间，IGBT 销售额超过 1 亿元，同比增长 75%。

报告期内，功率器件事业群积极拓展工控和汽车电子产品销售，调研工控和汽车电子市场与客户需求，聚焦汽车车载、车身电机控制器，以及 UPS、伺服驱动、电焊机和 5G 通信电源等汽车工控领域，有序推进新品立项开发，客户送样与量产供应。

报告期内，功率器件事业群积极布局宽禁带半导体器件，推进 SiC 技术平台产业化。功率器件事业群成功研发的 1200V 和 650V SiC 肖特基二极管产品性能卓越，其主要关键器件参数在系统应用中拥有与竞争对手一致的性能，可以满足市场上用户的需求，产品目标应用领域包括太阳能逆变器、通讯电源、服务器、储能设备等。2020 年 7 月 4 日，上海慕尼黑电子展期间，公司正式向市场投入 1200V 和 650V SiC 肖特基二极管产品，与此同时宣布国内首条 6 英寸商用 SiC 晶圆生产线正式量产，并获得小批量订单和出货。

(2) 报告期内，集成电路事业群积极推动一体化融合发展，以市场应用为引领，统筹规划产品线，下设标准产品线、LED 产品线、光电产品线、驱动及 MCU 产品线、消防及传感器产品线、电动工具产品线、智能电网应用及 AC-DC 等七条产品线，整体销售收入同比增长 24%。

报告期内，集成电路事业群加强市场与客户开拓，在国内白色家电、工业变频器等市场继续发力，同时在全力支援防疫工作的基础上，市场应用聚焦在三电及智能传感器和智能控制领域，功率驱动和电源管理相关产品导入品牌家电客户，烟雾报警传感器产品在品牌客户稳定上量，光电传感器产品与大客户进入稳定合作期，消防及传感器产品线销售额同比增长 64%，光电产品线销售额同比增长 45%。

报告期内，公司积极布局三电应用，500V 和 600V 智能功率模块产品系列化并成功推向市场，可满足多种无刷直流电机应用，目前市场需求较大，产品快速上量。电池管理系统产品受疫情影响出口受阻，公司积极调整市场策略，加大优势产品推广，逆势增长超过 33%。

公司计量 MCU、ASIC 以及配套的电源管理产品已经布局多年，产品广泛应用额温枪、耳温枪、电子体温计等，测温产品销售同比增长 370%。在疫情期间，额温枪的主控芯片供货 2,800 余万颗，快速电子体温计芯片供货 1.58 余亿颗，稳定了市场价格，充分展现央企的使命担当和社会责任，为国家的快速复工复产贡献了力量。

2、制造与服务业务板块

公司具有对外提供功率半导体规模化晶圆制造与封装测试的能力。公司通过加快创新步伐，夯实核心能力，持续进行晶圆工艺和封装能力提升，进一步掌握核心技术并建立差异化核心竞争力。同时通过质量体系完善、推行智能制造等方式提升市场竞争力，通过全产业链优势打造支撑产品业务发展。报告期内，制造与服务业务板块实现销售收入 38.27 亿元，与去年同期相比增长 20.2%。

(1) 晶圆制造方面，公司拥有中国领先的晶圆制造服务能力，为国内主要的半导体特种工艺平台之一，是国内前三的本土晶圆制造企业，公司能为客户提供 1.0-0.11 μm 的工艺制程的特色晶圆制造技术服务，包括硅基和 SOI 基 BCD、高压 CMOS、Bipolar、BiCMOS 等标准工艺及一系列客制化工艺平台，公司提供的 BCD 工艺技术水平国际领先。

报告期内，代工事业群持续推动先进 BCD、MEMS 高性能模拟特色工艺技术能力提升，增强技术差异化，持续以打造高性能、高压功率、高可靠性的 BCD 工艺技术为核心。报告期内，0.18 μm BCD G3 工艺平台综合技术能力进一步提升，逐步进行客户产品导入并量产。先进工艺系列技术平台整体技术水平达到 0.11 μm 节点，导入 600V SOI 工艺平台产品验证。MEMS 技术继续保持产业化优势，8 英寸硅麦克风工艺产品逐步量产，6 英寸高信噪比硅麦克风量产良率稳步提升。初步建立晶圆延伸叠加先进封装技术的工艺流程。

(2) 封装测试方面，公司具备完整的功率器件封装和 IPM 模块封装技术解决方案，公司自主研发 60 微米的超薄芯片封装技术、Copper-Clip BOND 技术和倒装技术等功率封装相关的关键核心技术，目前已应用于大电流 MOSFET、IPM 模块等功率器件和功率模块封装中，具备市场竞争优势。

封测事业群通过充分保障优质客户资源需求，将有限的产能向高效率/高线位的封装形式倾斜，利用客户和产品结构持续升级抵消了疫情带来的订单下降的影响，实现了比预期更好的盈利表现。

报告期内，智能功率模块封装产品和客户层面有了较大突破，国内白色家电（主要是空、冰、洗）、工业变频器等市场继续发力，预期未来几年将逐步起量。同时特色硅麦封装、光电传感器产品封装项目销售额均大幅提升。工业与汽车电子应用取得突破，报告期内导入两家汽车电子级产品客户，预期将逐步增量，提升汽车电子产品销售额占比。

报告期内，面板级先进封装技术取得突破，产品性能超出预期，受疫情影响，调整客户策略，重点关注国内客户导入上量工作，目前已导入多家知名设计公司进行验证，并有三家公司实现小批量生产。

3、组织管控与内部管理方面

公司通过对标国际领先的功率半导体企业，建设适用公司战略落地的组织架构，实现组织架构与战略目标的匹配，利用成为国资委“双百试点”企业的契机，推动公司组织变革，提升公司运营和管理效率。

(1) 报告期内，公司整合内部产品与制造资源，按产品与方案业务类、制造与服务业务类分成功率器件事业群、集成电路事业群、代工事业群和封测事业群四大事业群。

(2) 报告期内，华润微集成电路（无锡）有限公司吸收合并华润矽威科技（上海）有限公司和华润半导体（深圳）有限公司，集中研发资源，提高运营效率，积极推动集成电路事业群一体化融合发展。

(3) 报告期内，公司通过持续建设人才选拔体系，从岗位需求出发，恪守人才标准，关注人才质量，通过社会招聘、校园招聘、校企合作、猎头推荐、员工推荐、内部竞聘与培养等多样化的渠道与方式，吸引、选拔、聘用科技人才，确保人才认同华润价值观并具备持续发展潜力；公司高度关注行业内新工艺新技术的研究与发展，对于与公司战略目标相匹配的高端人才，采用灵活的市场化招聘方式大力引进。

同时公司组织召开年度科技大会，建立一个以科技工作者为主角的交流平台，一个科技创新战略传递宣贯的平台，积极培育创新文化，激发科研人员创新动力，建立协同创新机制，完善激励制度，推动可持续发展创新体系建设。

4、对外投资情况

报告期内，公司积极布局和拓展碳化硅业务及供应链，公司通过华润微电子控股有限公司与国内领先的碳化硅外延晶片企业-瀚天天成电子科技（厦门）有限公司达成《增资扩股协议》，增资后公司持有瀚天天成 3.2418% 的股权，通过资本合作和业务合作积极带动 SiC 业务的发展和布局。

报告期内，公司完成收购杰群电子科技(东莞)有限公司 70% 股权，已经在 9 月末办理完毕登记变更及交割公司手续，在本报告期末已将东莞杰群的资产负债表纳入合并范围（属于非同一控制下的企业合并），提升公司工业和车规级封装技术能力。

报告期内，润科基金开始进入正常的投资运行阶段，共有 19 个项目立项，其中 13 个项目完成了投决。润科基金围绕公司产业发展的纵向和横向进行投资，谋求产业链及细分领域的纵向与横向整合。其中，纵向投资包括上游端材料及设备，和下游端的先进封装和具体应用；横向投资包括共同组成模组或应用场景的电源、电机、电池解决方案中的核心元器件，以及传感器/物联网核心元器件，具体如下：

序号	参股公司名称	润科基金持股比例	成立日期	主营产品/服务
1	江苏菲沃泰纳米科技有限公司	2.89%	2016 年 8 月	纳米防护材料
2	无锡创达新材料股份有限公司	4.75%	2003 年 10 月	酚醛模塑料（PMC）、环氧模塑料（EMC）、不饱和聚酯模塑料（BMC）、有机硅胶等
3	北京天科合达半导体股份有限公司	0.93%	2006 年 9 月	碳化硅晶片及设备

序号	参股公司名称	润科基金 持股比例	成立日期	主营产品/服务
4	矽磐微电子（重庆）有限公司	6.50%	2018年9月	集成电路封装业务
5	杭州富特科技股份有限公司	2.08%	2011年8月	新能源汽车车载电源产品
6	无锡硅动力微电子股份有限公司	5.41%	2003年6月	电源管理芯片
7	西安芯派电子科技有限公司	3.96%	2008年7月	中大功率场效应管（MOSFET）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）
8	重庆中科超容科技有限公司	6.45%	2018年7月	高性能超级电容器及其储能系统
9	广东美信科技股份有限公司	6.25%	2003年9月	通信磁性元器件
10	深圳市开步电子有限公司	10.26%	2006年7月	高精密度电阻
11	重庆物奇微电子有限公司	6.00%	2018年7月	集成电路设计
12	上海灿瑞科技股份有限公司	1.98%	2005年9月	磁传感器芯片、显示驱动芯片以及 LCD 偏压芯片
13	无锡盛景微电子股份有限公司	2.98%	2016年4月	数码电子雷管芯片设计、电子雷管延期模块生产

公司于2020年10月19日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，并于2020年11月5日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了前述向特定对象发行相关议案并作出决议。本次发行股票募集资金总额不超过500,000.00万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）
1	华润微功率半导体封测基地项目	420,000.00	380,000.00
2	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
合计		540,000.00	500,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金用于功率半导体封测基地建设，集中整合公司现有封装测试环节资源，一方面通过先进的封测基地建设提高现有产能，满足日益增长的市场需求；另一方面助力公司在功率半导体封装测试这一后道制造领域的工艺提升，增强公司产品及服务的创新能力与技术水平。

二、风险因素

（一）尚未盈利的风险

适用 不适用

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

（三）核心竞争力风险

适用 不适用

1、产品研发与技术迭代风险

半导体产业技术及产品迭代速度较快。公司的发展在很大程度上依赖于识别并快速响应客户需求的变化，以开发出符合客户要求且具有较好成本效益的产品。为保证公司产品能够满足客户需求及紧跟行业发展趋势，公司在研发方面投入大量资金与人力资源。

半导体行业的特殊性，公司未来仍然面临着产品迭代速度过快、研发周期长、资金投入大的风险，如果公司的技术与工艺未能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级受阻、下游客户的需求发生难以预期的变化，可能导致公司产品被赶超或替代，前期的各项成本投入无法收回，进而在新产品领域难以保持市场的领先地位。

2、公司规模扩张与核心技术人员流失带来的管理风险

关键技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。随着半导体行业对专业技术人才的需求与日俱增，人才竞争不断加剧，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍存在关键技术人员流失的风险。

公司资产规模、业务规模和员工数量均快速增长的同时，公司各项业务将会进一步快速扩张。公司规模快速扩张会使得公司的组织结构和经营管理趋于复杂化，对公司的管理水平将提出更高的要求。若公司未能及时有效应对公司规模扩张带来的管理问题，可能会面临一定的管理风险。

3、与国际领先厂商存在技术差距的风险

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等各方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。该技术差距会导致公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性等诸多方面处于追赶地位，使公司在短期内面临激烈的市场竞争，且需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。如公司持续的研发投入未能缩短与国际领先水平的技术差距，且与国际领先厂商的市场竞争进一步加剧，则会对持续盈利能力造成不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、行业周期风险

公司主要产品包括功率半导体、智能传感器与智能控制产品，公司产品广泛应用于国民经济各个领域。半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对半导体产品的需求下降，进而影响半导体行业公司的盈利能力。如果由于贸易摩擦等因素引致下游市场整体波动，亦或由于中国半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

2、未来持续巨额资金投入风险

半导体行业具有技术强、投入高、风险大的特征。企业为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。

3、主要原材料供应商集中度较高及原材料供应风险

公司生产依赖于多种原材料，包括各种硅片、引线框、化学品和气体。原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。公司的一些重要基础原材料如大尺寸硅片、光刻胶等上游行业呈现集中度较高的市场格局，使公司在采购该等原材料时供应商集中度也相对较高。同时，由于国际政治及其他不可抗力等因素，原材料供应可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果公司出现不能及时获得足够的原材料供应，公司的正常生产经营可能会受到不利影响。

4、知识产权风险

作为一家科技型企业，公司的知识产权组合的优势是取得竞争优势和实现持续发展的关键因素。除了自有知识产权外，通过获得第三方公司 IP 授权或引入相关技术授权也是半导体公司常见的知识产权利用方式。

公司在业务开展中不能保证公司的专有技术、商业秘密、专利或集成电路布图设计不被盗用或不当使用，不排除被监管机构宣告无效或撤销，同时亦不排除与竞争对手产生其他知识产权纠纷，此类纠纷会对公司的业务开展产生不利影响。此外，公司亦不排除未能及时对临近保护期限的知识产权进行续展的风险。同时，公司在全球范围内销售产品，不同国别、不同的法律体系对

知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，并随之影响业务开展。

(五) 行业风险

适用 不适用

1、行业竞争风险

近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及智能装备制造、物联网、新能源等新兴领域的兴起，国内对半导体产品的需求迅速扩大，推动了行业的快速发展，也吸引了国内外企业进入市场，竞争日趋激烈。一方面，国内半导体企业数量不断增加；另一方面，国外领先的半导体企业对中国市场日益重视。在日趋激烈的市场竞争环境下，如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能与服务质量、降低成本与优化营销网络，则可能导致公司产品失去市场竞争力，从而对公司持续盈利能力造成不利影响。

2、产业政策变化风险

半导体产业作为信息产业的基础，是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司的经营业绩将会受到不利影响。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

1、新冠肺炎疫情相关的风险

2020年，新冠肺炎疫情在全球范围蔓延。受疫情影响，全球经济面临较大下行压力，国内消费电子等半导体终端行业的发展也受到疫情影响；由于目前全球新冠疫情仍未结束，对半导体行业上下游仍可能存在系统性影响的风险，进而对公司的经营造成一定影响。

2、国际贸易摩擦风险

在全球贸易保护主义抬头的大背景下，未来国际贸易政策存在一定的不确定性。公司部分产品出口境外地区，亦有部分设备、原材料从境外进口。如果全球贸易摩擦进一步加剧，境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营可能会受到不利影响。

3、汇率波动风险

人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，并受政治、经济形势的变化以及中国外汇政策等因素的影响。2015年8月，中国人民银行更改了人民币兑换美元中间价的计算方式，要求做市商在为参考目的提供汇率时考虑前一日的收盘即期汇率、外汇供求情况以及主要货币汇率的变化。本公司难以预测市场、金融政策等因素未来可能对人民币与美元汇率产生的影响，该等情况可能导致人民币与美元汇率出现更大幅度的波动。本公司的销售、采购、债权及债务均存在以外币计价的情形，因此，人民币汇率的波动可能对本公司的流动性和现金流造成不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

1、本公司的公司治理结构与适用境内法律、法规和规范性文件的上市公司存在差异的法律风险

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司。根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号）的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。本公司注册地法律法规对当地股东和投资者提供的保护，可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异。公司的公司治理制度需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，与目前适用于注册在中国境内的一般A股上市公司的公司治理模式在资产收益、参与重大决策以及剩余财产分配等方面存在一定差异。

2、控股股东控制的风险

目前公司控股股东 CRH (Micro) 处于绝对控股地位，股东大会拥有绝大多数的表决权，因此投资者可能无法实际影响发行人重大事务的决策。如果 CRH (Micro) 利用其控股地位，通过董事

会、股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会损害公司及其他股东的利益，使公司面临大股东控制的风险。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 697,725.92 万元，较上年同期增长 21.50%；实现利润总额 108,565.21 万元，较上年同期增长 114.58%；实现归属于母公司所有者的净利润 96,366.16 万元，较上年同期增长 140.46%；报告期末公司总资产 1,653,249.58 万元，较期初增长 63.76%；归属于母公司所有者权益为 1,058,278.79 万元，较期初增长 95.14%。

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 123,447.51 万元，同比增长 21.50%，主要系因功率器件事业群和代工事业群营业收入增加。

2、报告期内，公司整体毛利率较上年同期增长 4.63 个百分点，主要系因公司单位成本下降、产品获利能力好于上年同期。

3、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 56,290.61 万元，同比增长 140.46%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 64,683.62 万元，同比增长 313.52%，主要系因公司营业收入同比增长 21.50%、同时制造与服务业务板块产能利用率提升较大、毛利率提升 4.63 个百分点。

4、报告期内，公司研发费用 56,607.80 万元，同比增长 17.29%，公司新增境内专利申请 319 项，PCT 国际专利申请 54 项，境外专利申请 43 项；公司新增获得授权专利 215 项。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,977,259,188.03	5,742,784,130.70	21.50
营业成本	5,060,613,153.05	4,431,294,665.43	14.20
销售费用	105,956,728.87	112,019,905.06	-5.41
管理费用	369,922,286.94	376,840,527.92	-1.84
研发费用	566,077,973.66	482,615,725.08	17.29
财务费用	-119,929,609.61	30,994,340.79	-486.94
经营活动产生的现金流量净额	1,832,059,827.37	576,258,618.29	217.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,266,720,109.63	-40,714,050.22	3,011.26
筹资活动产生的现金流量净额	4,452,881,242.63	-179,647,917.03	-2,578.67

说明：

1、报告期内，公司财务费用为-1.2 亿元，比去年同期下降 486.94%。主要系因汇兑收益上升 9,761 万元，利息收入上升 5,005 万元。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 217.92%，主要系因市场景气度较高，客户回款较好。

3、报告期内，公司投资性活动产生的现金净流出比去年同期增加较多，主要系因 2019 年华润集团归还公司集中管理资金导致投资性现金流入增加 11.7 亿元。

4、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加较多，主要系因公司上市募集资金 42.36 亿元。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司主营业务收入 69.32 亿元，营业成本 50.34 亿元，分别比上年上升 21.62% 及 14.61%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
集成电路	6,931,629,010.75	5,033,555,125.02	27.38	21.62	14.61	增加 4.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
产品与方案	3,104,247,115.91	2,146,276,973.62	30.86	23.40	20.99	增加 1.38 个百分点
制造与服务	3,827,381,894.84	2,887,278,151.40	24.56	20.22	10.28	增加 6.8 个百分点
合计	6,931,629,010.75	5,033,555,125.02	27.38	21.62	14.61	增加 4.44 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	5,727,976,448.09	4,141,218,388.71	27.70	22.36	14.34	增加 5.11 个百分点
境外	1,203,652,562.66	892,336,736.31	25.86	18.26	15.87	增加 1.53 个百分点
合计	6,931,629,010.75	5,033,555,125.02	27.38	21.62	14.61	增加 4.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
产品与服务	亿颗	274.25	271.46	42.76	47.86	44.16	6.99
封装服务	亿颗	51.23	51.85	2.29	29.81	29.74	-10.82
晶圆制造	万片	172.25	176.62	5.14	12.48	15.67	-45.94
掩膜制造	万块	4.88	4.59	0.53	11.12	7.10	112.48

产销量情况说明

- 1、产品与服务生产量与销售量同比上升较大，主要系因市场景气度较好，公司接受到的订单比较饱满。
- 2、晶圆制造库存同比下降 45.94%，主要系因 2019 年度市场景气度较低，公司积累了较多库存。2020 年度市场转好，客户需求量激增，库存下降明显。
- 3、掩膜制造库存同比上升 112.48%，主要系因市场较好，客户积极推新品，公司产线在制产品数量急剧增长，产能供不应求，导致整套产品交付周期边长，库存增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比	情况 说明

集成电路	生产成本	5,033,555,125.02	100.00	4,392,072,459.68	100.00	14.61	无
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路	直接材料	1,747,968,857.25	34.72	1,364,418,807.47	31.07	28.11	无
集成电路	直接人工	1,028,729,461.34	20.44	892,620,848.02	20.32	15.25	无
集成电路	动力	540,460,875.16	10.74	522,925,119.79	11.91	3.35	无
集成电路	折旧	589,852,493.05	11.72	618,178,249.29	14.07	-4.58	无
集成电路	维护	449,113,641.27	8.92	434,240,368.55	9.89	3.43	无
集成电路	其他制造费用	677,429,796.95	13.46	559,689,066.56	12.74	21.04	无
集成电路	合计	5,033,555,125.02	100.00	4,392,072,459.68	100.00	14.61	无

成本分析其他情况说明

2020 年度公司直接材料成本同比上升较大，主要系材料成本占比高的产品生产较多所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 76,745.81 万元，占年度销售总额 11.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户 A	21,143.09	3.05
2	客户 B	14,811.28	2.14
3	客户 C	14,412.17	2.08
4	客户 D	13,267.50	1.91
5	客户 E	13,111.77	1.89
合计	/	76,745.81	11.07

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

说明：与上年同期比，有一家客户新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 63,383.59 万元，占年度采购总额 14.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	供应商 A	23,212.91	5.30
2	供应商 B	13,728.80	3.14
3	供应商 C	11,652.07	2.66
4	供应商 D	7,547.32	1.72

5	供应商 E	7,242.49	1.65
合计	/	63,383.59	14.48

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

说明：与上年同期比，有一家供应商新进入前五大供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期	上年同期	变动比例 (%)
销售费用	105,956,728.87	112,019,905.06	-5.41
管理费用	369,922,286.94	376,840,527.92	-1.84
研发费用	566,077,973.66	482,615,725.08	17.29
财务费用	-119,929,609.61	30,994,340.79	-486.94

2020 年度公司财务费用为-1.2 亿元，比去年同期下降 486.94%。主要系因汇兑收益上升 9,761 万元，利息收入上升 5,005 万元。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期	上年同期	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,832,059,827.37	576,258,618.29	217.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,266,720,109.63	-40,714,050.22	3,011.26
筹资活动产生的现金流量净额	4,452,881,242.63	-179,647,917.03	2,578.67

其他说明：

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 217.92%，主要系因市场景气度较好，客户回款较好。

2、报告期内，公司投资性活动产生的现金净流出比去年同期增加较多，主要系因 2019 年度华润集团归还公司集中管理资金导致投资性现金流入增加 11.7 亿元。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加较多，主要系因公司上市募集资金 42.36 亿元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期	上期期末数	上期期	本期期末金	情况
------	-------	-----	-------	-----	-------	----

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	额较上期期 末变动比例 (%)	说明
货币资金	6,865,693,381.17	41.53	1,930,674,620.44	19.12	255.61	
交易性金融资产	901,191,461.19	5.45	507,535,344.46	5.03	77.56	
应收账款	966,048,018.34	5.84	815,007,869.96	8.07	18.53	
存货	1,269,232,933.71	7.68	1,054,762,850.60	10.45	20.33	
长期股权投资	190,508,576.87	1.15	81,713,330.37	0.81	133.14	
固定资产	4,366,803,258.91	26.41	3,815,745,162.11	37.80	14.44	
应付账款	1,052,826,675.67	6.37	748,638,825.07	7.42	40.63	
应付职工薪酬	445,693,342.74	2.70	310,209,180.39	3.07	43.68	
其他应付款	943,310,435.86	5.71	535,826,262.58	5.31	76.05	
长期借款	1,442,242,704.86	8.72	1,506,112,961.12	14.92	-4.24	

其他说明

1、报告期内，货币资金大幅上升，主要系因 2020 年初上市募集资金 42.36 亿元，截止 2020 年末尚有 30.73 亿元未使用。

2、报告期内，交易性金融资产同比上升 77.56%，主要系因结构性存款上升。

3、报告期内，长期股权投资同比上升 133.14%，主要系因公司对润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的长期股权投资额增加了 1.07 亿元。

4、报告期内，应付账款同比上升 40.63%，主要系因市场景气度较高，公司业绩大幅提升，材料备货增加使得应付账款增加。同时，也受到东莞杰群纳入公司合并财务报表的影响。

5、报告期内，应付职工薪酬同比上升 43.68%，主要系因 2020 年度效益较好，年底计提奖金较多。

6、报告期内，其他应付款上升 76.05%，主要系因应付华润集团往来增加 2 亿元，应付固定资产款增加 0.92 亿元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,009,236.75	开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证金
固定资产	104,621,327.23	固定资产抵押借款
合计	126,630,563.98	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司行业经营性信息分析，详见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

见如下情况说明。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目	报告期末投资额	上年期末投资额	变动幅度 (%)
润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,860.00	8,200.00	130.00

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	507,535,344.46	901,191,461.19	393,656,116.73	1,191,461.19
应收款项融资	484,906,398.42	525,446,921.08	40,540,522.66	
合计	992,441,742.88	1,426,638,382.27	434,196,639.39	1,191,461.19

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 主要子公司：

子公司全称	主要经营地	业务	注册资本	持股比例 (%)
无锡华润上华科技有限公司	江苏无锡	晶圆制造	66801.147 万美元	100
华润微集成电路（无锡）有限公司	江苏无锡	IC 设计	12499.3178 万人民币	100
无锡华润安盛科技有限公司	江苏无锡	封装测试	4 亿人民币	100

华润赛美科微电子(深圳)有限公司	广东深圳	封装测试	1380 万美元	100
无锡华润华晶微电子有限公司	江苏无锡	分立器件	3.35 亿人民币	99.662
华润微电子(重庆)有限公司	重庆	分立器件	19.892 亿人民币	52.69
杰群电子科技(东莞)有限公司	广东东莞	封装测试	8,811.66 万美元	70

报告期内, 主要子公司的主要财务数据如下:

单位: 万元

子公司全称	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡华润上华科技有限公司	649,345.65	341,023.61	343,294.87	51,020.16
华润微集成电路(无锡)有限公司	55,318.51	26,196.92	51,660.31	1,572.46
无锡华润安盛科技有限公司	84,024.60	51,723.47	82,969.84	7,487.85
华润赛美科微电子(深圳)有限公司	26,891.99	11,809.78	18,615.62	692.45
无锡华润华晶微电子有限公司	96,257.55	57,283.02	107,343.24	6,374.78
华润微电子(重庆)有限公司	267,139.21	205,549.93	139,010.26	25,447.09
杰群电子科技(东莞)有限公司	71,118.18	45,132.37	61,767.75	3,105.41

2、 主要参股公司:

公司名称	主要经营地	注册地	业务	表决权比例(%)	会计处理方法
润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资基金	27.4248	权益法

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局和发展趋势

全球集成电路行业市场规模大且保持较快增长。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计, 2020 年全球半导体市场销售额为 4,390 亿美元, 同比增长了 6.5%。根据 IBS 数据, 未来五年, 半导体行业将迎来一波快速增长, 预计 2022 年市场规模突破 5,000 亿美元, 2024 年将达到 6,060 亿美元。到 2030 年, 全球集成电路产业规模预计达到 1 万亿美金。

我国本土半导体行业起步较晚。但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下, 中国半导体行业不断发展。步入 21 世纪以来, 我国半导体产业市场规模得到快速增长。根据海关统计, 2020 年中国进口集成电路 5,435 亿块, 同比增长 22.1%; 进口金额 3,500.4 亿美元, 同比增长 14.6%。

2020 年中国集成电路出口 2,598 亿块,同比增长 18.8%,出口金额 1,166 亿美元,同比增长 14.8%。整体来看,半导体市场增长前景可观,我国集成电路自给率仍较低,依然有很大的成长空间。

我国由于疫情控制较好,2020 年 GDP 实现了 2.3% 的增长,首次突破 100 万亿元,达到了 101.6 万亿元。在中国经济增长的带动下,中国集成电路产业继续保持快速增长态势。据中国半导体行业协会统计,2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元。其中,设计业销售额为 3,778.4 亿元,同比增长 23.3%;制造业销售额为 2,560.1 亿元,同比增长 19.1%;封装测试业销售额 2,509.5 亿元,同比增长 6.8%。半导体行业发展面临机遇,也面临挑战,需要在全球范围内加强合作,共同打造半导体行业产业链,实现更加健康和可持续的发展。随着 5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR 等新一轮科技逐渐走向产业化,未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期,逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位,公司也将充分受益于集成电路行业发展,受益于进口替代、半导体产业自主可控等历史性机遇。

展望 2021 年,国际宏观环境仍然非常复杂,新冠肺炎疫情全球蔓延趋势不减,全球经济增长依然存在不确定性,但同时全球集成电路的供应链和产能紧缺预计将至少持续到 2021 年上半年度。根据各市场研究公司 Gartner、IBS、IC Insights 等近期发布的最新预测,2021 年全球半导体行业整体增速预计将达到 11% 左右。全球经济增长的趋势和国际经贸政策的变化情况以及新冠疫情的演进方向仍存在一定的不确定性,将直接影响到半导体产业的景气情况。

从终端应用来看,疫情之下,居家消费电子产品如智能设备、穿戴设备等销售提振,远程工作和在线访问需求的增加,数据中心建设和通信基础设施建设将加快,这些将抵消一部分因智能手机和消费类电子下降的影响。同时,国内疫情缓解,工厂产能恢复,给国内厂商带来供应链重塑的机会。在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下,加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度,中国半导体行业发展迎来了历史性的机遇。

2、公司面临发展的战略机遇期

集成电路产业是国民经济支柱性行业之一,其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一,属于国家高度重视和鼓励发展的行业。自 2000 年以来,我国政府将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一,为鼓励和支持我国集成电路产业的发展,国家相关部委出台了一系列支持和引导半导体行业发展的政策法规。2014 年 6 月,国务院下发了《国家集成电路产业发展推进纲要》(以下简称《纲要》)。《纲要》明确提出:“集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期”,“应充分发挥市场优势,营造良好发展环境,激发企业活力和创造力,带动产业链协同可持续发展,加快追赶和超越的步伐,努力实现集成电路产业跨越式发展”,“为经济发展方式转变、国家安全保障、综合国力提升提供有力支撑”。《纲要》还提出要“设立国家产业投资基金。重点支持集成电路等产业发展,促进工业转型升级。”2016 年,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项政策的出台为半导体行业的发展提供了政策保障,进一步明确了发展方向。国家相关政策的陆续出台从战略、资金、专利保护、税收优惠等多方面推动半导体行业健康、稳定和有序的发展。2020 年 8 月 4 日,国务院颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施,进一步优化半导体产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量。坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面,并成为社会各界关注的重点产业。国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇,预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。

公司是华润集团半导体投资运营平台,始终以振兴民族半导体产业为己任,曾先后整合了华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体先驱。公司及下属相关经营主体曾建成并运营中国第一条 4 英寸晶圆生产线与第一条 6 英寸晶圆生产线,承担了多项国家重点专项工程。经过多年发展及一系列整合,公司已成为中国本土具有重要影响力的综合性半导体企业,自 2004 年起连续多年被工信部评为中国电子信息百强企业。公司是中国本土领先的以 IDM 模式为主经营的半导体企业,同时也是中国最大的功率器件企业之一。经过多年发展及一系列整合,公司是日前国内领先的运营完整产业链的半导体企业,基于此优势,公司正逐步向综合一体化半导体产品公司转型发展,矢志成为中国半导体行业的领军企业,并最终成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。未来公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源，不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型，矢志成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。

公司将立足现有基础，进一步聚焦于功率半导体及智能传感器等广泛应用于新经济领域的半导体产品，通过技术创新保持在业内的领先优势，同时深耕进口替代的中国市场机会，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，保持、巩固并提升公司现有的市场地位和竞争优势。

鉴于半导体行业是人才、技术和资金密集型的行业，行业的发展以研发设计能力、技术创新能力、先进制造能力和综合管理能力为主要驱动因素，公司顺应前述行业发展的驱动因素，密切关注中国及全球市场需求，从产品能力、研发投入、行业整合、对外合作以及资源协同等方面制定发展战略，以优化公司现有产品结构，提升公司的核心技术研发能力，为公司在巩固现有细分市场领先优势的同时，不断拓宽公司的业务领域，实现长期可持续发展奠定良好的基础。具体规划措施如下：

1、紧跟应用前沿，丰富产品体系

针对绿色环保、高效节能、智能便携等社会需求，以及新基建、大消费、大数据、5G 等热点应用领域，结合功率器件产品技术发展路径，公司将加大技术创新与产品突破，加强功率器件先进封装研发能力和资源配置，加强模块产品研发能力和资源配置。

公司积极在“电机+电池+电源”应用领域布局，实现细分市场领先以及高端应用领域突破。同时，公司还将在工业控制类细分市场中寻求更大的提升，并在汽车电子领域内从周边产品逐步向核心产品拓展，提升工业控制与汽车电子领域的市场业务。

2、持续加大研发投入、提升核心技术能力

公司将通过更加有效的资源配置，通过建设自身的研发体系、加强研发投入、加强对外科技合作、加强高校科技成果转化来整体部署科技研发。公司在研发方面会持续投入资源，以加强公司核心技术的能力，全面提升产品组合的技术竞争力。此外，公司会加强与国际先进水平的合作，积极探索与拥有核心技术的国内外团队的合作，共同推进先进技术的产业化。

公司将以 6 英寸产线为基础，充分利用 8 英寸产线的技术优势进行基础工艺技术开发及产品系列化研发，推进 GaN、SiC 等宽禁带器件产品研发与生产，深化产品技术研发和应用匹配，实现宽禁带器件产品的产业化，形成差异化竞争优势。

3、强化半导体全产业链一体化运营能力

为巩固公司在功率半导体领域的领先地位，公司将进一步完善内部一体化的运营能力，积极布局长三角，成渝双城，粤港澳大湾区，实现协同发展。

公司将集中整合现有功率半导体封测资源，围绕标准功率半导体产品、先进面板级功率产品、特殊应用的功率半导体产品三大工艺平台，覆盖消费电子、工业控制、汽车电子、5G、AIOT 等新基建领域，以巩固并进一步提升公司在功率半导体领域的领先地位。

除了通过内生发展的方式提高运营能力外，公司还将通过并购整合的方式提高产业链各环节的运营能力。公司将利用制造资源的优势，并购整合具有技术优势的功率半导体及智能传感器产品公司，提高公司的产品规模实现业务的跨越式发展。

此外，通过和国产设备及材料厂商的紧密合作，形成以国产设备、国产材料为主的产品验证平台，推动国产设备和材料技术提升的同时，保证自身的供应链安全。

4、持续吸纳和培养人才、建设一流团队

公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员的知识背景、研发能力及操作经验积累均有较高要求。杰出和具有丰富经验的人才是公司未来发展的关键，因此公司会在多个方面持续吸纳和培养人才，建设一流的团队，为公司发展打下坚实基础。

在人才管理方面，公司将采取积极的人才引进机制，根据公司战略目标及业务需求，引进行业领军人才，中高端技术人才，打造公司核心技术团队。同时根据公司战略发展方向，对管理团队进行优化并组织开展梯队建设工作，持续完善管理团队。在人才培养方面，以多种方式培养锻

炼技术人才，为科技人才的快速成长提供发展路径。同时加大与国内高校建立校企合作关系，建立实训基地，联合培养人才。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、积极推进上市公司股权激励

公司已于 2020 年 12 月将采用第二类限制性股票的股权激励方案报国资委进行审批，并将积极推进上市公司股权激励方案。公司希望股权激励方案能将员工利益与公司发展深度捆绑，激发员工的主人翁精神。

2、加大核心技术的研发投入

公司将充分利用全产业链的优势，继续在功率半导体和智能传感器两大技术领域不断强化研发投入，培育优势产品和技术，一方面积极推进前瞻性研发项目的实施，以拓展新的市场增长空间，另一方面深耕现有产品和市场，通过技术研发手段，不断完善产品和技术型谱，提高产品和技术的市场覆盖面，满足客户和市场对产品多样化的需求，同时推进产品和技术的更新换代，巩固和提升产品、技术的竞争优势。

宽禁带半导体材料的功率器件设计开发及工艺技术研究方面，加快推动 SiC 技术平台产业化，在现有 SiC 肖特基二极管产品市场拓展的基础上，研发新一代的 SiC 肖特基二极管产品，完善产品型谱，同时加快 SiC MOSFET 产品的设计开发和工艺技术能力建设；推动氮化镓 MOCVD 外延技术能力的建设，持续开展硅基氮化镓功率器件的研发工作，已启动 8 吋硅基氮化镓功率器件产品研发工作，将适时启动产业化工作。

产品开发与系列化方面，通过技术平台升级、产品开发迭代、特色工艺技术开发、新材料器件研发，不断提升产品性能和可靠性，积极切入工控类和汽车电子等高端应用领域，通过成立汽车电子专项小组实施专项攻关，努力实现车规级产品质的突破，进入汽车电子核心应用。

针对 MOSFET 产品，积极推进中低压 MOSFET 的工艺技术开发与产品研发，加快技术迭代与创新，保持并扩大中低压 MOSFET 产品竞争优势；加快高压超结 MOSFET 产品规模化推向市场，推动平面高压 MOSFET 第七代产品的快速上量，延长产品生命周期，提高平面高压 MOSFET 产品竞争力。

针对 IGBT 产品，公司将加大 IGBT 工艺技术和产品研发投入，持续推进 6 英寸平台技术升级，加快 8 英寸产品系列化与上量，推动产品模块化及上量，同期开发高电压段的 IGBT 和 FRD 产品，应用于智能电网等高端应用领域，通过拓展产品应用领域，扩大 IGBT 产品的市场影响力及占有率。

针对成熟工艺平台产品，公司将持续推进成本降低及工艺技术稳定，加大肖特基 SBD 芯片电源类通用产品和光伏产品模块化探索，扩大销售规模，提升盈利能力。

针对功率 IC 产品，公司将利用超高压 BCD 工艺技术和一体化优势，进一步丰富 LED 驱动、锂电管理、开关电源和无线充电的产品组合及相关产品性能。积极推进单片智能功率集成电路、基于 GaN 的 PD 电源控制芯片开发和智能电网应用等产品的研发工作；同时加快 BCD 先进工艺平台升级和 600V SOI 工艺平台产品的研发和试产。

针对智能控制产品，公司将聚焦电机驱动、LED 调光领域，推进智能功率 IPM 模块产品系列化并逐步上量，加快单芯片集成 SOI 模块的客户验证进度；MCU 产品从 8 位产品向 32 位产品发展，全方位匹配其他功率及驱动产品，实现产品升级。

针对传感器产品，公司将拓展 8 英寸 MEMS 硅麦产品并研发新一代高性能压力和温湿度传感器，独立烟雾报警传感器实现系统化方案，光电传感器深耕电源、工业仪表细分市场。同时公司将利用现有的制造资源和能力，加大对外投资，加强公司在自主传感器产品的布局。

3、外延式扩张

公司将围绕整体战略，持续关注外延式扩张机会，锁定目标集中在功率半导体和智能传感器产品公司，以及能够快速提升公司产品与客户层次的制造资源，通过对外合作、收购兼并和股权投资等多种发展路径，利用成功的整合经验，最大程度发挥协同效应，借助资本市场优势进一步增强资本实力，为公司实践战略规划与实现跨越式发展带来有力的支持，增强公司的核心竞争力，提升长期盈利能力，创造更多的经济效益与社会价值。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配政策的制定、调整情况：

根据上海证券交易所 2013 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》相关条款，2019 年 4 月 24 日经公司股东会特别决议通过了《章程》的第一百三十七条、第一百三十八条的修订。公司于 2019 年 4 月 30 日召开第一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，该议案于 2019 年 5 月 16 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 10 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》，该议案于 2020 年 11 月 5 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、利润分配执行情况：

报告期内，公司严格遵循公司《章程》利润分配政策。

3、本年度利润分配方案预案：

公司 2020 年度利润分配预案：公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7373 元（含税），预计派发现金红利总额为 97,330,372.91 元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.10%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对利润分配预案进行审议并出具了同意的独立意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配预案作出决议后，公司董事会须在股东大会结束后 2 个月内完成股利的派发事项。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0.7373	0	97,330,372.91	963,661,634.37	10.10
2019 年	0	0.3300	0	40,125,531.44	400,755,536.42	10.01
2018 年	0	0.0000	0	0	429,441,345.91	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履

					行期限	严格履行	说明未完成履行的具体原因	行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东	详见备注 1	2020 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人	详见备注 2	2020 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、非独董、高管	详见备注 3	2020 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、非独董	详见备注 4	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董事、高管	详见备注 5	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 6	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	详见备注 7	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	详见备注 8	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	详见备注 9	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 10	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 11	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 12	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见备注 13	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东	详见备注 14	长期有效	否	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	其他	公司	详见备注 15	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、董事、高级管理人员	详见备注 16	长期有效	否	是	不适用	不适用

		员						
	其他	公司	详见备注 17	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	详见备注 18	长期有效	否	是	不适用	不适用

备注1

控股股东承诺

- 1、本公司持续看好公司及所处行业的发展前景，拟长期持有公司股份。
- 2、自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。
若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。
- 3、本公司所持发行人股票在上述三十六个月的锁定期满后，如果届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本公司减持行为有任何规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。
- 4、发行人作为红筹企业于科创板上市，如果法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对红筹企业的股东减持行为做出特别规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。
- 5、本公司承诺，若本公司所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长6个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
- 6、本公司减持本公司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，由上海证券交易所予以备案。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：
 - (1) 不存在违反本公司在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；
 - (2) 若发生需本公司向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。
- 7、本公司同时将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。
- 8、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

备注2

实际控制人承诺

- 1、自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份。
若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。
- 2、本公司直接和间接持有的发行人股票在上述三十六个月的锁定期满后，如果届时相关法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对于本公司减持行为有任何规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。

- 3、发行人作为红筹企业于科创板上市，如果法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求对红筹企业的股东减持行为做出特别规定，则本公司承诺相关减持安排将严格遵守该等法律法规、规范性文件及证券监管机构的有关要求。
- 4、本公司同时将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（上证发[2019]22号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述规定被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。
- 5、本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

备注3

公司、控股股东、非独董、高管承诺

启动股价稳定措施的具体条件

发行人上市后三年内，如发行人股票收盘价格连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”）且同时满足监管机构对于增持或回购发行人之股份等行为的规定，则发行人及相关主体应按预案启动稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。

本人/本公司将严格执行公司《公司稳定股价的预案》及本承诺函中关于稳定公司股价的相关措施。如有违反，将承担相应法律责任。

若前述规定被修订、废止，本人/本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求采取相关措施。

备注4

公司、控股股东、实际控制人承诺

1、本公司保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

非独董承诺

1、发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将督促发行人在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

3、如发行人存在欺诈发行行为，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或各方协商确定的金额为准。

4、本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求采取相关措施。

备注5

公司承诺

本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

控股股东、实际控制人承诺

本公司将不会越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的。

本承诺函出具日后，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司承诺全面、完整、及时履行上述承诺。若本公司违反上述承诺，给发行人或股东造成损失的，本公司愿意：（1）在股东大会及中国证券监督管理委

员会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对发行人及其股东造成的损失；（3）无条件接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。

全体董事、高管承诺

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若发行人后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任；

7、本承诺函出具之日后，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺全面、完整、及时履行上述承诺。若本人违反上述承诺，给发行人或股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对发行人及其股东造成的损失；（3）无条件接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

备注6

公司承诺

本公司承诺，在本次发行完成后将严格按照《经修订及重列组织章程大纲及章程细则》的相关规定执行股利分配政策。

备注7

控股股东、实际控制人承诺

1、本公司及本公司控制的其他企业不存在非经营性地占用发行人的资金、资产的情形。

2、本公司及本公司控制的其他企业与发行人发生的经营性资金往来中，将严格按照中华人民共和国相关法律、行政法规的规定严格限制占用发行人资金、资产；并按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的约定，严格履行批准程序。

3、本公司及本公司控制的其他企业不滥用控股股东/实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产；在任何情况下，不要求发行人违规向本公司及所控制的其他企业提供任何形式的担保。

4、本公司控制的其他企业也将严格遵守上述声明与承诺。如因违反上述声明与承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

备注8

控股股东、实际控制人承诺

1、在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及关联企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易。

2、不利用本公司控制地位及重大影响，谋求发行人及其控制的其他企业在业务合作等方面给予本公司及本公司所控制的其他企业或从本公司及本公司控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。

3、本公司保证按照法律法规及发行人公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动、不非法侵占发行人利益。

4、本公司及所控制的其他企业将尽量避免与发行人及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与发行人及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司保证：

(1) 督促发行人按照有关法律和发行人公司章程和相关制度的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行有关关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事发表意见的程序；

(2) 本公司及关联企业将与发行人依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和发行人公司章程的规定履行批准程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与发行人进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；

(3) 根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和发行人公司章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；

(4) 本公司保证不会利用关联交易转移发行人的资金、利润，不通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。

5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给发行人造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。

备注9

控股股东、实际控制人承诺

1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属企业的主营业务相竞争的业务。

2、本公司及本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）将不会以任何形式直接或间接从事与发行人及其下属企业的主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动。

3、如本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）获得与发行人及其下属企业的主营业务存在或可能存在竞争的业务机会，本公司将书面通知发行人，若在通知中所指定的合理期间内，发行人做出愿意接受该业务机会的书面答复，本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其下属企业。

4、若监管机构认为本公司或本公司的下属企业（发行人及其下属企业除外）从事上述业务与发行人或其下属企业的主营业务构成同业竞争或发行人或其下属企业拟从事上述业务的，本公司将采取法律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）进行解决。

5、本公司承诺不以发行人控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。

6、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本公司不再是发行人的控股股东/实际控制人；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）股票上市地法律、法规及规范性文件的规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制50%或以上已发行的股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格）。

7、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，给发行人造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。

备注10

公司承诺

本公司承诺，自本承诺函出具之日起至本公司股票在上海证券交易所上市期间，本公司将严格遵守相关内控制度，保持公司财务独立，避免控股股东以任何形式占用本公司资金。

如出现本公司未能履行上述承诺的情形并导致本公司投资者的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给本公司投资者造成的实际损失。若本公司未能充分赔偿或补偿由此给本公司投资者造成的实际损失，本公司将依据华润股份有限公司、华润（集团）有限公司《关于资金集中管理安排事项の確認》要求其提供现金足额补偿，直至因未履行上述承诺事项所产生的不利影响全部消除及本公司实际履行上述承诺事项为止。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。

备注11

公司承诺

- 1、发行人将根据《开曼群岛公司法》等适用法律、法规和规范性文件（含境内监管要求）的规定，依法对现行《公司章程》进行必要修订，以保证其合法有效，进而保证《公司章程》中关于发行人股东有权在中国境内法院提起诉讼的相关条款持续合法有效。
- 2、若发生任何可能限制投资者根据发行人现行《公司章程》第二十八条及第二十九条的规定将相关诉讼提交中国法院管辖的权力的重大事项，发行人将依法及时向投资者进行披露，并承诺及时解决。
- 3、若本公司违反中国法律、行政法规或公司章程规定且给股东造成损失的，本公司将依法承担相应赔偿责任。中国境内投资者有权以自己的名义在有管辖权的中国法院针对本公司启动法律程序，且本公司承诺不会就此提出管辖权异议。
- 4、若本公司在中国境内发生与投资者就本次发行上市及股东于持股期间的股东权益相关之诉讼，本公司承诺投资者有权依据合法有效的生效法律文书对本公司位于中国境内的财产采取财产保全措施。若中国法院作出有利于投资者的针对本公司的生效法律文书，本公司将主动履行；若本公司未及时、完全履行前述生效法律文书，本公司承诺投资者有权依据届时的生效法律文书向有管辖权的中国法院申请对本公司位于中国境内的财产采取强制执行措施。

备注12

公司承诺

- 1、本公司确认，在获得证监会同意本次发行注册申请的批复后，将根据有关规定到上海证券交易所所在地国家外汇管理局上海分局办理登记。凭国家外汇管理局签发的资本项目业务登记凭证，本公司将按规定在一家境内商业银行开立账户，并通过该账户开展在境内发行股票有关的分红、派息、配股等相关资金的收付和汇兑事项。
- 2、本公司承诺，将在上市后尽快落实投资者关系管理制度的具体实施，在公司网站中设立投资者关系管理专栏，履行相关信息披露工作，及时接受投资者的咨询、投诉和建议，处理与投资者的纠纷、争议，以确保投资者可优先以便利的方式维护其权益。

备注13

公司承诺

- 1、本公司注册地的立法机关、政府部门或其他监管机构可能不时发布、更新适用于本公司的法律、法规或规范性文件，发行该等法律、法规或规范性文件可能对本公司产生实质影响，为此，本公司将持续在不违反其适用的注册地相关法律、法规或规范性文件的规定的前提下，参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，以确保本公司对境内投资者的权益保护持续不低于境内法律、行政法规以及中国证监会的要求。
- 2、本公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等证券交易所制定并公布业务规则，按时披露定期报告，并及时就可能对股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件披露临时报告，保障境内投资者的知情权。

备注14

公司、控股股东承诺

- 1、华润微电子的股份溢价金额（包括但不限于华润微电子本次在上海证券交易所科创板首次公开发行股票以及华润微电子股票在上海证券交易所上市期间形成的任何股份溢价）将不用于向投资者进行股利分配。
- 2、华润微电子募集资金的使用将严格遵守科创板及 A 股资本市场关于募集资金管理的相关制度以及华润微电子制定的《募集资金管理制度》，华润微电子不得变更或以任何方式变相变更募集资金的用途用于向投资者进行股利分配。
- 3、华润微电子募集资金用于补充营运资金的金额不得用于向投资者进行股利分配。

备注 15

公司承诺

公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），就不影响和干扰本次发行的审核及注册程序向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会作出如下承诺：

- 1、在本次发行申请期间，本公司保证不直接或间接地向科创板发行审核机构和中国证券监督管理委员会的相关人员提供资金、物品等馈赠及其他利益，保证不直接或间接地向科创板发行审核机构和中国证券监督管理委员会的相关人员提供本次所核准的申请发行的股票，保证不以不正当手段影响科创板股票发行审核机构人员对本公司的判断。
- 2、本公司保证不以任何方式干扰科创板发行审核机构的审核工作和中国证券监督管理委员会的注册程序。
- 3、在接受审核问询时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内容。
- 4、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。

备注 16

公司承诺

公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），公司编制了《China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（下称“募集说明书”）及其他相关申请文件。就本次发行的募集说明书等申请文件的真实性、完整性、准确性，公司承诺如下：

1. 公司本次发行的募集说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2. 若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司本次发行的募集说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本次发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。
3. 若在本次发行的股票上市流通过后，因公司本次发行的募集说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将依法及时回购本次发行的全部新股，回购价格为股票发行价格（指复权后的价格，如公司期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整），同时加算股票发行日至回购股份期间同期银行存款利息。
4. 如公司本次发行的募集说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者合法权益得到有效保护。
5. 上述承诺为不可撤销之承诺，公司严格履行上述承诺内容，如有违反，公司将承担由此产生的一切法律责任。

董事、高级管理人员承诺

公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），公司编制了《华润微电子有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（下称“募集说明书”）及其他相关申请文件。就本次发行的募集说明书等申请文件的真实性、完整性、准确性，公司的董事和高级管理人员承诺如下：

1. 公司本次发行的募集说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2. 如公司本次发行的募集说明书等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，确保投资者合法权益得到有效保护。
3. 上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司本次发行所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。

备注 17

公司承诺

公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 45 号——科创板上市公司发行证券申请文件》（中国证

券监督管理委员会公告[2020]39号），本公司严格按照该文件的要求制作了和书面原件一致的电子版申请文件。本公司保证报送上海证券交易所的电子版申请文件和书面原件一致，并保证该电子版申请文件真实、准确和完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。若本公司违反上述保证，本公司将承担相应的法律责任。

备注 18

公司承诺

鉴于公司拟申请 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（下称“本次发行”），公司为保护投资者利益，拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护中小股东利益，实现公司的可持续发展，增强公司持续回报能力。具体措施如下：

（一）保证本次募集资金合理规范有效使用

为保障公司规范、有效使用本次发行募集资金，公司将根据《开曼群岛公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。

（二）积极落实募集资金投资项目，助力公司业务做大做强

本次发行募集资金投资项目的实施，将有效地夯实公司业务发展基础，提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来有力保障。

本次发行募集资金到位后，公司管理层将大力加快募集资金投资项目的推进，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行摊薄股东即期回报的风险。

（三）大力发展主营业务，加强经营效率，降低运营成本，提升盈利能力

通过本次发行募集资金，有利于增强公司资金实力，并为给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。

（四）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制

公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《开曼群岛公司法》和公司章程的规定，结合公司实际情况，于公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于华润微电子有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》，对公司利润分配相关事项、未来分红回报规划做了明确规定，充分维护公司股东依法享有的获得股利和其他形式利益分配的权利，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项、未来分红回报规划的决策程序和机制。本次发行完成后，公司将严格执行现行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《开曼群岛公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

控股股东承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定的要求，作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司，以下简称“公司”或“华润微”）的控股股东，本企业现为保障华润微 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，承诺如下：

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

3、本承诺出具之日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相应处罚或采取相应监管措施。

实际控制人承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司，以下简称“公司”或“华润微”）的实际控制人，本企业现为保障华润微 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，承诺如下：

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

3、本承诺出具之日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相应处罚或采取相应监管措施。

董事、高级管理人员承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司，以下简称“公司”或“华润微”）的董事/高级管理人员，现为保障华润微 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，承诺如下：

1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、如公司未来制定股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

7、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照有关规定对本人作出相应处罚或采取相应监管措施。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

(1)经本公司管理层批准,自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号),并要求境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 12 月 31 日预收款项列示金额 0.00 元,合同负债列示金额 232,783,137.57 元; 2020 年 1 月 1 日预收款项列示金额 0.00 元,合同负债列示金额 111,627,094.45 元; 2020 年度影响营业成本 15,445,604.79 元,影响销售费用-15,445,604.79 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	200
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	0
财务顾问	无	/
保荐人	魏先勇、王健	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，公司 2019 年度实际发生的关联交易金额为 2,625.84 万元，在 2019 年度预计额度 3,960.20 万元范围内。公司 2020 年度预计发生的关联交易金额约为 6,570 万元。	http://www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，已发生的关联交易(不包括关键管理人员报酬)为 3,706.55 万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年8月14日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟转让矽磐微电子(重庆)有限公司股权的议案》,同意公司全资子公司华微控股将所持有的矽磐微电子195万美元股权和105万美元股权(分别占矽磐微电子总股本的6.5%和3.5%)分别以196.1505万美元等值人民币和105.6195万美元等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)对价转让给润科基金和珠海矽盛。	http://www.sse.com.cn

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年7月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司华微控股与华润深圳湾及清研院共同签署技术开发(合作)合同,合作进行无线电力传输技术与产品项目的研究开发,华微控股和华润深圳湾分别提供研究开发经费2,393万元,合同金额共计4,786万元。	http://www.sse.com.cn

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
杰群电子科技有限公司	控股子公司	卢超群	26,099,600.00	2017.04.28	2017.04.28	2021.02.08	连带责任担保	是	否	0	否	否	控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									26,099,600.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									26,099,600.00				
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
无锡华润微电子有限公司	全资子公司	华润矽威科技（上海）有限公司	全资子公司	20,000,000.00	2019.10.14	2019.10.14	2020.10.13	连带责任担保	否	否	0	否	
无锡华润微电子有	全资子公司	华润赛美科微电子（深圳）有限	全资子公司	20,000,000.00	2019.08.12	2019.08.12	2020.08.12	连带责任	否	否	0	否	

限公 司		公司							担 保				
报告期内对子公司担保发生额合计							25,326,388.42						
报告期末对子公司担保余额合计 (B)							11,196,109.37						
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)							37,295,709.37						
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.32						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							0.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							0.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)							0.00						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							0.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							<p>2020年9月,公司全资子公司华微控股收购东莞杰群70%股权,且在2020年9月末将东莞杰群的资产负债表纳入合并范围(属于非同一控制下的企业合并)。2017年4月,因卢超群向其东莞杰群相关银行贷款提供金额为400万美元的保证担保,作为反担保措施,东莞杰群向卢超群提供反担保,金额为400万美元,东莞杰群已于2021年2月8日解除前述反担保。</p> <p>公司全资子公司华润微集成电路(无锡)有限公司已于2020年10月15日召开董事会和股东会同意吸收合并全资子公司华润矽威科技(上海)有限公司和全资子公司华润半导体(深圳)有限公司,吸收合并日为2020年11月30日,吸收合并后,华润微集成电路(无锡)有限公司继续存续。</p>						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定	未来是否有委	减值准备计提
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	--------	--------	--------

											程序	托 理 财 计 划	金 额 (如 有)
中信银行	结构性存款	500,000,000.00	2019/12/27	2020/3/27	自有资金	中信银行结构性存款	保本浮动收益型	3.7%		4,612,328.77	已收回	是	否
中信银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/6/18	2020/7/24	自有资金	中信银行结构性存款	保本浮动收益型	3.2%		306,849.32	已收回	是	否
工商银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/7/2	2020/10/9	自有资金	工商银行结构性存款	保本浮动收益型	3.4%		1,844,383.56	已收回	是	否
工商银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/8/5	2020/11/18	自有资金	工商银行结构性存款	保本浮动收益型	3.45%		1,984,931.51	已收回	是	否
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/11/6	2020/12/7	自有资金	中信银行结构性存款	保本浮动收益型	2.6%		427,397.26	已收回	是	否
工商银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/11/9	2020/12/24	自有资金	工商银行结构性存款	保本浮动收益型	3%		369,863.01	已收回	是	否
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2020/12/9	2021/3/10	自有资金	中信银行结构性存款	保本浮动收益型	1.48%-3.2%		1,396,164.38	已收回	是	否
兴业银行	结构性存款	400,000,000.00	2020/12/10	2021/1/11	自有资金	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	1.5% 或 2.85% 或 2.93%		1,027,506.85	已收回	是	否
中信银行	结构性存款	100,000,000.00	2020/12/26	2021/2/25	自有资金	中信银行结构性存款	保本浮动收益型	1.48%-3.3%		484,657.53	已收回	是	否

	款													
工商 银行	结 构 性 存 款	200,000, 000.00	2020/ 12/30	2021/ 4/1	自 有 资 金	工 商 银 行 结 构 性 存 款	保 本 浮 动 收 益 型	1.3%-3 .4%		1,713 ,972. 60	已 收 回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		423,574.46				本年度投入募集资金总额			116,268.16			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			116,268.16			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00%										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	42,619.15	42,619.15	-107,380.85	28.41%	2021 年 6 月	不适用	是	否
前瞻性技术和产品升级研发项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	8,558.86	8,558.86	-51,441.14	14.26%	2023 年 1 月	不适用	是	否
产业并购及整合项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	28,752.60	28,752.60	-1,247.40	95.84%	2022 年 5 月	不适用	是	否
补充营运资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	36,337.55	36,337.55	-23,662.45	60.56%	不适用	不适用	是	否
超募资金投向产业并购及整合	否	123,574.46	123,574.46	123,574.46	0.00	0.00	-123,574.46	0.00%	不适用	不适用	是	否
合计	-	423,574.46	423,574.46	423,574.46	116,268.16	116,268.16	-307,306.30	27.45%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				针对“8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目”，受新冠肺炎疫情导致的停工停产影响，该项目相关建设活动有所放缓；同时，多国实行“封国”措施并管控进出口贸易活动，因此对于进口设备，公司无法实地对其进行考察验收或按交期顺利收货，进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影								

	响。但经公司积极推进后，公司预计仍能于原计划时间内完成前期系列基础设施工程，并达到预计可使用状态，在设备到位调试后可实现投产。公司将在该等基础设施建设基础上，在计划内视产线投产后的运营情况继续补充提升相关工艺能力、进一步丰富产品线并补充相关设备。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的8英寸高端传感器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币38,493.87万元。</p> <p>2020年7月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币1,602.86万元。</p> <p>上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并分别于2020年4月2日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]19453号），于2020年7月27日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]33245号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

2020年7月，公司在无锡市新吴区工信局的带领下，赴青海省海东市互助县开展对口帮扶工作，并捐赠爱心款5万元。

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

(1) 规范董事会建设

2020年，为规范公司在上海证券交易所科创板上市后的运行，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定以及公司注册地开曼群岛所在地法律制定了《对外捐赠管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者来访接待管理制度》《重大信息内部报告制度》等5项公司治理制度，修订了《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总裁及执行委员会工作细则》《子公司管理规定》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理制度》等7项公司治理制度并颁布实施。公司董事会下设战略委员会、审计合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询和建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化，同时独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性。公司建立了三会运作的规范体系，公司的治理架构能按照相关法律法规和公司《组织章程大纲和章程细则》的规定有效运作。2020年，公司累计召开专门委员会15次，董事会9次，股东大会3次。

(2) 规范信息披露

2020年是公司登陆上海证券交易所科创板上市的元年，公司董事会办公室专门负责信息披露管理和投资者关系管理事务，公司积极应对上市公司信息披露的规范与新要求，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时，并建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话和邮箱，接受投资者咨询和交流。公司通过加强信息披露管理，从而建立良好的投资者关系，助力公司树立良好的市场形象。2020年，公司累计披露上网文件130份（其中带编号公告52份），累计355万余字。

(3) 公司财务稳健，诚信经营，不损害债权人的合法权益

根据《中华人民共和国会计法》与《企业会计准则》的要求，公司建立了一套完善的财务管理体系，依法实行会计监督，合理筹集资金，有效利用公司的各项资产，提高经济效益，确保资产的保值增值。公司财务管理规范、诚实守信，与各家金融机构建立了良好的合作关系。同时公司内部控制制度健全、资金使用安全、合理。公司诚信经营，不损害债权人的合法权益，公司历年无银行贷款到期不还情形，严格履行与供应商、客户等签订的合同义务，具有较高的信誉度。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

(1) 依法平等、合规用工

公司在雇佣员工的过程中，不以应聘人员的性别、年龄、民族、宗教信仰、肤色、户籍所在地等与工作无关的个人特征作为标准做出对应聘人员是否招聘的依据，是否录用取决于公司的实际工作需要及应聘者本人的教育背景、职业背景和工作能力等综合因素。公司按照国家规定执行员工的工作时间和休息休假时间，从未在招用、薪酬、福利、晋升等方面出现性别歧视、民族歧视、种族歧视、宗教歧视、生理歧视，保证公平、公正，对员工基本权益保护、平等雇佣、职业健康、员工发展、员工关系管理等方面履行企业应有的责任。公司及下属单位劳务派遣用工人数均未超过其用工总量的 10%，符合《劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》等相关法律法规的规定。劳务派遣用工与其他员工类别人员实行同工同酬，保障劳务派遣员工合法权益。

(2) 人才服务与支持

合理争取、使用政府政策、人才补贴等资源，加大对具有国际视野的复合型管理和技术领军人才的引进力度，支持公司生产、经营的高速发展。通过政企沟通会、申报咨询会等，加强与无锡新吴区人才办、科创中心沟通和交流，及时了解人才计划申报信息。开展国家引才引智项目、高新区集成电路产业发展资金项目申报，组织开展双创人才、太湖人才、企业高级经营管理人才等申报。组织员工薪酬补贴、住房补贴的申报，做好人才保留。

(3) 带动就业

近几年来，公司培养、选拔、引进了大量高素质人才，包括海外专家、市场人才等，逐步建立了一支政治素质高、业务能力强、勇于拼搏、敢打必胜的人才干部队伍。公司发展业务的同时，还积极承担社会责任，带动就业，以回馈社会。每年，公司为当地创造了 3000 多个就业岗位。公司还定期开展校园招聘，与全国多个高校进行校企合作，深入实施大学生联合培养及就业促进计划，吸收应届毕业大学生 244 人，并扎实开展校企合作实习实践活动、系列专项服务活动和技能就业专项行动。公司积极促进本地就业，2020 年本地化员工雇用比例为 6.6%。

公司积极履行社会责任，鼓励辅助岗位聘用残疾人，出台残疾人相关政策，推动各部门残疾人招聘，在 2020 年辅助岗位聘用残疾人达到用工总数的 1.5%。公司与无锡市残联加强联系，多次举行残疾人专场招聘会，公开推出各类招聘岗位，截止 2020 年底，公司共有 35 名残疾人在公司就业。今后，公司还将持续推动残疾人招聘工作，为解决残疾人工作岗位出一份力。

(4) 反强迫劳动和骚扰虐待

公司致力于为员工提供舒适、公平及安全的工作环境，为确保所有员工的人格尊严及个人的平等权利，制定了女职工防止性骚扰管理规定，维护女职工合法权益。

公司鼓励有效沟通、员工激励和团队协作精神，倡导公司管理人员在日常管理工作特别是在员工出现问题时，应与员工做双向沟通，聆听员工问题和意见，并以鼓励方式处理。2020 年，基于组织架构调整，开展了员工奖惩一致化工作。奖惩条例明确了骚扰虐待或其他形式不当行为的惩处细则，任何员工对不当行为可以向上申诉，公司会及时反馈并在保密情况下进行调查后作出回应，同时在有需要的时候采取补救措施。

(5) 薪酬与福利体系

公司实行男女同工同酬，并结合公司效益情况、员工个人绩效及内外部公平性三大因素，通过科学的岗位评估及薪酬分析，逐步优化更公平合理的薪酬结构与福利体系。公司薪酬管理合法合规，每月及时、足额发放劳动报酬，依法安排员工加班换休或支付加班费，遵守最低工资约束，按年回顾薪酬并结合公司业绩合理设置增长方案。同时，依法依规给予员工相关福利与关爱，包括社会保险、住房公积金、带薪年假等法定福利，以及补充商业保险、工作餐、厂车、防暑降温、体检、通讯、职工活动等其他非法定福利。

公司高度重视对人才的吸引、使用与保留，通过市场化的薪酬管理机制、全面业绩及项目考核管理体系、相关激励体系，提高人才队伍的稳定性。同时，公司积极学习、研究国有科技型企业的股权与分红激励机制相关政策，拟通过中长期激励机制的完善补充，加大对人才的吸引与保留效用。

(6) 员工培训

公司秉承“尊重人的价值、开发人的潜能、升华人的心灵”的人才发展理念，搭建具有公司特色、分层分类的人才培养与发展体系；致力于管理人才与专业人才的培养，造就一支拥有核心竞

争能力和专业技能突出的优秀员工队伍，实现员工与企业的共同发展。2020 年培训近 30 万人次，人均时数为 32 课时。

(7) 职业发展通道

继续大力推进双通道工作，结合人才成长规律和专业岗位要求，设定专业技术岗位的成长路径，为科技人才打通专业发展通道，促进个人与公司共同发展，实现双赢。

(8) 组织开展丰富多彩的员工活动

公司每季度会进行“餐饮、住宿满意度调查”，及时获取员工意见和建议，持续提高餐饮、住宿质量和满意度；每周一上午定期举行周晨会，周晨会设有“公司大事”、“部门分享”、“家人家事”等环节，定期与员工分享、交流信息。每个工厂以班组为单位，每天召开的班前会更是员工信息反馈的重要渠道。

为倡导卓越文化，激发员工工作积极性，提升员工荣誉感，公司开展年度评优活动，优化评优机制，提高公平、公开、公正性。2020 年，公司开展了优秀员工、卓越工匠评选、科技人才评选以及最佳协同奖、特别贡献奖、市场开拓奖，在年度业绩合同签约大会上进行了表彰。为鼓励科技创新，培育创新文化，推动可持续发展创新体系建设，激发科研人员创新动力，提升公司整体竞争力，组织 2019 年度优秀科技人员评选。评出百人优秀科技工作者 100 人，十佳科技人员 10 人，科技新锐 5 人，功勋科技人员 2 人，在公司 2020 年度科技大会上进行了表彰。

(9) 困难员工帮扶

2020 年公司救助困难员工共计 393 人次，投入金额 22.2 万元；走访慰问困难员工家庭 66 户，走访慰问困难员工家庭投入 6 万元。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

(1) 供应商权益保护

公司率先在集团内部推广使用华润守正电子招标平台，实现全公司招标业务全覆盖，吸引了更多潜在的合格供应商参与投标，进一步增强了招标采购业务的公开、公平和公正性，随着守正公开招标系统的推广，供应商参与度和积极性越来越高，投标人之间的竞争力度日趋增强。除部分项目通过当地公共资源交易中心进场交易外，所有招标项目均通过华润守正电子招标平台招标，在 2020 年度通过华润守正电子招标平台发布招标公告 88 项，涉及金额 49,332 万元，降本比例达到 20% 以上。除招标采购系统推广外，公司总部采购完成非招标采购业务的梳理，成功上线使用非招标采购管理系统并发布公开寻源公告，全年通过非招标采购管理系统发布寻源项目 188 项，金额约 2,500 万元以上，采购降本约 15%，实现招标+非招标采购业务全流程线上作业，有效提高工作效率，规范采购行为。

在与供应商供需合作中，基于《中华人民共和国合同法》的基础、结合公司经营实际情况，与供应商协商并签署合同或订单，通过合同或订单约定供应商的权益。诚信履约，确保供应商的权益得到执行，通过公司《阳光宣言》，接受供应商监督或投诉，同时主动走访供应商，征求改善建议等举措。尊重和善待供应商，及时做好采购计划，减少临时性紧急订单的频次。充分发挥现金结算的优势，不拖欠供应商货款。

(2) 客户和消费者权益保护

公司秉持客户至上的原则，致力于以优质的产品和服务，持续为客户创造价值。为更好的服务客户，华润微电子设置了多个客户服务窗口，当客户遇到产品技术、质量问题时，窗口人员会积极与客户面对面沟通，注重从客户权益保护视角考虑，关注诉求的合理性和服务体验度，确保客户及时获得优质的服务。

此外，公司通过专业的培训系统，为员工提供沟通技巧、产品技术信息、工程分析、解决方案等相关培训，不断提升客户服务窗口人员专业能力。华润微电子以客户为中心，致力于建设包括销售服务团队、工程服务团队、质量服务团队、IT 客服系统支持等方面的售后服务体系，通过设立专业的服务团队及规范的服务组织，为客户提供全方位、立体化、高效快捷的优质售后服务。

华润微电子致力于从管理系统上提升和加强公司本身及客户信息的安全度，尤其强调客户机密信息和自有知识产权的保护。公司已建立起一整套信息安全的综合防护体系和机制，涉及管理制度、技术防控、信息安全意识宣导等方面。

以代工事业群为例，代工事业群已建立一整套完善的 ISO27001 信息安全管理体系统，设立了信息安全管理委员会，强化并落实公司的机密信息保护政策，物理安全、数据安全、生产区域安

全，以及个人的信息安全防范策略。通过定期公司内网、邮件、培训系统考核形式，对全员进行信息安全宣导；每年组织信息安全员培训并针对信息资产进行风险评估，持续提升信息安全管理水平。

2020 年公司通过内外部审核发现改进方向，并结合风险评估结果，IT 优化了邮件外发管控策略，增加部署了打印管理软件，加强了防火墙、服务器端口管控策略；研发网络架设了研发专线，升级了防火墙，提升了 FTP 管控的安全性；动力设施增设了新 UPS，并根据性能对现有的 UPS 电池和电容进行了更换。

公司通过官方网站、服务窗口、电子邮件等方式，建立多元化的客户沟通渠道，收集客户反馈意见和建议。

公司积极倾听客户声音，主动走访并积极了解客户需求，从不同维度进行详细调查和数据收集分析，及时、准确地了解客户的技术质量和需求，有针对性地解决客户提出的需求。实施定期与不定期的客户质量联合攻关会议，努力提升客户满意度。同时通过客户尊享服务，使客户一站式、全方位掌握当前良率、在线制程能力、准时交付率、投诉进展、工程开发进度等客户关心的信息及状态，融洽与客户的关系，提升客户粘合力。

公司在全价值链中建立了一个渠道顺畅、行之有效的投诉处理和争议解决机制。通过不断提升消费者纠纷的受理和处理能力，持续完善客户投诉处理机制。当客户遇到产品质量问题时，窗口人员会积极与客户面对面沟通，注重从客户权益保护视角考虑，关注诉求的合理性和服务体验度，积极协商处理方案，争取尽快达成共识，避免损失的扩大化。2020 年无重大客户投诉事件发生。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

(1) 产品与服务质量管理体系

公司按 ISO9001&IATF16949 标准建立质量管理体系，注重产品实现过程中的效率和有效性，不断推进全面质量管理 (Total Quality Management) 的理念和方法，以产品质量为核心，让参与产品质量生产、服务全过程的每位员工都有做好产品质量的职责和要求，不仅在人员、机台、材料、环境、方法和检测等方面做好基础的质量管控工作，而且贯标标准 APQP/PPAP、FMEA、SPC 和 MSA 过程控制方法来管控产品质量，并对客户关注的过程变更、有害物质管控等方面加强管控。公司始终坚持高标准、系统化管理、整体化建设和维护产业链的运行，得到了权威认证机构的众多认证，并获得了广泛的认可。

(2) 产品与服务标准执行情况

2020 年公司强化体系能力，2020 年已顺利通过 223 家客户审核，增强客户要求识别和沟通，组织专项审核推动等，顺利通过敏芯，安森美，汇川，施耐德等重点客户审核。获得内外部客户对质量体系的认可，为公司业务拓展提供了坚实基础。

(3) 产品与服务质量安全管理机制

公司重视产品质量的提升和控制工作，目前已建立起一套科学严密高效的质量管理体系和质量管理体系电子系统，从而保证提供的产品质量能满足客户的需求。每年制定产品质量提升目标，层层分解到部门落实至个人，定期检查质量目标达成状态，对任何的产品质量异常问题能及时报警有应急处置机制来管控，对客户的特殊要求也能快速反应实施，随着公司产品质量和客户满意度的不断提升，公司和客户都得到可持续的发展。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

(1) 倾力慈善公益

公司积极履行慈善公益责任，对所肩负的社会责任更是义不容辞，获得了社会广泛认可。自 2007 年起与无锡市慈善总会签订“定向冠名慈善基金”认捐协议书，每年捐赠 70 万元，用于救助、帮扶社会困难群体。2020 年 7 月，公司在无锡市新吴区工信局的带领下，赴青海省海东市互助县开展对口帮扶工作，并捐赠爱心款 5 万元。

(2) 捐资助学

微电子产业已成为国家后续发展的关键产业，国家已将信息安全提升到了一个前所未有的高度，公司紧跟国家战略，积极履行央企使命，为中国微电子产业发展贡献自己的力量。2020 年公司着力打造校企合作平台，为推动学校教学、科研及高新技术的创新发展提供了新动力。公司通

过在各大高校设立奖学金、助学活动基金、建立联合实验室、实训实践基地、冠名班等形式，履行企业支持学生完成学业、支持高校发展的社会责任。2020 年公司共奖励优秀学生 20 名，发放奖学金及助学活动基金合计 40 万元。

(3) 参与志愿者活动及社区共建

2020 年，各级党组织以抗击疫情、协助护绿、公益机构服务、爱心捐赠、专业知识宣导、统筹协作等为主题积极开展各类党员志愿者活动，共计 29 个基层党支部、838 名党员和入党积极分子参与活动。公司各直属党组织创新活动形式，2020 年开展内外部党团共建共计 22 次，参与活动共计 495 人次。如：与中国电子系统工程第二建设有限公司团委共建，开展“新青年说-铭记历史·重任在肩”主题团日活动；与无锡市生态环境局党支部开展共建，开展“大手拉小手”环保公益活动；与南京微盟、玉祁红光党支部共建，开展“客制先锋，业务共促”党建品牌创建活动；与无锡市劳动保障监察支队党支部共建，参观无锡国有企业廉政教育基地活动；与妇幼、供电局、702 所、无锡市政等单位共建，举办“遇见·在云端”联谊活动。

(4) 各直属党组织积极开展内外共建

公司各直属党组织在积极开展内外共建中，党建品牌建设取得一定成效，如：创建“客制先锋、业务共促”品牌，加强与上下游客户的沟通交流，提供产品定制化拓展服务。有苦练内功显成效的，如“党员自主维修岗”品牌，以党员为先锋和骨干，带动设备工程师对产线设备损坏的备件进行自主维修，为工厂节省运营成本。各直属党组织对党建品牌创建提炼先进典型事迹，及时通过党建简报、润心学苑等线上线下平台进行宣传。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

华润微电子有限公司（无锡地区）					
废水					
排放口数量		3		分布情况	公司总排口
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污	排放的最大浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/L)	达标情况
排放口	经处理达标后接管排放	pH	8.71	6-9	达标
		COD	227	500	达标
		悬浮物	207	400	达标
		氨氮	30.1	45	达标
		氟化物	17.6	20	达标
		总磷	5.63	8	达标
		铜	0.107	0.3	达标
		锡	0.47	-	达标
废气					
排放口数量		67		分布情况	地面或楼顶
排放口编号或名称	排放方式	主要/特征污	排放的最大浓度 (mg/m ³)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/m ³)	达标情况
排放口	经处理达标后排放	氟化物	4.58	9	达标
		硫酸雾	7.02	45	达标
		氮氧化物	8	240	达标
		氯化氢	13.07	100	达标
		非甲烷总烃	69.3	120	达标
		氨Kg/h	3.09	8.5	达标
		挥发性有机物	8.99	50	达标
		锡及其化合物	0.00663	8.5	达标
		铅及其化合物	0.01	0.7	达标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司的污水治理设施、废气处理设施均正常运行，公司设有专门的部门负责其运行维护。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司均依法进行环境影响评价并依法申请环保许可。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及子公司按照法规要求制定了环境保护突发事件应急预案，并按照规定进行了备案，公司及子公司会定期进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，减少在突发环境事件发生对人员和环境造成的损害。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司根据法律法规及相关部门的规定，根据各自的实际情况，制定了环境自行检测的方案，对相关污染物进行自我环境监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司及子公司因公司性质以及所经营的业务，对环境的影响较小。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	878,982,146	100.00	99,806,061			-11,907,847	87,898,214	966,880,360	79.52
1、国家持股									
2、国有法人持股	878,982,146	100.00	87,898,214			0	87,898,214	966,880,360	79.52
3、其他内资持股	0	0.00	11,907,847			-11,907,847	0	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	0	0.00	11,907,847			-11,907,847	0	0	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0	0.00	237,136,988			11,907,847	249,044,835	249,044,835	20.48
1、人民币普通股	0	0.00	237,136,988			11,907,847	249,044,835	249,044,835	20.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	878,982,146	100.00	336,943,049			0	336,943,049	1,215,925,195	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司于2020年1月19日收到的中国证监会《关于同意华润微电子有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]144号），公司发行的A股股票于2020年2月27日在上海证券交易所科创板上市。2020年3月27日超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为336,943,049

股，发行新增股份于 2020 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理完毕登记托管手续。本报告期内，公开发行后公司股票数量为 1,215,925,195 股。

2020 年 8 月 27 日，公司首次公开发行网下配售限售股 11,907,847 股上市流通，占公司股本总数的 0.9793%，限售股股东数量为 233 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月。详见公司 2020 年 8 月 19 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华润微电子有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(2020-032)。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次上市公开发行人民币普通股 336,943,049 股，本次发行后，公司总股本由发行前的 878,982,146 股增加至 1,215,925,195 股。上述股本变动使公司 2020 年度的基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄，具体变动情况详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华润集团（微电子）有限公司	878,982,146	0	0	878,982,146	首次公开发行实际控制人股票限售	2023 年 2 月 27 日
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	0	78,125,000	78,125,000	首次公开发行战略配售股票限售	2021 年 3 月 1 日
中国中金财富证券有限公司	0	0	7,812,500	7,812,500	首次公开发行战略配售股票限售	2022 年 2 月 27 日
国新投资有限公司	0	0	1,960,714	1,960,714	首次公开发行战略配售股票限售	2021 年 3 月 1 日
其他股东	0	11,907,847	11,907,847	0	首次公开发行网下配售股票限售	2020 年 8 月 27 日
合计	878,982,146	11,907,847	99,806,061	966,880,360	/	/

说明：其他股东为首次发行网下配售摇号的 10%的最终获配账户 233 个，中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月，以上未进行每个股东列示。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020 年 2 月 12 日	12.80 元/股	336,943,049	2020 年 2 月 27 日	336,943,049	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据公司于 2020 年 1 月 19 日收到的中国证监会《关于同意华润微电子有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]144 号），公司发行的 A 股股票于 2020 年 2 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。2020 年 3 月 27 日超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 336,943,049 股，发行新增股份于 2020 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全部办理完毕登记托管手续。本报告期内，公开发行后公司股票数量为 1,215,925,195 股。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,587
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,024
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借出股 份的限售股份数量	质押或冻结情况	股东 性质

						股份 状态	数量	
华润集团（微电子）有限公司	0	878,982,146	72.29	878,982,146	878,982,146	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	78,125,000	78,125,000	6.43	78,125,000	78,125,000	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	9,496,360	9,496,360	0.78	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	4,946,019	4,946,019	0.41	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,866,536	4,866,536	0.40	0	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	4,000,000	4,000,000	0.33	0	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,720,006	3,720,006	0.31	0	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,658,674	3,658,674	0.30	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	2,900,000	2,900,000	0.24	0	0	无	0	境内非国有法人
白秀平	2,624,962	2,624,962	0.22	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
						种类	数量	
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金				9,496,360		人民币普通股	9,496,360	

中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	4,946,019	人民币普通股	4,946,019
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,866,536	人民币普通股	4,866,536
全国社保基金五零三组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,720,006	人民币普通股	3,720,006
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,658,674	人民币普通股	3,658,674
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
白秀平	2,624,962	人民币普通股	2,624,962
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	2,611,597	人民币普通股	2,611,597
吕梁小金地资产管理有限公司	2,344,222	人民币普通股	2,344,222
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	华润集团（微电子）有限公司	878,982,146	2023 年 2 月 27 日	-	自上市日期锁定 36 个月
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	78,125,000	2021 年 3 月 1 日	-	自上市日期锁定 12 个月
3	中国中金财富证券有限公司	7,812,500	2022 年 2 月 27 日	-	自上市日期锁定 24 个月
4	国新投资有限公司	1,960,714	2021 年 3 月 1 日	-	自上市日期锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中国中金财富证券有限公司	保荐机构的全资子公司	7,812,500	2022年2月27日	0	7,812,500

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	华润集团（微电子）有限公司
单位负责人或法定代表人	董事：李福利、阎飏
成立日期	2011年7月8日
主要经营业务	持股公司
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

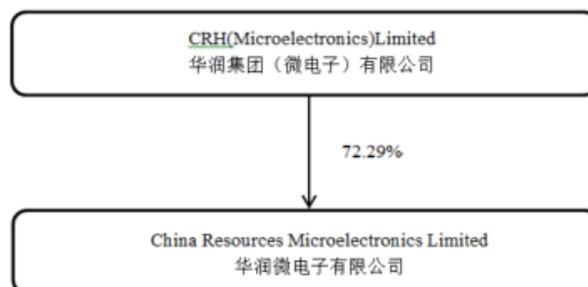
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国华润有限公司
单位负责人或法定代表人	王祥明
成立日期	1986年12月31日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参照下表
其他情况说明	无

公司实际控制人中国华润控制的上市公司基本情况如下：

序号	公司名称	注册地	成立时间	主营业务
1	China Resources Power Holdings Company Limited (华润电力控股有限公司) (0836.HK)	中国香港	2001年8月27日	电厂及煤矿投资、开发、经营和管理
2	China Resources Land Limited (华润置地有限公司) (1109.HK)	开曼群岛	1996年7月3日	房地产开发
3	China Resources Cement Holdings Limited (华润水泥控股有限公司) (1313.HK)	开曼群岛	2003年3月13日	水泥及混凝土业务
4	China Resources Gas Group Limited (华润燃气控股有限公司) (1193.HK)	百慕大	1994年9月20日	城市燃气业务
5	China Resources Pharmaceutical Group Limited (华润医药集团有限公司) (3320.HK)	中国香港	2007年5月10日	药品制造和分销
6	China Resources Beer (Holdings) Company Limited (华润啤酒(控股)有限公司) (0291.HK)	中国香港	1965年8月5日	啤酒生产、经营
7	华润万象生活有限公司	开曼群岛	2017年5月18日	商业运营与物业管理
8	华润医疗控股有限公司	开曼群岛	2013年2月28日	综合医疗服务、医院管理及咨询服务
9	华润三九医药股份有限公司(000999.SZ)	深圳	1999年4月21日	医药产品的研发、生产和销售

10	华润双鹤药业股份有限公司(600062.SH)	北京	1997年5月16日	新药研发、制剂生产、医药销售、制药装备及原料药生产
11	东阿阿胶股份有限公司(000423.SZ)	东阿	1994年6月4日	阿胶系列产品的研发、生产和销售
12	江中药业股份有限公司(600750.SH)	南昌	1996年9月18日	非处方药、保健品的生产、研发和销售

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

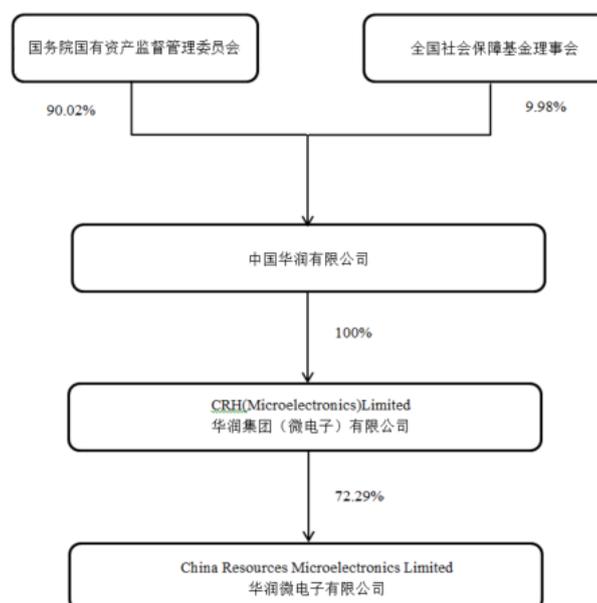
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈小军	董事长	否	男	55	2020/5/20	2022/4/23	0	0	0	无	0.00	是
李福利	董事长	否	男	55	2019/4/24	2020/4/21	0	0	0	无	0.00	是
李虹	董事、首席运营官	是	男	58	2020/8/27 (首席运营官) 2020/11/5 (董事)	2022/4/23	0	0	0	无	274.48	否
陈南翔	常务副董事长	是	男	59	2019/4/24	2020/10/18	0	0	0	无	229.47	否
张宝民	董事	否	男	51	2019/4/24	2022/4/23	0	0	0	无	0.00	是
马文杰	董事	否	男	35	2019/4/24	2022/4/23	0	0	0	无	0.00	是
Yu Chor Wing Wilson (余楚荣)	董事	是	男	61	2019/4/24	2022/4/23	0	0	0	无	304.32	否
彭庆	董事、助理总裁	否	男	47	2019/4/24	2022/4/23	0	0	0	无	212.14	否
杨昶	独立董事	否	男	47	2019/4/24	2022/4/23	0	0	0	无	6.00	否
张志高	独立董事	否	男	55	2019/4/24	2022/4/23	0	0	0	无	6.00	否
夏正曙	独立董事	否	男	60	2019/4/24	2022/4/23	0	0	0	无	6.00	否

张小键	副总裁	否	男	59	2019/5/5	2022/4/23	0	0	0	无	237.66	否
马卫清	副总裁	是	男	55	2019/5/5	2022/4/23	0	0	0	无	216.92	否
姚东晗	副总裁	否	女	46	2019/5/5	2022/4/23	0	0	0	无	212.26	否
康斌	助理总裁	否	男	43	2019/5/5	2021/2/28	0	0	0	无	180.90	否
王国平	专家委员会主任	是	男	58	2019/5/5	2022/4/23	0	0	0	无	196.90	否
吴国屹	董事会秘书	否	男	43	2019/5/5	2022/4/23	0	0	0	无	107.36	否
庄光东	法律合规官	否	男	59	2020/7/29	2020/12/4	0	0	0	无	56.46	否
合计	/	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,246.87	/

姓名	主要工作经历
陈小军	2020 年至今任公司董事长，同时担任华润（集团）有限公司副总经理，华润网络（深圳）有限公司董事长，华润化学材料科技控股有限公司董事长。
李福利	2018 年 2020 年任公司董事长，同时担任华润（集团）有限公司副总经理、华润金融控股有限公司董事长。在控股公司担任董事职务。
李虹	2020 年至今任公司董事，同时担任公司首席运营官、华润微电子（重庆）有限公司总经理。曾任无锡华润上华副总经理，无锡华润华晶副总经理。
陈南翔	2016 年至 2020 年任公司常务副董事长，曾任华润矽威科技（上海）有限公司总经理，无锡华润微电子有限公司董事长，无锡华润矽科微电子有限公司董事长，润科投资管理（上海）有限公司董事。曾任华润微电子（控股）有限公司副总经理、董事，无锡华润晶芯半导体有限公司总经理，华润微电子有限公司副总经理，技术研究院院长，中国半导体行业协会副理事长、中国集成电路产业创新联盟副理事长等。
张宝民	2019 年任公司董事，同时担任华润（集团）有限公司战略管理部高级副总监。曾任华润置地有限公司高级副总裁，华润健康集团有限公司总经理。
马文杰	2019 年任公司董事，同时担任华润（集团）有限公司财务助理总监。曾任华润集团财务部专业总监。
余楚荣	2016 年至今任公司董事，同时担任公司运营中心资深专务。曾任公司副总经理，运营中心总经理，无锡华润半导体总经理，无锡华润上华总经理。
彭庆	2019 年任公司董事，同时担任公司助理总裁。曾任公司会计总监，华润微电子控股有限公司董事长，公司财务总监。
杨昉	2019 年任公司独立董事，博士，现就职于上海科技大学信息科学与技术学院、创意与艺术学院，教授、博导及执行院长。
张志高	2019 年任公司独立董事，上海序伦律师事务所合伙人。
夏正曙	2019 年任公司独立董事，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。

张小键	现任公司副总裁，同时担任华润安盛科技有限公司总经理，华润矽磐微电子有限公司总经理。曾任中国华晶集成电路封装总厂厂长，公司助理总经理。
马卫清	现任公司副总裁，同时担任华润华晶微电子有限公司总经理，华润芯功率半导体设计有限公司董事长。曾任中国华晶分立器件总厂总工程师、厂长，华润华晶微电子有限公司常务副总经理。
姚东晗	现任公司副总裁，同时担任公司人力资源总监，华润微电子控股有限公司总经理。曾任华润集团人力资源部高级经理，公司人力资源总监、助理总经理。
康斌	曾任公司助理总裁，公司财务处资深处长、资本营运总监，无锡华润上华科技有限公司财务处资深处长。
王国平	现任公司专家委员会主任，同时担任公司技术研究院副院长。曾任中国华晶分立器件总厂厂长、总经理，无锡华润微电子有限公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，CR Logic 执行董事、CEO，公司执行董事、总经理、董事长。
吴国屹	现任公司董事会秘书，同时担任公司战略发展部总监。
庄光东	曾任公司法律合规官。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈小军	华润（集团）有限公司	副总经理	2020/3/18	/
陈小军	华润网络（深圳）有限公司	董事长	2020/5/15	/
陈小军	华润化学材料科技控股有限公司	董事长	2020/4/28	/
张宝民	华润（集团）有限公司	战略管理部高级副总监	2018/8/1	/

马文杰	华润（集团）有限公司	财务部助理总监	2019/2/1	/
马文杰	华润维麟健康投资有限公司	董事	2019/4/1	/
马文杰	华润维麟养老服务有限公司	董事	2019/4/1	/
马文杰	华润（泰国）有限公司	董事	2018/9/1	/
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈南翔	江苏信息职业技术学院	华润微电子学院院长	2018/3/1	/
陈南翔	安徽大学电子信息工程学院微电子系	兼职教授	2018/10/1	/
杨旸	上海科技大学	教授、博导、执行院长	2018/7/1	/
杨旸	上海交通大学	兼职教授	2018/6/1	/
杨旸	人民邮电出版社	物联网学报编辑	2017/12/1	/
杨旸	重庆邮电大学	学报编辑	2017/4/1	/
杨旸	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	学位评定委员会副主任	2016/6/1	/
杨旸	上海知识产权法院	技术调查官	2016/3/1	/
张志高	上海序伦律师事务所	合伙人	2007/12/1	/
张志高	潍坊市奎文区中成村镇银行股份有限公司	董事	2013/12/1	/
张志高	上海君道住宅工业有限公司	董事	2018/9/1	/
张志高	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	独立董事	2017/6/1	/
张志高	中庚基金管理有限公司	独立董事	2018/1/1	/
张志高	厦门紫元金线生物科技有限公司	监事	2019/7/1	/
张志高	上海国盈金融信息技术服务有限公司	董事	2010/8/1	/
张志高	福建虎伯寮金线莲有限公司	监事	2019/7/1	/
张志高	上海丞玺股权投资基金管理有限公司	董事	2011/7/1	/
张志高	海口申海房屋发展有限公司	监事	2004/7/1	/

夏正曙	无锡市公证财会咨询有限公司	董事	2012/1/1	/
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬考核委员会是公司根据《公司章程》设立的专门工作机构，负责制定董事及高级管理人员的薪酬议案，并由董事会审议通过		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》制定董事及高级管理人员的薪酬议案		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符		
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,038.66		
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,951.14		

四、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈小军	董事长	选举	股东大会选举
李福利	董事长	离任	工作调整
李虹	董事、首席运营官	选举	股东大会选举
陈南翔	常务副董事长	离任	个人原因
康斌	助理总裁	离任	个人原因
庄光东	法律合规官	聘任	公司发展需要
庄光东	法律合规官	离任	个人原因
邓小社	核心技术人员	离任	个人原因
何波涌	核心技术人员	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		4
主要子公司在职员工的数量		9,056
在职员工的数量合计		9,060
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	6,520	5,418
销售人员	359	279
研发人员	697	653
财务人员	116	114
行政人员	1,368	1,414
合计	9,060	7,878

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	540	488
大学本科	2,854	2,614
大学专科	2,092	1,790
高中及以下	3,574	2,986
合计	9,060	7,878

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司实行分类分级的薪酬与业绩考核管理体系。在科学合理的岗位职级评估体系基础上，建立全员绩效管理体系，将组织业绩目标全方位、多方式、全过程地层层分解、落实，将组织和个人业绩评价结果与薪酬激励相关联，促进公司经营业绩达成，同时提升股东回报。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司秉承“尊重人的价值、开发人的潜能、升华人的心灵”的人才发展理念，搭建具有公司特色、分层分类的人才培养与发展体系；致力于管理人才与专业人才的培养，造就一支拥有核心竞争能力和专业技能突出的优秀员工队伍，实现员工与企业的共同发展。2020年培训达20万人次以上，人均时数为32课程。

1、在线学习打造持续性学习氛围

2020年由于疫情，公司充分利用在线学习方式，不断加强推广，提高培训覆盖率、时效性、一致性，打造“疫情不停学”的持续性学习氛围。充分利用“华润大学”在线学习平台（PC/APP）、腾讯课堂、腾讯直播及外部领导力专业学习平台开展各层级培训，如针对公司骨干开展领导力系列在线专项培训，新员工培训在线学习全覆盖，通过直播形式开展半导体专业学习，财务爱学习在线学习项目，安全专项培训，保密专项培训等等。同时，为了更好地丰富在线学习内容，沉淀内部知识与经验，开展微课大赛，通过大赛打造了一批精品微课和微课内训师团队。

2、讲师培养

内训师队伍的打造，是保障培训体系正常运作的基石，公司通过“金讲台讲师培养计划”提升内训师个人课程开发能力、课程讲授能力、引导能力三大核心能力，提高整体内训师团队质量，培养过程中，引入华润大学认证课程，进行了《行动学习催化师》和《微课制作内训师》的认证。同时，每年开展微电子培训交流会及讲师表彰会，激励优秀讲师，提升讲师热情，树立讲师榜样，增强内部讲师的自豪感与荣誉感。

3、双通道人才培养

(1) 领导力发展

领导力在线专题培训：公司与外部领导力在线学习平台联手，针对公司骨干，开展为期 3 个月的在线领导力专题培训。领导力在线学习课程涵盖了基、中、高三个层级，各层级经理人可以选择相适应的内容进行学习，开展《团队角色》、《基于个人优势的发展规划》等专项领导力培训，提升经理人识别团队成员特点及优势，及时辅导及沟通的技能，在内部团队进行人才梯队建设。

(2) 专业能力发展

科技创新人才培养：开展创新工学坊项目，持续引入创新专题培训，通过对全球核心 3 大创新工具进行系统介绍，引导科技人员建立从客户出发的创新思维，掌握创新方法，鼓励科技人员不断追求、勇于突破。

鼓励科技人员积极参加职称评定，职称评定对公司科技人才成长和企业长远发展，都起着重要作用。公司对职称评定工作予以高度重视，通过开展宣讲会、建立职称服务专栏、制定激励方案等措施鼓励科技人才结合自身条件，积极参与申报，提升个人专业度和影响力。

持续运营集成电路工程研修班，2020 年通过线上线下两种方式，共开展了 10 门课程的学习，进一步完善技术骨干专业知识体系，开拓思维，提升自己的理论知识和专业技能。

职能专业类培养，结合微电子战略业务发展的需求，持续开展有针对性的职能专业培训，如财务爱学习专题培训、ESH 专题培训、信息安全专题培训、保密专题培训及质量体系专题培训等等，进一步提升职能人才的素养，更好地夯实职能支持工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制。公司董事会下设有战略委员会、审计合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。公司股东大会、董事会和管理层权责明确、规范运作，相互制衡、有效配合，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 29 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 15 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 6 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

公司 2020 年第一次临时股东大会为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
陈小军	否	6	6	5	0	0	否	1
李福利	否	3	3	3	0	0	否	1
李虹	否	1	1	0	0	0	否	0
陈南翔	否	5	5	0	0	0	否	2
张宝民	否	9	9	9	0	0	否	3
马文杰	否	9	9	9	0	0	否	3
余楚荣	否	9	9	1	0	0	否	3
彭庆	否	9	9	0	0	0	否	3
杨旻	是	9	9	8	0	0	否	3
张志高	是	9	9	8	0	0	否	3
夏正曙	是	9	9	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司强化业绩导向，逐层分解公司商业计划，明确年度工作目标，并按季度进行周期性回顾与检讨。公司同步开展高管人员的个人绩效考核，涵盖相关业绩指标及综合能力评价。高管人员的激励水平与公司整体业绩完成情况、分管业务完成情况及个人绩效考核结果强相关。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司已披露内部控制自我评价报告,报告的披露网址：www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制有效性进行了独立审计，并出具了标准的无保留意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

华润微电子有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了华润微电子有限公司及其子公司（以下简称“贵公司”）合并财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2020 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表，以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2020 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
营业收入的确认	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>贵公司是中国拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供半导体产品与系统解决方案。</p> <p>2020 年度贵公司营业收入金额为 6,977,259,188.03 元。</p> <p>考虑到收入是贵公司的关键业绩指标之一，且对贵公司经营成果影响重大。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于营业收入确认的会计政策见财务报表附注“三、（二十八）”；关于营业收入类别的披露见附注“六、（三十七）营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们针对收入的确认执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解贵公司销售与收款相关的内部控制并执行内部控制测试，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性； 2、通过对贵公司管理层（以下简称“管理层”）访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯运用； 3、对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性； 4、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与贵公司及主要关联方是否存在关联关系； 5、结合应收账款的审计，向主要客户函证款项余额及报告期销售额； 6、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对收入确认的支持性依据，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间； 7、对销售收入进行真实性检查，核实贵公司收入确认是否真实，检查主要客户销售合同、销售发票、出库单、报关单及销售回款等。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价合并财务报表的总体列报、结构和内容，并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

[以下无正文]

中国·北京

二〇二一年四月二十九日

中国注册会计师

(项目合伙人):

汪娟

中国注册会计师:

王巍

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,865,693,381.17	1,930,674,620.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	901,191,461.19	507,535,344.46
衍生金融资产			
应收票据	七、4	303,832,938.04	190,955,453.14
应收账款	七、5	966,048,018.34	815,007,869.96
应收款项融资	七、6	525,446,921.08	484,906,398.42
预付款项	七、7	51,562,369.47	51,889,680.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	12,390,836.36	12,957,740.46
其中：应收利息	七、8		6,214,794.52
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,269,232,933.71	1,054,762,850.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	18,850,280.91	43,806,238.01
流动资产合计		10,914,249,140.27	5,092,496,196.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	190,508,576.87	81,713,330.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	40,000,000.00	
投资性房地产	七、20	8,213,205.19	2,500,232.86
固定资产	七、21	4,366,803,258.91	3,815,745,162.11
在建工程	七、22	402,136,697.36	489,116,235.65
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	274,080,653.01	274,935,332.40
开发支出			
商誉	七、28	18,204,962.26	16,584,907.67
长期待摊费用	七、29	45,065,694.24	26,558,077.64
递延所得税资产	七、30	17,916,841.20	13,709,328.92
其他非流动资产	七、31	255,316,737.66	281,928,846.54
非流动资产合计		5,618,246,626.70	5,002,791,454.16
资产总计		16,532,495,766.97	10,095,287,650.34
流动负债：			
短期借款	七、32	6,006,416.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	74,896,015.65	99,818,520.32
应付账款	七、36	1,052,826,675.67	748,638,825.07
预收款项	七、37		111,627,094.45
合同负债	七、38	232,783,137.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	445,693,342.74	310,209,180.39
应交税费	七、40	44,887,726.23	37,641,785.19
其他应付款	七、41	943,310,435.86	535,826,262.58
其中：应付利息			
应付股利	七、41	578,258.43	578,258.43
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	98,198,875.04	
其他流动负债	七、44	134,961,244.70	134,961,244.70
流动负债合计		3,033,563,870.12	1,978,722,912.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,442,242,704.86	1,506,112,961.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	七、48	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	13,892,427.86	5,695,422.38
递延收益	七、51	167,325,940.03	151,623,593.33
递延所得税负债	七、30	24,707,255.75	12,310,776.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,698,168,328.50	1,725,742,753.30
负债合计		4,731,732,198.62	3,704,465,666.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,130,152,498.83	829,723,968.05
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	9,418,416,070.63	5,449,608,255.71
减：库存股			
其他综合收益	七、57	336,169,147.36	369,284,876.09
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-301,949,831.59	-1,225,485,934.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,582,787,885.23	5,423,131,165.33
少数股东权益		1,217,975,683.12	967,690,819.01
所有者权益（或股东权益）合计		11,800,763,568.35	6,390,821,984.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,532,495,766.97	10,095,287,650.34

法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：吴从韵

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,977,259,188.03	5,742,784,130.70
其中:营业收入	七、61	6,977,259,188.03	5,742,784,130.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,051,383,317.57	5,499,929,565.32
其中:营业成本	七、61	5,060,613,153.05	4,431,294,665.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	68,742,784.66	66,164,401.04
销售费用	七、63	105,956,728.87	112,019,905.06
管理费用	七、64	369,922,286.94	376,840,527.92
研发费用	七、65	566,077,973.66	482,615,725.08
财务费用	七、66	-119,929,609.61	30,994,340.79
其中:利息费用	七、66	40,680,804.23	44,971,740.09
利息收入	七、66	87,808,866.78	37,761,310.18
加:其他收益	七、67	127,082,612.49	238,776,694.27
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	27,766,191.47	-34,298.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	11,212,908.93	-286,669.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	1,191,461.19	35,344.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	984,056.68	30,881,385.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-11,257,834.70	-36,573,885.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	45,476.79	1,821,601.52

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,071,687,834.38	477,761,408.03
加：营业外收入	七、74	16,046,070.34	32,691,380.87
减：营业外支出	七、75	2,081,757.83	4,499,984.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,085,652,146.89	505,952,803.94
减：所得税费用	七、76	25,943,659.07	-6,473,744.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,059,708,487.82	512,426,548.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,059,708,487.82	512,426,548.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		963,661,634.37	400,755,536.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,046,853.45	111,671,011.96
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-33,826,948.93	22,442,192.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、57	-33,115,728.73	22,442,192.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、57	-33,115,728.73	22,442,192.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	七、57	-33,115,728.73	22,442,192.75
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、57	-711,220.20	
七、综合收益总额		1,025,881,538.89	534,868,741.13

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		930,545,905.64	423,197,729.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		95,335,633.25	111,671,011.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十七、2	0.8362	0.4559
(二) 稀释每股收益(元/股)	十七、2	0.8362	0.4559

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：吴从韵

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,102,270,528.56	4,775,509,876.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		73,661,588.36	50,537,238.30
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	323,534,683.86	244,841,487.64
经营活动现金流入小计		6,499,466,800.78	5,070,888,601.97
购买商品、接受劳务支付的现金		2,499,066,504.91	2,305,580,846.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,493,735,522.19	1,477,947,189.80
支付的各项税费		367,358,721.57	305,666,415.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	307,246,224.74	405,435,531.72
经营活动现金流出小计		4,667,406,973.41	4,494,629,983.68
经营活动产生的现金流量净额	七、79	1,832,059,827.37	576,258,618.29
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,652,273.29	253,453.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,049,137.56	1,596,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,391,716,764.32	3,604,143,423.77
投资活动现金流入小计		1,403,418,175.17	3,605,992,947.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		572,640,609.62	612,313,139.85
投资支付的现金		146,600,000.00	82,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		214,824,595.51	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,736,073,079.67	2,952,393,857.80
投资活动现金流出小计		2,670,138,284.80	3,646,706,997.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,266,720,109.63	-40,714,050.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,253,671,027.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,625,960.42	1,479,978,083.95
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	269,360,156.75	
筹资活动现金流入小计		4,556,657,144.37	1,479,978,083.95
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,870,599.62	155,073,737.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	24,905,302.12	1,504,552,263.62
筹资活动现金流出小计		103,775,901.74	1,659,626,000.98
筹资活动产生的现金流量净额		4,452,881,242.63	-179,647,917.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-65,785,241.64	18,589,246.35
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	4,952,435,718.73	374,485,897.39
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	1,891,248,425.69	1,516,762,528.30
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	6,843,684,144.42	1,891,248,425.69

法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：吴从韵

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	829,723,968.05				5,449,608,255.71		369,284,876.09				-1,225,485,934.52	5,423,131,165.33	967,690,819.01	6,390,821,984.34
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	829,723,968.05				5,449,608,255.71		369,284,876.09				-1,225,485,934.52	5,423,131,165.33	967,690,819.01	6,390,821,984.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	300,428,530.78				3,968,807,814.92		-33,115,728.73				923,536,102.93	5,159,656,719.90	250,284,864.11	5,409,941,584.01
(一)综合收益总额							-33,115,728.73				963,661,634.37	930,545,905.64	95,335,633.25	1,025,881,538.89
(二)所有者投入和减少资本	300,428,530.78				3,968,807,814.92							4,269,236,345.70	154,949,230.86	4,424,185,576.56
1.所有者投入的普通股	300,428,530.78				3,935,316,063.98							4,235,744,594.76		4,235,744,594.76
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所														

		优先股	永续债	其他	股		储备	公积	风险准备					
一、上年年末余额	829,723,968.05				6,020,818,816.32		346,842,683.34				-3,049,202,200.67	4,148,183,267.04	871,613,421.20	5,019,796,688.24
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	829,723,968.05				6,020,818,816.32		346,842,683.34				-3,049,202,200.67	4,148,183,267.04	871,613,421.20	5,019,796,688.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-571,210,560.61		22,442,192.75				1,823,716,266.15	1,274,947,898.29	96,077,397.81	1,371,025,296.10
（一）综合收益总额							22,442,192.75				400,755,536.42	423,197,729.17	111,671,011.96	534,868,741.13
（二）所有者投入和减少资本					857,787,423.12						1,249,735.00	859,037,158.12	-15,593,614.15	843,443,543.97
1. 所有														

者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				857,787,423.12					1,249,735.00		859,037,158.12	-15,593,614.15		843,443,543.97
(三)利润分配				-7,209,249.00					-77,740.00		-7,286,989.00			-7,286,989.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-77,740.00		-77,740.00			-77,740.00
4. 其他				-7,209,249.00							-7,209,249.00			-7,209,249.00
(四)所有者权益内部结转				-1,421,788,734.73					1,421,788,734.73					
1. 资本公积转增资本(或股本)														

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华润微电子有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为于开曼群岛注册成立的有限公司，本公司的控股股东为华润集团（微电子）有限公司（以下简称“华润集团（微电子）”），一家于英属维尔京群岛注册成立的公司。本公司股数 1,215,925,195 股，股本 1,130,152,498.83 元。本公司注册办事处的地址为开曼群岛大开曼岛 KY1-1111，板球广场 4 楼，邮编 KY1-1111。本公司的主要营业地址一：中国江苏省无锡市梁溪路 14 号，邮编：214061，地址二：上海市静安区市北智汇园汶水路 299 弄 12 号，邮编：200072。

本公司的母公司：华润集团（微电子）有限公司，注册地：英属维尔京群岛。

本公司的最终控制方：中国华润有限公司，注册地：北京市。

本公司经营范围：投资、控股

本年度财务报表经公司董事会于 2021 年 4 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	注册地/主要生产经营地	持股比例 (%)		主营业务
			直接	间接	
1	华润微电子控股有限公司	上海		100	发行人境内运营实体的主要持股公司
2	无锡华润上华科技有限公司	无锡		100	从事晶圆制造业务
3	无锡华润微电子有限公司	无锡		100	从事辅助运营管理职能并持有部分境内运营公司的股权
4	华润微电子（重庆）有限公司	重庆		52.69	从事分立器件产品及应用的研发、设计与销售
5	无锡华润华晶微电子有限公司	无锡		99.662	从事分立器件产品及应用的研发、设计与销售
6	无锡华润安盛科技有限公司	无锡		100	从事公司半导体封装和成品测试业务
7	华润微集成电路（无锡）有限公司	无锡		100	从事集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
8	华润赛美科微电子（深圳）有限公司	深圳		100	从事晶圆测试和成品测试业务
9	重庆润芯微电子有限公司	重庆		50.9	持有矽磐微电子股权
10	矽磐微电子（重庆）有限公司	重庆		38.72	从事集成电路封装业务
11	无锡迪思微电子有限公司	无锡		100	掩模板的加工制造及销售
12	华润矽威科技（上海）有限公司	上海		100	集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售

序号	子公司全称	注册地/主要生产经营地	持股比例 (%)		主营业务
			直接	间接	
13	华润半导体(深圳)有限公司	深圳		100	集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
14	无锡华润芯功率半导体设计有限公司	无锡		100	分立器件销售
15	无锡华晶综合服务有限公司	无锡		100	负责发行人的仓储、食堂等后勤业务管理
16	润科投资管理(上海)有限公司	上海		51	投资管理, 投资咨询
17	杰群电子科技(东莞)有限公司	东莞		70	从事半导体封装和成品测试业务
18	杰铨电子(东莞)有限公司	东莞		70	从事半导体电镀服务
19	Great Team Backend Foundry, (HK) Limited	中国香港		70	公司境外销售平台
20	InPower Semiconductor Company Limited	中国香港		100	公司境外销售平台
21	CSMC Asia Limited	中国香港	100		公司境外销售平台
22	CSMC Manufacturing Co., Ltd.	英属维京群岛	100		公司境外销售平台
23	China Resources Semiconductor International Limited	中国香港		100	公司境外销售平台
24	China Resources Microelectronics (Hong Kong) Limited	中国香港		100	持有发行人下属企业
25	Wuxi China Resources Microelectronics (Holdings) Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
26	CRC Microelectronics Company Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
27	Well-Known Property Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
28	Firstar Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
29	Semico Microelectronics (BVI) Limited	英属维京群岛		100	持有发行人下属企业
30	Well-Known (Hong Kong) Property Limited	中国香港		100	无实际经营业务、持有物业
31	DIS Microelectronics (Hong Kong) Limited	中国香港		100	无实际经营业务
32	Bold Team Management Limited	英属维京群岛	100		无实际经营业务
33	Advanced Microelectronics Limited	英属维京群岛	100		无实际经营业务
34	Qualibest Enterprises Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务

序号	子公司全称	注册地/主要生产经营地	持股比例 (%)		主营业务
			直接	间接	
35	Huajing Microelectronics Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
36	Logic Semiconductor Manufacturing Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
37	Micro Assembly Technologies Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
38	Advanced Semiconductor Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增加 3 家。

合并范围变更主体的具体信息详见“本节八合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了

能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信

用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收

款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

公司对商业承兑汇票以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

应收商业承兑汇票账龄分析法

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)
未逾期	0.00
逾期 0-2 个月以内 (含 2 个月)	5.00
逾期 2-6 个月以内 (含 6 个月)	20.00
逾期 6 个月—1 年 (含 1 年)	50.00
逾期 1 年以上	100.00

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，

即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200.00 万元（含 200.00 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄分析法组合	账龄分析法
款项性质组合	资金集中管理形成的款项不计提坏账

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

1) 账龄分析法组合

应收账款账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)
未逾期	0.00
逾期 0-2 个月以内（含 2 个月）	5.00
逾期 2-6 个月以内（含 6 个月）	20.00
逾期 6 个月—1 年（含 1 年）	50.00
逾期 1 年以上	100.00

2) 款项性质组合

款项性质组合	资金集中管理形成的款项不计提坏账
--------	------------------

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资。

2. 发出存货的计价方法

发出存货时，采用移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，

应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日

取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
机器设备	年限平均法	8	2.00	12.25
运输工具	年限平均法	5	0.00	20.00
电子设备	年限平均法	3-5	0.00-2.00	19.60-33.33
信息系统	年限平均法	8	0.00	12.50
办公设备及家具	年限平均法	5	0.00	20.00
动力及基础设施	年限平均法	10	2.00	9.80

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择

权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件使用权、特许权使用权及其他，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	5
特许权使用权	5

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工

薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益

工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 对于国内销售的产品，以产品发运并取得客户确认后作为控制权转移时点并确认销售收入；

(2) 对于国外销售的产品，以产品发运并办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的

应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

8. 政府补助总额法与净额法的实际分类

序号	政府补助性质	总额法或净额法
1	稳岗补助	总额法
2	财政贴息	净额法
3	专利补助	总额法

序号	政府补助性质	总额法或净额法
4	土地价款补贴	总额法
5	固定资产相关的补助	总额法
6	电费返还	总额法

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号), 并要求境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行	经公司管理层审批	2020 年 12 月 31 日预收款项列示金额 0.00 元, 合同负债列示金额 232,783,137.57 元; 2020 年 1 月 1 日预收款项列示金额 0.00 元, 合同负债列示金额 111,627,094.45 元; 2020 年度影响营业成本 15,445,604.79 元, 影响销售费用-15,445,604.79 元。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,930,674,620.44	1,930,674,620.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	507,535,344.46	507,535,344.46	
衍生金融资产			
应收票据	190,955,453.14	190,955,453.14	
应收账款	815,007,869.96	815,007,869.96	
应收款项融资	484,906,398.42	484,906,398.42	
预付款项	51,889,680.69	51,889,680.69	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	12,957,740.46	12,957,740.46	
其中：应收利息	6,214,794.52	6,214,794.52	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,054,762,850.60	1,054,762,850.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,806,238.01	43,806,238.01	
流动资产合计	5,092,496,196.18	5,092,496,196.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	81,713,330.37	81,713,330.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,500,232.86	2,500,232.86	
固定资产	3,815,745,162.11	3,815,745,162.11	
在建工程	489,116,235.65	489,116,235.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	274,935,332.40	274,935,332.40	
开发支出			
商誉	16,584,907.67	16,584,907.67	
长期待摊费用	26,558,077.64	26,558,077.64	
递延所得税资产	13,709,328.92	13,709,328.92	
其他非流动资产	281,928,846.54	281,928,846.54	
非流动资产合计	5,002,791,454.16	5,002,791,454.16	
资产总计	10,095,287,650.34	10,095,287,650.34	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	99,818,520.32	99,818,520.32	
应付账款	748,638,825.07	748,638,825.07	
预收款项	111,627,094.45		-111,627,094.45
合同负债		111,627,094.45	111,627,094.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	310,209,180.39	310,209,180.39	
应交税费	37,641,785.19	37,641,785.19	
其他应付款	535,826,262.58	535,826,262.58	
其中：应付利息			
应付股利	578,258.43	578,258.43	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	134,961,244.70	134,961,244.70	
流动负债合计	1,978,722,912.70	1,978,722,912.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,506,112,961.12	1,506,112,961.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,695,422.38	5,695,422.38	
递延收益	151,623,593.33	151,623,593.33	
递延所得税负债	12,310,776.47	12,310,776.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,725,742,753.30	1,725,742,753.30	
负债合计	3,704,465,666.00	3,704,465,666.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	829,723,968.05	829,723,968.05	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,449,608,255.71	5,449,608,255.71	
减：库存股			
其他综合收益	369,284,876.09	369,284,876.09	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-1,225,485,934.52	-1,225,485,934.52	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,423,131,165.33	5,423,131,165.33	
少数股东权益	967,690,819.01	967,690,819.01	
所有者权益（或股东权益）合计	6,390,821,984.34	6,390,821,984.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,095,287,650.34	10,095,287,650.34	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则要求，将原列报于“预收款项”重分类至“合同负债”，具体调整数据详见上表

适用 不适用

无

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、16.50%、15.00%、0.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.20%/12.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	3.00-10.00 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%、1.00%
其他税费	按国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	0.00
华润华晶、无锡华润上华、华润安盛、华润矽科、迪思微电子、华润矽威、华润半导体、华润赛美科、重庆华微、杰群电子	15.00
润科投资管理（上海）有限公司	20.00
设立于开曼群岛和英属维尔京群岛的纳税主体	0.00
设立于香港的纳税主体	16.50
除上述以外的纳税主体	25.00

注：本公司及设立于开曼群岛和英属维尔京群岛的子公司所得税适用税率为0.00%，本公司设立于香港的子公司所得税适用税率为16.50%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司享受高新技术税收优惠的子公司如下所示：

本公司之子公司无锡华润上华科技有限公司于 2019 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201932002789），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司无锡华润安盛科技有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201732001603），于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为三年（证书编号：GR202032005473），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司华润赛美科微电子（深圳）有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201744200604），于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR202044203291），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司华润矽威科技（上海）有限公司于 2017 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201731000141），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司无锡华润华晶微电子有限公司于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR202032005403），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司华润微集成电路（无锡）有限公司于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为三年（证书编号：GR202032007247），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司华润半导体（深圳）有限公司于 2018 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201844200471），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司华润微电子（重庆）有限公司通过 2017 年度高新技术企业认定，有效期为 3 年（证书编号：GR201751100305），于 2020 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR202051101508），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司无锡迪思微电子有限公司于 2019 年通过高新技术企业认定，有效期为 3 年（证书编号：GR201932007288），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司杰群电子科技（东莞）有限公司于 2019 年通过高新技术企业复审，复审后的有效期为 3 年（证书编号：GR201944000304），按应纳税所得额的 15% 税率计征所得税。

本公司之子公司润科投资管理（上海）有限公司为年应纳税所得额不超过 100 万元的小型微利企业，根据财政部和税务总局财税【2019】13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	251,382.62	81,121.52
银行存款	6,843,430,661.80	1,891,165,204.17
其他货币资金	22,011,336.75	39,428,294.75
合计	6,865,693,381.17	1,930,674,620.44
其中：存放在境外的款项总额	353,404,189.86	407,906,398.54

其他说明

截至 2020 年 12 月 31 日存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 22,009,236.75 元，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	901,191,461.19	507,535,344.46
其中：		
理财产品		7,535,344.46
结构性存款	901,191,461.19	500,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	901,191,461.19	507,535,344.46

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	303,832,938.04	190,955,453.14
商业承兑票据		
合计	303,832,938.04	190,955,453.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		154,710,206.46
商业承兑票据		
合计		154,710,206.46

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
未逾期小计	943,795,653.72
逾期 0-2 个月以内（含 2 个月）	18,754,787.11
逾期 2-6 个月以内（含 6 个月）	4,163,502.16
逾期 6 个月—1 年（含 1 年）	2,209,030.27
逾期 1 年以上	43,084,749.93
合计	1,012,007,723.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	37,413,554.93	3.70	37,413,554.93	100.00		36,646,339.88	4.23	36,646,339.88	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,751,492.40	3.63	36,751,492.40	100.00		35,938,595.85	4.15	35,938,595.85	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	662,062.53	0.07	662,062.53	100.00		707,744.03	0.08	707,744.03	100.00	
按组合计提坏账准备	974,594,168.26	96.30	8,546,149.92	0.88	966,048,018.34	829,470,150.26	95.77	14,462,280.30	1.74	815,007,869.96
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	974,594,168.26	96.30	8,546,149.92	0.88	966,048,018.34	829,470,150.26	95.77	14,462,280.30	1.74	815,007,869.96
合计	1,012,007,723.19	100.00	45,959,704.85		966,048,018.34	866,116,490.14	100.00	51,108,620.18		815,007,869.96

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳耀攀科技有限公司	16,701,062.25	16,701,062.25	100.00	预计无法收回
上海仪恩埃半导体设备有限公司	5,236,855.50	5,236,855.50	100.00	预计无法收回
中航工业集团公司洛阳电光设备研究所	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	预计无法收回
浙江东和电子科技有限公司	4,980,167.49	4,980,167.49	100.00	预计无法收回

深圳市英福达贸易有限公司	2,633,407.16	2,633,407.16	100.00	预计无法收回
成都凯天电子股份有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市贵鸿达电子有限公司	447,022.53	447,022.53	100.00	预计无法收回
江苏九鼎光伏系统有限公司	215,040.00	215,040.00	100.00	预计无法收回
合计	37,413,554.93	37,413,554.93	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	943,795,653.72		
逾期0-2个月以内 (含2个月)	18,754,787.11	937,739.36	5.00
逾期2-6个月以内 (含6个月)	4,163,502.16	832,700.42	20.00
逾期6个月-1年(含1年)	2,209,030.27	1,104,515.14	50.00
逾期1年以上	5,671,195.00	5,671,195.00	100.00
合计	974,594,168.26	8,546,149.92	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	51,108,620.18	-803,246.18	3,603,352.67	113,036.77	7,830,187.24	5,797.81	45,959,704.85
合计	51,108,620.18	-803,246.18	3,603,352.67	113,036.77	7,830,187.24	5,797.81	45,959,704.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,830,187.24

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市凯隆电子有限公司	货款	6,384,991.45	确信无法收回	管理层审批	否
合计	/	6,384,991.45	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd	43,461,706.54	4.29	
江苏钧茂电子有限公司	33,661,361.42	3.33	
中颖电子股份有限公司	28,824,327.83	2.85	
华羿微电子股份有限公司	21,793,328.52	2.15	
佛山市顺德区矽华电子有限公司	21,190,460.38	2.09	
合计	148,931,184.69	14.71	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	525,446,921.08	484,906,398.42
合计	525,446,921.08	484,906,398.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,415,411.63	78.38	34,880,937.94	67.22
1 至 2 年	3,568,065.42	6.92	11,258,195.74	21.70
2 至 3 年	3,927,837.03	7.62	399,062.88	0.77
3 年以上	3,651,055.39	7.08	5,351,484.13	10.31
合计	51,562,369.47	100.00	51,889,680.69	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	未结算的原因
KINGTEK ELECTRON LIMITED	4,283,919.28	尚未到货
DB HiTek Co Ltd	1,312,387.98	尚未结算
合计	5,596,307.26	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
重庆平伟实业股份有限公司	非关联方	9,948,741.01	19.29
DB HiTek Co Ltd	非关联方	4,599,410.71	8.92
KINGTEK ELECTRON LIMITED	非关联方	4,283,919.28	8.31
银关通	非关联方	3,242,926.27	6.29
联华电子股份有限公司	非关联方	2,476,189.82	4.80
合计		24,551,187.09	47.61

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		6,214,794.52
应收股利		
其他应收款	12,390,836.36	6,742,945.94
合计	12,390,836.36	12,957,740.46

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		6,214,794.52
委托贷款		
债券投资		
合计		6,214,794.52

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,299,924.27
1 至 2 年	1,783,679.86
2 至 3 年	101,192.82
3 年以上	38,296,376.64
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	51,481,173.59

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程垫付费	28,310,077.50	29,127,373.81
诉讼保证金	7,400,601.70	7,375,870.70
保证金	5,381,144.08	2,428,711.76
代垫款	4,177,693.89	805,489.69
押金	2,160,722.65	849,413.57
出口退税	1,902,919.62	1,285,204.18
员工备用金及借款	1,543,463.83	2,182,534.39
其他	604,550.32	435,140.58
设备预收款		893,647.20
技术服务费		614,800.00
政府补助		284,686.50
合计	51,481,173.59	46,282,872.38

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	39,539,926.44			39,539,926.44
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-35,803,948.20		35,803,948.20	
--转回第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
一转回第一阶段				
本期计提	717,873.47			717,873.47
本期转回	785,647.20			785,647.20
本期转销	626,740.99			626,740.99
本期核销				
其他变动	244,925.51			244,925.51
2020年12月31日余额	3,286,389.03		35,803,948.20	39,090,337.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	39,539,926.44	717,873.47	785,647.20	626,740.99	244,925.51	39,090,337.23
合计	39,539,926.44	717,873.47	785,647.20	626,740.99	244,925.51	39,090,337.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市地产集团	押金及代垫款	28,678,425.90	1年以内、1-2年、3年以上	55.71	28,346,402.72
北京市隆安(南京)律师事务所	保证金	7,375,870.70	3年以上	14.33	7,375,870.70
东莞宝桥电子科技有限公司	保证金	2,274,739.00	1年以内	4.42	113,736.95
上海开创企业发展有限公司	保证金	1,771,570.00	3年以上	3.44	1,771,570.00

Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd	代垫款	971,584.56	1 年以内	1.89	48,579.23
合计	/	41,072,190.16	/	79.79	37,656,159.60

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	482,750,846.45	102,579,339.19	380,171,507.26	294,559,396.80	100,280,036.15	194,279,360.65
在产品	598,219,973.60	73,011,551.74	525,208,421.86	564,508,489.65	80,174,707.70	484,333,781.95
库存商品	327,757,661.01	57,739,500.64	270,018,160.37	356,827,713.29	58,385,292.46	298,442,420.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	20,019,036.16		20,019,036.16	23,622,242.91		23,622,242.91
委托加工物资	99,737,327.38	25,921,519.32	73,815,808.06	84,282,989.09	30,197,944.83	54,085,044.26
合计	1,528,484,844.60	259,251,910.89	1,269,232,933.71	1,323,800,831.74	269,037,981.14	1,054,762,850.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	100,280,036.15	9,910,409.45	2,050,408.45	9,661,514.86		102,579,339.19
在产品	80,174,707.70	21,497,099.20		28,660,255.16		73,011,551.74
库存商品	58,385,292.46	25,786,609.62		26,432,401.44		57,739,500.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	30,197,944.83	14,795,440.05		19,071,865.56		25,921,519.32
合计	269,037,981.14	71,989,558.32	2,050,408.45	83,826,037.02		259,251,910.89

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	15,788,073.47	31,190,077.51
预缴税金	2,218,215.81	3,062,743.77
发行费用	843,991.63	9,553,416.73
合计	18,850,280.91	43,806,238.01

其他说明
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	81,713,330.37	106,600,000.00		2,195,246.50							190,508,576.87
小计	81,713,330.37	106,600,000.00		2,195,246.50							190,508,576.87
合计	81,713,330.37	106,600,000.00		2,195,246.50							190,508,576.87

其他说明：无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
瀚天天成电子科技（厦门）有限公司	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	9,383,465.61			9,383,465.61
2. 本期增加金额	753,690.93	9,019,451.32		9,773,142.25
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	753,690.93	9,019,451.32		9,773,142.25
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,137,156.54	9,019,451.32		19,156,607.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,883,232.75			6,883,232.75
2. 本期增加金额	590,410.88	3,469,759.04		4,060,169.92
(1) 计提或摊销	223,211.88	94,514.25		317,726.13
(2) 存货、固定资产、在建工程转入	367,199.00	3,375,244.79		3,742,443.79
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,473,643.63	3,469,759.04		10,943,402.67
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,663,512.91	5,549,692.28		8,213,205.19
2. 期初账面价值	2,500,232.86			2,500,232.86

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,366,803,258.91	3,815,745,162.11
固定资产清理		
合计	4,366,803,258.91	3,815,745,162.11

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及家具	信息系统	动力及基础设施	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,560,578,753.52	11,973,476,292.30	13,527,842.82	300,759,702.75	30,180,384.86	36,057,688.80	1,301,425,601.11	15,216,006,266.16
2. 本期增加金额	4,418,954.48	1,673,526,504.56	1,331,659.82	42,272,644.99	51,817,527.05	5,789,339.33	248,439,450.09	2,027,596,080.32
1) 购置		70,592,669.00	352,660.18	5,950,354.46	456,559.28	5,372,287.04	62,051,361.37	144,775,891.33
2) 在建工程转入	4,418,954.48	644,939,773.71	978,999.64	23,273,027.19	556,705.65	417,052.29	153,064,623.03	827,649,135.99

入									
3) 企业合并增加		939,025,304.88		13,049,263.34	2,937,276.33				955,011,844.55
4) 其他增加		18,968,756.97			47,866,985.79		33,323,465.69		100,159,208.45
3. 本期减少额	59,077,501.69	59,354,758.71	2,958,188.09	44,879,340.09	1,262,656.06	1,221,969.52	17,094.02		168,771,508.18
1) 处置或报废	952,415.00	59,329,953.69	2,949,463.55	3,059,865.95	1,257,998.71	1,130,847.95	17,094.02		68,697,638.87
2) 其他减少	57,144,012.28			41,816,420.33					98,960,432.61
(3) 汇率变动	227,383.48	24,805.02	8,724.54	3,053.81	4,657.35	91,121.57			359,745.77
(4) 转至投资性房地产	753,690.93								753,690.93
4. 期末余额	1,505,920,206.31	13,587,648,038.15	11,901,314.55	298,153,007.65	80,735,255.85	40,625,058.61	1,549,847,957.18		17,074,830,838.30
二、累计折旧									
1. 期初余额	692,021,928.72	8,697,697,269.71	9,890,831.50	249,662,240.20	25,342,419.73	24,443,063.21	1,039,307,635.78		10,738,365,388.85
2. 本期增加额	59,267,761.17	1,209,911,830.39	974,882.87	37,515,281.07	41,315,683.94	2,252,046.81	92,831,671.05		1,444,069,157.30
1) 计提	59,267,761.17	534,907,686.17	974,882.87	25,903,906.23	1,630,256.39	2,252,046.81	52,467,308.90		677,403,848.54
2) 企业合并增加		673,495,047.97		11,611,374.84	2,407,815.89				687,514,238.70
3) 其他增加		1,509,096.25			37,277,611.66		40,364,362.15		79,151,070.06

3. 本期减少额	42,546,137.19	53,548,010.90	2,366,083.41	39,930,637.43	1,155,246.07	674,912.75	186,031.90	140,407,059.65
1) 处置或报废	915,070.29	53,524,861.39	2,362,593.59	2,829,659.62	1,151,526.63	592,903.34	186,031.90	61,562,646.76
2) 其他减少	41,233,209.50			37,100,541.42				78,333,750.92
3) 汇率变动	30,658.40	23,149.51	3,489.82	436.39	3,719.44	82,009.41		143,462.97
4) 转至投资性房地产	367,199.00							367,199.00
4. 期末余额	708,743,552.70	9,854,061,089.20	8,499,630.96	247,246,883.84	65,502,857.60	26,020,197.27	1,131,953,274.93	12,042,027,486.50
三、减值准备								
1. 期初余额	1,178,995.28	658,299,862.19	38,219.20	471,208.11	36,886.07	879,445.14	991,099.21	661,895,715.20
2. 本期增加金额		8,424,884.43		330,204.22	6,998.60	643.32	218,405.12	8,981,135.69
(1) 计提		7,886,059.23		330,014.71	6,998.60	643.32	218,405.12	8,442,120.98
2) 其他增加		538,825.20		189.51				539,014.71
3. 本期减少金额		4,268,898.77	38,219.20	7,908.77	5,382.16	536,436.35	19,912.75	4,876,758.00
1) 处置或报废		3,135,006.43	38,219.20	7,908.77	5,382.16	536,436.35	19,912.75	3,742,865.66
2) 其他减少		1,133,892.34						1,133,892.34
4. 期末余额	1,178,995.28	662,455,847.85		793,503.56	38,502.51	343,652.11	1,189,591.58	666,000,092.89

四、账面价值								
1. 期末账面价值	795,997,658.33	3,071,131,101.10	3,401,683.59	50,112,620.25	15,193,895.74	14,261,209.23	416,705,090.67	4,366,803,258.91
2. 期初账面价值	867,377,829.52	2,617,479,160.40	3,598,792.12	50,626,254.44	4,801,079.06	10,735,180.45	261,126,866.12	3,815,745,162.11

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华晶 S 栋设计楼	2,285,315.90	由于土地使用权人名称与房产实际使用人名称不一致，导致未能办理该处房产的房产证。

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	402,136,697.36	489,116,235.65
工程物资		
合计	402,136,697.36	489,116,235.65

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海力士设备转移	333,223,032.04	284,916,188.23	48,306,843.81	337,201,398.12	288,723,186.18	48,478,211.94
引进德国设备	106,389,809.36	66,847,080.39	39,542,728.97	115,706,287.65	61,443,440.80	54,262,846.85
技术升级改造	78,983,364.52		78,983,364.52			
6英寸晶圆生产线扩容设备	43,808,554.00	27,414,824.72	16,393,729.28	43,838,684.54	27,418,217.32	16,420,467.22
6英寸晶圆生产线扩容项目动力工程	23,593,835.93	18,339,813.30	5,254,022.63	23,593,835.93	18,339,813.30	5,254,022.63
扩建工艺厂房、连廊及废水站	20,476,490.32		20,476,490.32	20,476,490.33		20,476,490.33
6英寸晶圆生产线扩容项目特气特化系统	15,798,009.88	12,355,196.99	3,442,812.89	15,798,009.88	12,355,196.99	3,442,812.89
深槽刻蚀设备购入	13,451,050.00		13,451,050.00			
净化厂房装修及机电安装	13,329,414.37		13,329,414.37	42,421,393.62	30,667,883.58	11,753,510.04
新购入1台DPS Poly ETCH设备	10,619,450.00		10,619,450.00			
其他	194,716,339.51	42,379,548.94	152,336,790.57	336,773,916.20	7,746,042.45	329,027,873.75
合计	854,389,349.93	452,252,652.57	402,136,697.36	935,810,016.27	446,693,780.62	489,116,235.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
海力士设备转移	337,201,398.12	337,201,398.12			3,978,366.08	333,223,032.04	100.00	正在调试				自有资金
引进德国设备	150,000,000.00	115,706,287.65	20,419,023.04	28,452,798.11	1,282,703.22	106,389,809.36	90.75	在建				自有资金
技术升级改造	100,060,000.00		78,983,364.52			78,983,364.52	78.94	在建				自有资金
6英寸晶圆生产线扩容设备	43,838,684.54	43,838,684.54			30,130.54	43,808,554.00	100.00	正在调试				自有资金
6英寸晶圆生产线扩容项目动力工程	23,593,835.93	23,593,835.93				23,593,835.93	100.00	正在调试				自有资金
扩建工艺厂房、连廊及废水站	41,278,905.97	20,476,490.33			0.01	20,476,490.32	49.61	在建				自有资金
6英寸晶圆生产线扩容项目特气特化系统	15,798,098.88	15,798,098.88				15,798,098.88	100.00	正在调试				自有资金
深槽刻蚀设备购入	13,451,050.00		13,451,050.00			13,451,050.00	100.00	正在调试				自有资金

净化厂 房装修 及机电 安装	112, 642, 198. 22	42,421 ,393.6 2	30,66 7,883 .58	59,75 9,862 .83		13,329 ,414.3 7	64.89	在建				自有资金
新购入 1 台 DPS Poly ETCH 设 备	10,6 19,4 50.0 0		10,61 9,450 .00			10,619 ,450.0 0	100.00	正在调试				自有资金
合计	848, 483, 532. 66	599,03 6,100. 07	154,1 40,77 1.14	88,21 2,660 .94	5,291,1 99.85	659,67 3,010. 42	/	/			/	/

注：其他减少主要为出售正在安装调试的设备。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
1. 引进德国设备	7,014,468.19	资产闲置
合计	7,014,468.19	/

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权使用权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	284,499,209.12			92,143,376.34	268,881,920.17	690,000.00	646,214,505.63
2. 本期增加金额				13,981,435.85	27,121,462.15		41,102,898.00
(1) 购置					27,121,462.15		27,121,462.15
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				13,981,435.85			13,981,435.85
3. 本期减少金额	9,019,451.32			1,691,649.45			10,711,100.77
(1) 处置	9,019,451.32			1,691,649.45			10,711,100.77
4. 期末余额	275,479,757.80			104,433,162.74	296,003,382.32	690,000.00	676,606,302.86
二、累计摊销							
1. 期初余额	75,614,475.20			36,015,843.88	234,543,188.85		346,173,507.93
2. 本期增加金额	6,208,557.79			8,966,316.34	20,956,353.89		36,131,228.02
(1) 计提	6,208,557.79			8,966,316.34	20,956,353.89		36,131,228.02
3. 本期减少金额	3,375,244.79			789,415.01			4,164,659.80
(1) 处置	3,375,244.79			789,415.01			4,164,659.80
4. 期末余额	78,447,788.20			44,192,745.21	255,499,542.74		378,140,076.15
三、减值准备							
1. 期初余额				21,836,201.74	3,269,463.56		25,105,665.30

2. 本期增加金额					182,142.84		182,142.84
(1) 计提					182,142.84		182,142.84
3. 本期减少金额				902,234.44			902,234.44
(1) 处置				902,234.44			902,234.44
4. 期末余额				20,933,967.30	3,451,606.40		24,385,573.70
四、账面价值							
1. 期末账面价值	197,031,969.60			39,306,450.23	37,052,233.18	690,000.00	274,080,653.01
2. 期初账面价值	208,884,733.92			34,291,330.72	31,069,267.76	690,000.00	274,935,332.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华润赛美科微电子（深圳）有限公司	5,946,978.17					5,946,978.17
华润微集成电路（无锡）有限公司	10,637,929.50					10,637,929.50
杰群电子科技（东莞）有限公司		1,620,054.59				1,620,054.59
合计	16,584,907.67	1,620,054.59				18,204,962.26

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	账面价值	确定方法	
华润赛美科微电子(深圳)有限公司资产组	5,946,978.17	华润赛美科微电子(深圳)有限公司资产组确定的非流动资产	161,381,347.32	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组	否
华润微集成电路(无锡)有限公司资产组	10,637,929.50	华润微集成电路(无锡)有限公司资产组确定的非流动资产	68,815,303.60	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组	否
杰群电子科技(东莞)有限公司资产组	1,620,054.59	杰群电子科技(东莞)有限公司资产组确定的非流动资产	377,228,170.81	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组	否

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

华润赛美科微电子(深圳)有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值;采用未来现金流量折现方法的主要假设:华润赛美科微电子(深圳)有限公司未来5年产能均维持在核定产能,稳定年份增长率0%,折现率14.18%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于华润赛美科微电子(深圳)有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。华润赛美科微电子(深圳)有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

华润微集成电路（无锡）有限公司（更名前为“无锡华润矽科微电子有限公司”）资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：华润微集成电路（无锡）有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，折现率14.52%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于华润微集成电路（无锡）有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。华润微集成电路（无锡）有限公司商誉不予计提资产减值准备。

杰群电子科技（东莞）有限公司资产组组合的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：杰群电子科技（东莞）有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，折现率14.18%测算资产组组合的可收回金额。经预测显示资产组组合的可收回金额大于杰群电子科技（东莞）有限公司资产组组合账面价值及商誉账面价值之和。杰群电子科技（东莞）有限公司商誉不予计提资产减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	18,798,298.12	32,747,956.51	13,735,753.47		37,810,501.16
项目改造费	7,759,779.52	5,217,652.72	5,722,239.16		7,255,193.08
合计	26,558,077.64	37,965,609.23	19,457,992.63		45,065,694.24

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,083,809.60	3,762,571.44		
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	69,410,200.00	10,411,530.00	78,895,526.13	11,834,328.92
递延收益-政府补助	16,834,884.43	2,525,232.66	12,500,000.00	1,875,000.00
预计负债	8,116,714.00	1,217,507.10		
合计	119,445,608.03	17,916,841.20	91,395,526.13	13,709,328.92

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧税收优惠政策导致的计税基础和账面价值之间的差异	65,570,509.43	13,214,159.49	82,012,935.67	12,301,940.35
交易性金融资产公允价值变动	1,191,461.19	297,865.30	35,344.46	8,836.12
资产评估增值	74,633,251.19	11,195,230.96		
合计	141,395,221.81	24,707,255.75	82,048,280.13	12,310,776.47

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,618,123,231.99	1,632,505,282.21
可抵扣亏损	999,078,422.34	1,509,175,218.99
合计	2,617,201,654.33	3,141,680,501.20

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	8,627,492.10	7,274,748.99	
2023	50,589,521.16	79,310,442.85	
2024	57,757,890.71	148,683,090.39	
2025	241,566,790.68	362,083,635.88	
2026	398,179,368.91	517,517,925.27	
2027	135,085,343.87	288,440,817.29	
2028	37,194,403.43	73,366,585.22	
2029	41,471,019.20	32,497,973.10	
2030	28,606,592.28		
合计	999,078,422.34	1,509,175,218.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产款	255,316,737.66		255,316,737.66	279,416,311.37		279,416,311.37
预付工程款				2,512,535.17		2,512,535.17
合计	255,316,737.66		255,316,737.66	281,928,846.54		281,928,846.54

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,006,416.66	
合计	6,006,416.66	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	74,896,015.65	99,818,520.32
合计	74,896,015.65	99,818,520.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,039,159,254.73	718,437,220.96
1-2 年（含 2 年）	6,182,404.85	16,147,016.70
2-3 年（含 3 年）	867,419.22	3,110,058.79
3 年以上	6,617,596.87	10,944,528.62
合计	1,052,826,675.67	748,638,825.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州永晟电子科技有限公司	2,060,433.53	尚未结算
Okmetic Oyj	1,813,867.39	尚未结算
合计	3,874,300.92	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	232,783,137.57	111,627,094.45
合计	232,783,137.57	111,627,094.45

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

注：期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	284,024,784.84	1,562,243,968.14	1,445,115,240.82	401,153,512.16
二、离职后福利-设定提存计划	26,184,395.55	99,792,029.30	82,936,594.28	43,039,830.57
三、辞退福利		2,231,338.30	731,338.29	1,500,000.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	310,209,180.39	1,664,267,335.74	1,528,783,173.39	445,693,342.74

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	232,030,004.75	1,311,572,981.35	1,223,156,316.40	320,446,669.70
二、职工福利费	2,305.64	63,471,588.61	57,987,516.52	5,486,377.73
三、社会保险费	13,988,636.16	73,879,334.64	62,650,044.94	25,217,925.86
其中：医疗保险费	10,809,097.46	59,233,299.24	50,308,474.84	19,733,921.86
工伤保险费	793,606.00	4,213,780.36	3,132,250.79	1,875,135.57
生育保险费	1,268,645.32	7,225,275.78	6,060,282.29	2,433,638.81
补充医疗保险	1,117,287.38	3,206,979.26	3,149,037.02	1,175,229.62
四、住房公积金	8,091,773.30	90,095,306.05	79,501,182.69	18,685,896.66
五、工会经费和职工教育经费	29,912,064.99	23,224,757.49	21,820,180.27	31,316,642.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	284,024,784.84	1,562,243,968.14	1,445,115,240.82	401,153,512.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,373,051.21	96,400,190.16	80,460,478.94	41,312,762.43
2、失业保险费	811,344.34	3,391,839.14	2,476,115.34	1,727,068.14
3、企业年金缴费				
合计	26,184,395.55	99,792,029.30	82,936,594.28	43,039,830.57

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,104,533.08	8,847,532.71
消费税		
营业税		
企业所得税	15,897,203.84	16,385,288.80
个人所得税	6,072,922.49	3,828,749.59
城市维护建设税	2,260,749.37	1,876,487.98
房产税	1,961,736.74	3,600,465.58
教育费附加	1,664,635.56	1,377,069.36
土地使用税	925,945.15	1,101,194.87
印花税		624,996.30
合计	44,887,726.23	37,641,785.19

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	578,258.43	578,258.43
其他应付款	942,732,177.43	535,248,004.15
合计	943,310,435.86	535,826,262.58

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	578,258.43	578,258.43
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	578,258.43	578,258.43

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利系下属公司（华晶）派息，小股东江苏新科电子集团有限公司没有提供收款信息

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程和固定资产款	457,776,786.09	361,153,745.22
往来款	200,090,724.36	
保证金	192,450,241.25	138,261,403.65
MEMS 项目补助资金	36,582,200.00	
预提费用	26,221,813.21	19,018,181.22
股份收购款	13,620,200.00	
员工款项	6,453,175.59	3,907,299.65
代垫款	6,152,506.09	1,667,632.56
社保及住房公积金	1,110,040.08	1,403,301.52
押金	951,588.55	4,091,198.14
稳岗补贴		3,959,176.76
固定资产质保金		310,936.68
其他	1,322,902.21	1,475,128.75
合计	942,732,177.43	535,248,004.15

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ASM Pacific (Hong Kong) Limited	3,387,699.20	对方未催收
上海正帆科技股份有限公司	1,554,978.99	对方未催收
合计	4,942,678.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	98,198,875.04	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	98,198,875.04	

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应付租赁费	134,961,244.70	134,961,244.70
合计	134,961,244.70	134,961,244.70

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	95,565,156.08	
保证借款		
信用借款	1,346,677,548.78	1,506,112,961.12
合计	1,442,242,704.86	1,506,112,961.12

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

信用借款利率区间：1.45143%-4.9000%，抵押借款利率区间：1.72063%-4.9000%

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

1.0.18 微米 BCD 升级项目	50,000,000.00			50,000,000.00	政府补助
合计	50,000,000.00			50,000,000.00	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	5,695,422.38	13,892,427.86	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	5,695,422.38	13,892,427.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
政府补助-与资产相关	112,742,104.77	20,993,000.00	34,320,359.45	99,414,745.32	政府补助
政府补助-与收益相关	38,881,488.56	42,238,000.00	13,208,293.85	67,911,194.71	政府补助
合计	151,623,593.33	63,231,000.00	47,528,653.30	167,325,940.03	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能功率集成电路及应用方案研发		39,250,000.00		1,238,647.66		38,011,352.34	与收益相关
智慧健康医疗传感器技术与应用系统平台研究	17,391,691.88			169,107.28		17,222,584.60	与收益相关
高端传感器研发	12,100,000.00					12,100,000.00	与资产相关
4500V 新型高压功率芯片工艺开发产业	13,513,523.93			3,708,452.68		9,805,071.25	与资产相关
集成电路与传感器集成制造与生产技术	9,367,011.27					9,367,011.27	与资产相关
8 英寸 BCD 技术升级项目	8,655,000.00					8,655,000.00	与资产相关
01 专项-基于国产 CPU 的计算机外设 SoC 芯	7,650,000.00					7,650,000.00	与资产相关
有机废气治理设施提标改造		7,010,000.00				7,010,000.00	与资产相关
基于 GaN 的 PD 电源控制芯片开发政府补助	10,000,000.00			3,774,748.33		6,225,251.67	与收益相关
其他零星项目	5,430,284.57			1,645,984.11		3,784,300.46	与资产相关
2020 年重庆市第三批工业信息化专项补助资金（用于 CONTACT SI ETCH 多晶硅刻蚀		3,790,000.00		236,875.00		3,553,125.00	与资产相关

机)							
微纳掩模干法刻蚀技术研发及产业化应用	4,500,000.00			1,125,000.00		3,375,000.00	与资产相关
新区管委会(智能卡)	2,960,000.00					2,960,000.00	与资产相关
硅基高速光耦系列芯片关键技术研发	3,964,316.11			1,123,716.58		2,840,599.53	与资产相关
微纳掩模离子修复技术研发及产业化	3,562,500.00			750,000.00		2,812,500.00	与资产相关
测温仪核心传感器的规模制造		3,000,000.00		281,250.00		2,718,750.00	与资产相关
02 专项-IGBT	4,867,112.66			2,313,912.66		2,553,200.00	与资产相关
8 英寸硅基 GaN 电子器件工艺	130,102.92	2,388,000.00				2,518,102.92	与收益相关
掩模微纳清洗技术研发及应用	3,083,333.00			1,000,000.00		2,083,333.00	与资产相关
光电子半导体器件项目	2,703,617.91			643,505.14		2,060,112.77	与资产相关
8 英寸项目建设补贴	5,825,842.70			4,112,359.56		1,713,483.14	与资产相关
新一代功率半导体器件关键技术研发	1,650,000.00			118,363.64		1,531,636.36	与资产相关
硅基氮化镓功率器件制造及工艺研发	1,100,000.00	600,000.00		232,063.42		1,467,936.58	与资产相关
超结(SJ)工艺产品线数字化装备普及项目		1,440,000.00				1,440,000.00	与资产相关
新一代氮化镓功率器件与制造技	1,450,000.00	550,000.00		812,202.14		1,187,797.86	与资产相关
高密度 3DQFN 先进封装技术研究及产业化	1,530,351.86			403,890.28		1,126,461.58	与资产相关
湿法机台 VOCs 减排改造		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发(1100)	820,997.67	443,000.00		320,200.88		943,796.79	与资产相关
金融芯片研发	907,000.00					907,000.00	与收益相关
分裂栅工艺产品线专项资金		890,000.00		111,249.97		778,750.03	与资产相关
低成本多芯片混合封装技术研发	971,570.04			274,248.00		697,322.04	与资产相关
高效率无线充与功率驱动技术的研发与产业化		2,000,000.00		1,305,496.33		694,503.67	与资产相关
典型 MEMS 器件规模化封装技术	1,040,035.32			354,634.52		685,400.80	与收益相关
0.11 微米超低功耗工艺技术平台开发	800,000.00			200,000.00		600,000.00	与收益相关
精密掩模检测技术产业化应用	1,354,167.00			812,500.00		541,667.00	与资产相关
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发	490,000.00	270,000.00		218,667.57		541,332.43	与资产相关
红外光接收芯片示范项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关

江苏省无线电力传输技术重点实验室	1,465,220.21			992,155.93		473,064.28	与资产相关
新能源汽车电子用 6 吋 SiC 功率器件	500,000.00			46,875.00		453,125.00	与资产相关
与 CMOS 兼容的 MEMS 成套模块工艺与制造平台	4,290,721.35			3,942,060.64		348,660.71	与资产相关
2020 市太湖人才项目扶持经费		300,000.00				300,000.00	与收益相关
新吴区飞凤人才补贴		300,000.00				300,000.00	与收益相关
无锡市科技发展资金(技术研发)发展项目-新一代高压大功率超级 MOS 型器件的研制	500,000.00			229,166.67		270,833.33	与资产相关
人工智能技术创新	270,000.00					270,000.00	与收益相关
高可靠性音视频和控制用 MCU 研发与产业化	1,324,681.10			1,100,381.42		224,299.68	与资产相关
无线充电与功率驱动技术的研发与产业化	379,539.28			218,921.40		160,617.88	与资产相关
省科技支-新型 Trench-FS-IGBT	308,069.20			152,269.74		155,799.46	与资产相关
电源适配器的集成光耦和电压基准一体化芯片	196,268.80			43,750.48		152,518.32	与收益相关
02 专项-IGBT 测试技术与可靠性实验与封装应用技术研究	421,998.19			281,150.65		140,847.54	与资产相关
其他零星项目	118,984.05					118,984.05	与收益相关
信息安全类芯片测试技术研究	100,000.00					100,000.00	与收益相关
信息安全类芯片测试技术研究	84,078.03					84,078.03	与资产相关
红外光接收芯片示范项目	273,785.87			200,661.26		73,124.61	与资产相关
02 专项-S01 工艺平台先导产品设计与验证 2	53,753.18			37,238.40		16,514.78	与资产相关
超低功耗微控制器的研发及产业化	106,417.03			94,987.77		11,429.26	与资产相关
新能源汽车推广应用补贴	26,220.00			16,560.00		9,660.00	与资产相关
集成电路产业专项基金-MEMS 压力传感器芯片的研发及产业化	50,016.86			50,016.86			与资产相关
省软件产业专项-高压 IGBT 功率器件的研发	38,550.01			38,550.01			与资产相关
Flipchip 系列先进封装技术产业化	250,000.00			250,000.00			与资产相关
02 专项-IGBT	7,427,405.59			7,427,405.58		0.01	与收益相关

华润微电子 650V 硅基氮化镓功率器件设计及工艺技术研究项目	5,119,425.74			5,119,425.74			与资产相关
合计	151,623,593.33	63,231,000.00		47,528,653.30		167,325,940.03	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	829,723,968.05	300,428,530.78				300,428,530.78	1,130,152,498.83
一、有限售条件股份	829,723,968.05	88,990,078.17			-10,617,393.62	78,372,684.55	908,096,652.60
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	829,723,968.05	78,372,684.55				78,372,684.55	908,096,652.60
3. 其他内资持股		10,617,393.62			-10,617,393.62		
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							

二、无限售条件流通股份		211,438,452.61			10,617,393.62	222,055,846.23	222,055,846.23
1. 人民币普通股		211,438,452.61			10,617,393.62	222,055,846.23	222,055,846.23
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	829,723,968.05	300,428,530.78				300,428,530.78	1,130,152,498.83

其他说明：

注：经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]144号文《关于同意华润微电子有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司首次公开发行股票并于2020年2月27日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本公司公开发行人民币普通股股票（A股）每股面值为1.00港元，初始发行数量29,299.4049万股，发行价格为每股人民币12.80元，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权于2020年3月27日全额行使，向境内投资者超额配售4,394.90万股人民币普通股股票（A股），每股配售价格为12.80元，发行总股数扩大至33,694.3049万股。累计增加股本人民币300,428,530.78元，增加资本公积人民币3,935,316,063.98元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,083,246,756.77	3,935,316,063.98		5,018,562,820.75
其他资本公积	4,366,361,498.94	34,717,502.27	1,225,751.33	4,399,853,249.88
合计	5,449,608,255.71	3,970,033,566.25	1,225,751.33	9,418,416,070.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期增加3,935,316,063.98元，本公司公开发行336,943,049.00股人民币普通股（含超额配售），最终募集资金总额为4,312,871,027.20元，扣除本次发行费用人民币77,126,432.44元，最终募集资金净额为人民币4,235,744,594.76元，其中增加股本300,428,530.78元，增加资本公积3,935,316,063.98元；Great Team Backend Foundry, Inc对Great Team Backend Foundry, (HK) Limited债务豁免导致增加资本公积34,717,502.27元。本期减少1,225,751.33元，主要为职工安置住房补贴。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	369,284,876.09	-33,826,948.93				-33,115,728.73	-711,220.20	336,169,147.36
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	369,284,876.09	-33,826,948.93				-33,115,728.73	-711,220.20	336,169,147.36
其他综合收益合计	369,284,876.09	-33,826,948.93				-33,115,728.73	-711,220.20	336,169,147.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,225,485,934.52	-3,049,202,200.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,225,485,934.52	-3,049,202,200.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	963,661,634.37	400,755,536.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,125,531.44	77,740.00
转作股本的普通股股利		
其他（注）		-1,423,038,469.73
期末未分配利润	-301,949,831.59	-1,225,485,934.52

注：其他主要为资本公积弥补亏损。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,931,629,010.75	5,033,555,125.02	5,699,182,500.37	4,392,072,459.68
其他业务	45,630,177.28	27,058,028.03	43,601,630.33	39,222,205.75
合计	6,977,259,188.03	5,060,613,153.05	5,742,784,130.70	4,431,294,665.43

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	IC 设计分部	晶圆制造分部	封装测试分部	分立器件分部	配套及总部分部	合计
商品类型						
产品与方案	693,876,056.17			2,378,711,866.75	31,659,192.99	3,104,247,115.91
制造与服务		2,434,031,857.72	1,047,009,167.27		346,340,869.85	3,827,381,894.84
按经营地区分类						
中国大陆	650,979,207.27	2,312,916,124.52	520,735,952.98	2,184,128,200.11	59,216,963.21	5,727,976,448.09
其他国家和地区	42,896,848.90	121,115,733.20	526,273,214.29	194,583,666.64	318,783,099.63	1,203,652,562.66
市场或客户类型						
合同类型						
产品购销	693,876,056.17			2,378,711,866.75	31,659,192.99	3,104,247,115.91
劳务服务		2,434,031,857.72	1,047,009,167.27		346,340,869.85	3,827,381,894.84
按商品转让的时间分类						
按商品转让的时间分类						
在某一时刻确认收入	693,876,056.17	2,434,031,857.72	1,047,009,167.27	2,378,711,866.75	378,000,062.84	6,931,629,010.75
按合同期限分类						
一年以内	693,876,056.17	2,434,031,857.72	1,047,009,167.27	2,378,711,866.75	378,000,062.84	6,931,629,010.75
按销售渠道分类						
直销	278,248,526.66	2,434,031,857.72	1,047,009,167.27	1,072,211,853.97	377,611,999.97	5,209,113,405.59
经销	415,627,529.51			1,306,500,012.78	388,062.87	1,722,515,605.16
合计	693,876,056.17	2,434,031,857.72	1,047,009,167.27	2,378,711,866.75	378,000,062.84	6,931,629,010.75

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

- (1) 对于国内销售的产品，以产品发运并取得客户确认后作为控制权转移时点并确认销售收入；
 (2) 对于国外销售的产品，以产品发运并办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,668,169,700 元，其中：2,588,774,100 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	25,843,252.83	23,774,133.28
教育费附加	18,495,628.06	21,467,377.51
资源税		
房产税	13,386,253.98	10,976,206.08
土地使用税	5,689,969.68	6,015,176.46
车船使用税	28,298.04	26,443.04
印花税	5,011,219.36	3,625,129.13
环境保护税	288,162.71	279,935.54
合计	68,742,784.66	66,164,401.04

其他说明：无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,446,141.16	77,788,706.65
办公及租赁费	4,759,237.05	4,193,051.70
差旅费	4,076,450.37	6,629,192.50
专业服务费	2,894,840.56	575,626.58
业务招待费	2,475,104.07	3,738,951.80
物料消耗	2,276,646.91	2,007,105.54
折旧	1,147,342.99	547,202.12
业务宣传费	788,625.88	845,793.49
检验维修费	718,745.68	1,246,433.42
保险费	557,351.58	260,466.69
摊销	441,594.16	282,860.62
动力费用	197,897.01	189,732.81
其他	174,135.30	158,001.97
治安保卫费	2,616.15	
运输费		13,556,779.17
合计	105,956,728.87	112,019,905.06

其他说明：

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将与合同履行相关的运输费由原销售费用科目调整至主营业务成本科目核算。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	233,209,218.12	245,953,340.33
折旧	30,440,714.36	29,864,664.21
办公及租赁费	27,388,192.09	31,192,596.43
维修费	14,442,799.85	12,798,665.75
专业服务费	13,546,161.53	10,870,786.31
污废处置费	12,671,424.94	9,909,837.08
保险费	10,565,842.68	11,162,831.34
摊销	6,223,791.85	4,577,286.86
物料消耗	5,027,613.74	3,426,280.42
差旅费	3,940,614.87	6,029,533.30
动力费用	3,752,211.99	3,394,749.16
税金	3,630,482.21	3,925,427.42
业务宣传费	1,703,992.68	287,106.96
试验检验费	869,173.62	1,104,517.69
绿化费	678,864.60	828,406.99
运输费	678,091.35	435,779.85
业务招待费	667,508.99	938,308.59
其他	459,057.79	140,409.23
治安保卫费	26,529.68	

合计	369,922,286.94	376,840,527.92
----	----------------	----------------

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	286,591,106.14	239,221,599.04
物料消耗	134,237,312.02	83,688,963.67
折旧	50,865,788.15	55,811,733.72
专业服务费	39,473,567.99	37,364,051.05
摊销	24,209,363.77	23,602,610.36
试验检验费	9,806,142.42	17,937,767.66
维修费	7,038,760.85	9,338,910.52
知识产权费	7,004,293.19	7,515,018.74
差旅费	2,806,862.50	3,908,465.91
办公及租赁费	2,492,272.09	2,408,673.63
动力费用	724,431.55	1,022,545.41
其他	370,258.84	238,992.69
业务招待费	294,322.41	440,182.56
运输费	143,919.33	91,258.66
治安保卫费	15,523.11	
业务宣传费	4,049.30	24,951.46
合计	566,077,973.66	482,615,725.08

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	40,680,804.23	44,971,740.09
减：利息收入	-87,808,866.78	-37,761,310.18
汇兑损益	-77,536,182.70	20,076,630.34
手续费	4,734,371.36	3,707,449.64
其他	264.28	-169.10
合计	-119,929,609.61	30,994,340.79

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术改造补贴	16,951,003.88	

02 专项-IGBT	9,741,318.24	
研发稳增长及专利奖励补贴	8,495,000.00	
政府项目扶持资金	8,000,000.00	
稳岗补贴	5,307,040.24	2,702,817.30
华润微电子 650V 硅基氮化镓功率器件设计及工艺技术研究项目	5,119,425.74	14,880,574.26
氮化镓专项补贴	4,610,000.00	
8 英寸项目建设补贴	4,112,359.56	
与 CMOS 兼容的 MEMS 成套模块工艺与制造平台	3,942,060.64	51,539,478.65
基于 GaN 的 PD 电源控制芯片开发政府补助	3,774,748.33	
4500V 新型高压功率芯片工艺开发产业	3,708,452.68	3,818,281.72
外延基地和研发中心人才引进扶持金	3,000,000.00	3,000,000.00
集成电路成长企业税收排名奖励	2,500,000.00	
上市补贴	2,000,000.00	3,000,000.00
代工流片补贴	1,810,000.00	
专利资助	1,746,800.00	
外经贸发展专项补贴	1,718,536.00	
高企补贴	1,600,000.00	
地区总部发展专项资金（区级）	1,500,000.00	
深圳市工商业用电降成本资助	1,346,543.80	1,742,785.80
进口贴息	1,321,200.00	
高效率无线充与功率驱动技术的研发与产业化	1,305,496.33	1,539,775.85
智能功率集成电路及应用方案研发	1,238,647.66	
技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目	1,170,000.00	
集成电路产业重大专项奖励、展会补贴	1,144,900.00	
微纳掩模干法刻蚀技术研发及产业化应用	1,125,000.00	1,125,000.00
硅基高速光耦系列芯片关键技术研发	1,123,716.58	459,281.25
高可靠性音视频和控制用 MCU 研发与产业化	1,100,381.42	1,461,461.24
知识产权补助	1,031,200.00	
掩模微纳清洗技术研发及应用	1,000,000.00	1,000,000.33
销售规模奖励—集成电路龙头企业销售规模项目	1,000,000.00	
江苏省无线电力传输技术重点实验室	992,155.93	1,534,779.79
沸石转轮项目省级环保引导资	980,000.00	
就业补贴	881,854.00	
智能制造项目（车间建设类）补贴	873,000.00	
精密掩模检测技术产业化应用	812,500.00	812,500.00
新一代氮化镓功率器件与制造技	812,202.14	
复工复产专项补助金	800,000.00	
微纳掩模离子修复技术研发及产业化	750,000.00	750,000.00
代扣个税手续费返还	716,107.27	235,093.81
园区产业扶持金	700,000.00	3,000,000.00
深圳市龙岗区技术改造专项扶持项目	646,000.00	
光电子半导体器件项目	643,505.14	223,925.28
江苏省普惠金融发展专项资金	600,000.00	
技术改造倍增专项技术改造投资项目	580,000.00	
企业研究开发资助计划第二批资助	539,000.00	
深圳市科技创新委员会关于 2018 年第一批企业研究开发资助补贴	511,000.00	848,000.00
2019 年龙岗区研发资助	500,000.00	

无锡微纳(MEMS 子课题)	492,352.24	
收到 2019 年受影响企业失业保险费返还	430,689.29	
创新驱动发展专项资金	404,500.00	
高密度 3DQFN 先进封装技术研究及产业化	403,890.28	403,890.12
光伏发电电费补贴	390,926.83	
市物联网与云计算产业资金	387,500.00	
2019 年福田区支持科技创新发展项目-核心人才综合保险	383,000.00	
典型 MEMS 器件规模化封装技术	354,634.52	
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发(1100)	320,200.88	79,002.33
2019 科技创新补贴资金	313,200.00	
功率半导体基地项目(人才引进培训金)	300,000.00	300,000.00
MEMS 麦克风工艺平台开发及产业化项目	296,250.00	
测温仪核心传感器的规模制造	281,250.00	
02 专项-IGBT 测试技术与可靠性实验与封装应用技术研究	281,150.65	941,667.32
低成本多芯片混合封装技术研发	274,248.00	274,248.00
Flipchip 系列先进封装技术产业化	250,000.00	125,000.00
研发机构奖补	250,000.00	
2020 年职工适岗培训政府补贴	248,190.00	
2020 年重庆市第三批工业信息化专项补助资金(用于 CONTACT SI ETCH 多晶硅刻蚀机)	236,875.00	
硅基氮化镓功率器件制造及工艺研发	232,063.42	100,000.00
科技保险保费资助	232,000.00	
无锡市科技发展资金(技术研发)发展项目-新一代高压大功率超级 MOS 型器件的研制	229,166.67	
无线充电与功率驱动技术的研发与产业化	218,921.40	248,954.62
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发	218,667.57	
第二期保就业计划申请工资补贴	201,413.17	
红外光接收芯片示范项目	200,661.26	349,337.09
0.11 微米超低功耗工艺技术平台开发	200,000.00	200,000.00
增值税进项加计抵减	196,814.41	17,886.56
贷款贴息	170,084.13	
智慧健康医疗传感器技术与应用系统平台研究	169,107.28	6,708,308.12
国家集成电路产业研究与开发专项资金(单片智能)	163,640.00	
省科技支-新型 Trench-FS-IGBT	152,269.74	203,364.91
东莞市商务局财政补贴	148,000.00	
600V 高低压兼容工艺技术研发	147,769.64	
2015 物联网红外项目	136,250.00	
岗前培训补贴	125,100.00	
上海市大张江(静安园)项目	120,000.00	800,000.00
新一代功率半导体器件关键技术研发	118,363.64	
分裂栅工艺产品线专项资金	111,249.97	
其他零星项目	100,984.54	2,065,250.22
国外发明代理费政府补助	100,000.00	
国家级博士后工作站专项资金	100,000.00	
超低功耗微控制器的研发及产业化	94,987.77	128,098.08
政府返还流片验证费	90,332.42	
市政府污水处理费补贴	81,140.85	
市政府代缴基本电费-2 月	75,240.00	

2020 年 11 月招用自主就业退役士兵减免税	72,750.00	
2019 年企业新型学徒制预支补贴	71,400.00	
疫情防控期间企业吸纳外来务工人员补助	67,000.00	
重庆高新区单位社保补贴	52,925.00	
集成电路产业专项基金-MEMS 压力传感器芯片的研发及产业化	50,016.86	908,854.23
国际服务贸易专项资金	50,000.00	
2020 年防疫效果奖励	50,000.00	
新能源汽车电子用 6 吋 SiC 功率器件	46,875.00	
电源适配器的集成光耦和电压基准一体化芯片	43,750.48	19,412.90
省软件产业专项-高压 IGBT 功率器件的研发	38,550.01	154,200.00
02 专项-SOI 工艺平台先导产品设计与验证 2	37,238.40	39,867.85
高新区鸿雁计划引才补贴	30,500.00	
新吴区飞凤人才基金（组织人才专项）补贴	30,000.00	
第五批线上培训补贴	29,500.00	
香港政府保就业计划补贴	19,355.59	
新能源汽车推广应用补贴	16,560.00	16,560.00
江苏省 2018 年度 333 高层次人才培养工程资助 70%	15,000.00	35,000.00
防护用品支持项目	10,000.00	
2020 年 1-11 月重点人群（失业）税收优惠	7,150.00	
集成电路产业布图设计登记证书资质奖励	7,000.00	
无锡市滨湖生态环境局绿色金融奖补资金	7,000.00	
环境污染责任保险保费补贴	5,600.00	
2019 年度市级现代服务业提质增效资金奖励	5,000.00	
2019 外贸稳增长金	5,000.00	
2019 年进博会财政补贴	200.00	
园区扶贫资金		40,000,000.00
人工智能技术创新		24,000,000.00
PLP 基板级扇出封装项目		16,000,000.00
2018 年第二批重庆市工业和信息化项目专项资金		5,000,000.00
典型 MEMS 器件规模化封装技术		4,412,764.68
8 英寸项目建设补贴		4,111,419.06
传感电路设计服务平台		3,944,400.00
光耦成品测试生产线技术装备及管理智能化提升		3,730,000.00
集成电路与传感器集成制造与生产技术		3,654,479.52
省级企业重点实验室新建项目		3,000,000.00
政府开办费补助		2,000,000.00
2019 年市第九批科技发展计划项目拨款		1,960,000.00
先进功率器件（分栅结构）技术研发及产业化		1,500,000.00
集成式 HVLED 芯片研发及产业化		1,471,165.26
8 英寸晶圆线精密掩模制造技术研究		1,333,333.00
2018 年企业研发费用省级财政奖励		1,300,000.00
消费类 MCU 芯片关键技术及产品研发与产业化		1,297,600.00
0.13 微米 SOI 通用 CMOS 工艺开发产业化		1,264,113.06
2018 年引智项目政府补贴		1,100,000.00
新型节能驱动芯片生产工艺高价值专利培育(100029748)		1,000,000.00
2019 第二批工业信息化专项资金		620,000.00
新一代高效节能 MOS 型功率半导体芯片的研制		500,000.00
企业研究开发费用省级财政奖励		500,000.00

集成电路产业专项基金-节能照明用功率集成电路的研发		446,699.90
新型节能驱动汽车电子芯片工艺开发		416,149.05
沙区经信委研发补助金		230,000.00
区产业发展专项专利支持		200,000.00
2019年度无锡市第一批集成电路产业发展资金		200,000.00
2016外经委商务发展资金		180,450.50
展博会补贴		160,800.00
2019年度重点人才工程奖励补贴人才创业基金		100,000.00
上海市科技创新券		59,250.00
制造年会补贴		50,000.00
2019年度人才创业基金		30,000.00
中小企业开拓国际市场补助		20,000.00
2019年度重点人才工程奖励补贴		20,000.00
中小企业开拓国际市场补助 2018年越南电子展展会补贴		20,000.00
02专项(SOI项目)		9.61
深圳市龙岗区工业和信息化局关于公示2018年区经发资金技术改造专项扶持项目		2,981,000.00
2018年企业研究开发资助计划第二批资助		898,000.00
2019年新吴区专利资助		854,000.00
2019年市级科技发展资金		100,000.00
2019年科技保险保费资助		100,000.00
2019年市科技发展资金(保险项目)		100,000.00
专利资助费(2019第一批一般资助费)		68,403.00
2018年国家高新技术企业认定奖补		30,000.00
沙坪坝科委专利资助金		20,000.00
合计	127,082,612.49	238,776,694.27

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,212,908.93	-286,669.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,478,526.08	
理财产品收入	9,074,756.46	252,371.29
合计	27,766,191.47	-34,298.34

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,191,461.19	35,344.46
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,191,461.19	35,344.46

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	916,282.95	32,308,847.95
其他应收款坏账损失	67,773.73	-1,427,462.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	984,056.68	30,881,385.95

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,198,754.47	-31,280,151.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-8,442,120.98	-2,491,505.33
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-7,014,468.19	-2,802,228.51
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-11,257,834.70	-36,573,885.21

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	128,325.54	5,125,892.37
在建工程处置收益	-82,848.75	-3,304,290.85
合计	45,476.79	1,821,601.52

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
卖废品收入	2,283,260.52	2,217,760.20	2,283,260.52
罚款、违约金收入	943,735.35	696,413.94	943,735.35
房租补贴	6,503,845.43	7,086,279.36	6,503,845.43
减免及补贴	9,348.85	2,240,068.61	9,348.85
无需支付的款项	2,410,908.60		2,410,908.60
其他	3,894,971.59	20,450,858.76	3,894,971.59
合计	16,046,070.34	32,691,380.87	16,046,070.34

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	30,681.65		30,681.65
其中：固定资产处置损失	30,681.65		30,681.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,150,000.00	1,350,000.00	1,150,000.00
债务重组损失		11,067.29	
罚款支出	1,000.00		1,000.00
赔款支出	300,327.24	1,793,826.53	300,327.24
滞纳金	61,325.66	765,389.17	61,325.66
盘亏损失		201,168.97	
法院执行款	65,984.86		65,984.86
其他	472,438.42	378,533.00	472,438.42
合计	2,081,757.83	4,499,984.96	2,081,757.83

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,785,412.72	-3,223,081.09
递延所得税费用	-3,841,753.65	-3,250,663.35
合计	25,943,659.07	-6,473,744.44

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,085,652,146.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	150,788,910.48
调整以前期间所得税的影响	-278,806.71
非应税收入的影响	-2,787,533.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,877,348.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-113,499,415.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,817,690.97
子公司亏损无需纳税的影响	2,555.30
研发加计扣除	-47,254,181.55
其他（注）	3,277,090.97
所得税费用	25,943,659.07

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 57. 其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	94,023,661.30	31,546,515.66
政府补助	136,503,331.48	146,491,073.04
投标保证金、员工款项、赔偿款	56,425,491.08	66,803,898.94
代收政府补助	36,582,200.00	
合计	323,534,683.86	244,841,487.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	307,246,224.74	357,939,331.72
代付政府补助		47,496,200.00
合计	307,246,224.74	405,435,531.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款质押减少	75,519,027.00	47,456,790.00
资金集中管理划入款		1,821,541,573.97
结构性存款	1,300,000,000.00	1,700,000,000.00
理财产品	14,500,000.00	33,000,000.00
其他	1,697,737.32	2,145,059.80
合计	1,391,716,764.32	3,604,143,423.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款质押增加	28,168,708.83	53,192,465.57
资金集中管理划出款		651,552,053.40
结构性存款	1,700,000,000.00	2,200,000,000.00
理财产品	7,000,000.00	30,500,000.00
收购保证金		12,810,924.00
其他	904,370.84	4,338,414.83
合计	1,736,073,079.67	2,952,393,857.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	248,821,524.58	
不丧失控制权下出售子公司部分股权	20,538,632.17	
合计	269,360,156.75	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还借款		1,469,365,279.69
融资费用	11,405,618.83	35,186,983.93
支付回购少数股东股权款	13,499,683.29	
合计	24,905,302.12	1,504,552,263.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,059,708,487.82	512,426,548.38
加：资产减值准备	11,257,834.70	36,573,885.21

信用减值损失	-984,056.68	-30,881,385.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	677,721,574.67	662,361,639.02
使用权资产摊销		
无形资产摊销	36,131,228.02	30,273,685.16
长期待摊费用摊销	19,457,992.63	16,531,102.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-45,476.79	-1,821,601.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,681.65	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,191,461.19	-35,344.46
财务费用（收益以“-”号填列）	-32,120,742.83	68,755,650.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,766,191.47	34,298.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,207,512.28	1,715,220.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	365,758.63	-4,965,884.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,223,694.06	161,698,454.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-431,835,205.27	-608,926,990.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	599,760,609.82	-267,480,660.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,832,059,827.37	576,258,618.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,843,684,144.42	1,891,248,425.69
减：现金的期初余额	1,891,248,425.69	1,516,762,528.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,952,435,718.73	374,485,897.39

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,843,684,144.42	1,891,248,425.69
其中：库存现金	251,382.62	81,121.52
可随时用于支付的银行存款	6,843,430,661.80	1,891,165,204.17
可随时用于支付的其他货币资金	2,100.00	2,100.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,843,684,144.42	1,891,248,425.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,009,236.75	票据保证金、信用保证金、收购公司支付的保证金、充值卡
应收票据		
存货		
固定资产	104,621,327.23	固定资产抵押借款
无形资产		
合计	126,630,563.98	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	999,832,444.91
其中：美元	129,973,146.04	6.52490	848,061,780.60
欧元	124.50	8.025	999.11
港币	178,559,416.25	0.84164	150,282,747.09
台币	5,912,777.00	0.23211	1,372,414.67
新加坡元	23,082.30	4.9314	113,828.05
韩元	112,600.00	0.005997	675.26
日元	2.00	0.06324	0.13
应收账款	-	-	114,542,192.15
其中：美元	16,894,483.00	6.52490	110,234,812.13

欧元			
港币	5,117,841.38	0.84164	4,307,380.02
长期借款	-	-	1,415,017,623.06
其中：美元	10,473,735.12	6.5249	68,340,074.28
欧元			
港币	1,600,063,624.33	0.84164	1,346,677,548.78
应付账款			136,850,804.79
其中：美元	18,705,430.04	6.52490	122,051,060.47
港币	9,592,020.00	0.84164	8,073,027.71
日元	96,522,913.00	0.06324	6,104,109.02
欧元	77,583.50	8.02500	622,607.59
一年内到期的非流动负债			98,198,875.04
其中：美元	15,049,866.67	6.52490	98,198,875.04

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术改造补贴	16,951,003.88	其他收益	16,951,003.88
02 专项-IGBT	9,741,318.24	其他收益	9,741,318.24
研发稳增长及专利奖励补贴	8,495,000.00	其他收益	8,495,000.00
政府项目扶持资金	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
稳岗补贴	5,307,040.24	其他收益	5,307,040.24
华润微电子 650V 硅基氮化镓功率器件设计及工艺技术研究项目	5,119,425.74	其他收益	5,119,425.74
氮化镓专项补贴	4,610,000.00	其他收益	4,610,000.00
8 英寸项目建设补贴	4,112,359.56	其他收益	4,112,359.56
与 CMOS 兼容的 MEMS 成套模块工艺与制造平台	3,942,060.64	其他收益	3,942,060.64
基于 GaN 的 PD 电源控制芯片开发政府补助	3,774,748.33	其他收益	3,774,748.33
4500V 新型高压功率芯片工艺开发产业	3,708,452.68	其他收益	3,708,452.68
外延基地和研发中心人才引进扶持金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
集成电路成长企业税收排名奖励	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
上市补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
代工流片补贴	1,810,000.00	其他收益	1,810,000.00
专利资助	1,746,800.00	其他收益	1,746,800.00

外经贸发展专项补贴	1,718,536.00	其他收益	1,718,536.00
高企补贴	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
地区总部发展专项资金(区级)	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
深圳市工商业用电降成本资助	1,346,543.80	其他收益	1,346,543.80
进口贴息	1,321,200.00	其他收益	1,321,200.00
高效率无线充与功率驱动技术的研发与产业化	1,305,496.33	其他收益	1,305,496.33
智能功率集成电路及应用方案研发	1,238,647.66	其他收益	1,238,647.66
技改倍增专项技术装备及管理智能化提升项目	1,170,000.00	其他收益	1,170,000.00
集成电路产业重大专项奖励、展会补贴	1,144,900.00	其他收益	1,144,900.00
微纳掩模干法刻蚀技术研发及产业化应用	1,125,000.00	其他收益	1,125,000.00
硅基高速光耦系列芯片关键技术研发	1,123,716.58	其他收益	1,123,716.58
高可靠性音视频和控制用 MCU 研发与产业化	1,100,381.42	其他收益	1,100,381.42
知识产权补助	1,031,200.00	其他收益	1,031,200.00
掩模微纳清洗技术研发及应用	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
销售规模奖励—集成电路龙头企业销售规模项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
江苏省无线电力传输技术重点实验室	992,155.93	其他收益	992,155.93
沸石转轮项目省级环保引导资	980,000.00	其他收益	980,000.00
就业补贴	881,854.00	其他收益	881,854.00
智能制造项目(车间建设类)补贴	873,000.00	其他收益	873,000.00
精密掩模检测技术产业化应用	812,500.00	其他收益	812,500.00
新一代氮化镓功率器件与制造技	812,202.14	其他收益	812,202.14
复工复产专项补助金	800,000.00	其他收益	800,000.00
微纳掩模离子修复技术研发及产业化	750,000.00	其他收益	750,000.00
代扣个税手续费返还	716,107.27	其他收益	716,107.27
园区产业扶持金	700,000.00	其他收益	700,000.00
深圳市龙岗区技术改造专项扶持项目	646,000.00	其他收益	646,000.00
光电子半导体器件项目	643,505.14	其他收益	643,505.14
江苏省普惠金融发展专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
技术改造倍增专项技术改造投资项目	580,000.00	其他收益	580,000.00
企业研究开发资助计划第二批资助	539,000.00	其他收益	539,000.00
深圳市科技创新委员会关于 2018 年第一批企业研究开发资助补贴	511,000.00	其他收益	511,000.00
2019 年龙岗区研发资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
无锡微纳(MEMS 子课题)	492,352.24	其他收益	492,352.24
收到 2019 年受影响企业失业保险费返还	430,689.29	其他收益	430,689.29
创新驱动发展专项资金	404,500.00	其他收益	404,500.00
高密度 3DQFN 先进封装技术研究及产业化	403,890.28	其他收益	403,890.28
光伏发电电费补贴	390,926.83	其他收益	390,926.83
市物联网与云计算产业资金	387,500.00	其他收益	387,500.00
2019 年福田区支持科技创新发展项目-核心人才综合保险	383,000.00	其他收益	383,000.00
典型 MEMS 器件规模化封装技术	354,634.52	其他收益	354,634.52
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发(1100)	320,200.88	其他收益	320,200.88
2019 科技创新补贴资金	313,200.00	其他收益	313,200.00
功率半导体基地项目(人才引进培训金)	300,000.00	其他收益	300,000.00

MEMS 麦克风工艺平台开发及产业化项目	296,250.00	其他收益	296,250.00
测温仪核心传感器的规模制造	281,250.00	其他收益	281,250.00
02 专项-IGBT 测试技术与可靠性实验与封装应用技术研究	281,150.65	其他收益	281,150.65
低成本多芯片混合封装技术研发	274,248.00	其他收益	274,248.00
Flipchip 系列先进封装技术产业化	250,000.00	其他收益	250,000.00
研发机构奖补	250,000.00	其他收益	250,000.00
2020 年职工适岗培训政府补贴	248,190.00	其他收益	248,190.00
2020 年重庆市第三批工业信息化专项补助资金（用于 CONTACT SI ETCH 多晶硅刻蚀机）	236,875.00	其他收益	236,875.00
硅基氮化镓功率器件制造及工艺研发	232,063.42	其他收益	232,063.42
科技保险保费资助	232,000.00	其他收益	232,000.00
无锡市科技发展资金（技术研发）发展项目-新一代高压大功率超级 MOS 型器件的研制	229,166.67	其他收益	229,166.67
无线充电与功率驱动技术的研发与产业化	218,921.40	其他收益	218,921.40
硅表面加工与体加工工艺物理模型建模和仿真系统开发	218,667.57	其他收益	218,667.57
第二期保就业计划申请工资补贴	201,413.17	其他收益	201,413.17
红外光接收芯片示范项目	200,661.26	其他收益	200,661.26
0.11 微米超低功耗工艺技术平台开发	200,000.00	其他收益	200,000.00
增值税进项加计抵减	196,814.41	其他收益	196,814.41
贷款贴息	170,084.13	其他收益	170,084.13
智慧健康医疗传感器技术与应用系统平台研究	169,107.28	其他收益	169,107.28
国家集成电路产业研究与开发专项资金（单片智能）	163,640.00	其他收益	163,640.00
省科技支-新型 Trench-FS-IGBT	152,269.74	其他收益	152,269.74
东莞市商务局财政补贴	148,000.00	其他收益	148,000.00
600V 高低压兼容工艺技术研发	147,769.64	其他收益	147,769.64
2015 物联网红外项目	136,250.00	其他收益	136,250.00
岗前培训补贴	125,100.00	其他收益	125,100.00
上海市大张江（静安园）项目	120,000.00	其他收益	120,000.00
新一代功率半导体器件关键技术研发	118,363.64	其他收益	118,363.64
分裂栅工艺产品线专项资金	111,249.97	其他收益	111,249.97
其他零星项目	100,984.54	其他收益	100,984.54
国外发明代理费政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家级博士后工作站专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
超低功耗微控制器的研发及产业化	94,987.77	其他收益	94,987.77
政府返还流片验证费	90,332.42	其他收益	90,332.42
市政府污水处理费补贴	81,140.85	其他收益	81,140.85
市政府代缴基本电费-2 月	75,240.00	其他收益	75,240.00
2020 年 11 月招用自主就业退役士兵减免税	72,750.00	其他收益	72,750.00
2019 年企业新型学徒制预支补贴	71,400.00	其他收益	71,400.00
疫情防控期间企业吸纳外来务工人员补助	67,000.00	其他收益	67,000.00
重庆高新区单位社保补贴	52,925.00	其他收益	52,925.00
集成电路产业专项基金-MEMS 压力传感器芯片的研发及产业化	50,016.86	其他收益	50,016.86
国际服务贸易专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年防疫效果奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

新能源汽车电子用 6 吋 SiC 功率器件	46,875.00	其他收益	46,875.00
电源适配器的集成光耦和电压基准一体化芯片	43,750.48	其他收益	43,750.48
省软件产业专项-高压 IGBT 功率器件的研发	38,550.01	其他收益	38,550.01
02 专项-S01 工艺平台先导产品设计与验证 2	37,238.40	其他收益	37,238.40
高新区鸿雁计划引才补贴	30,500.00	其他收益	30,500.00
新吴区飞凤人才基金（组织人才专项）补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
第五批线上培训补贴	29,500.00	其他收益	29,500.00
香港政府保就业计划补贴	19,355.59	其他收益	19,355.59
新能源汽车推广应用补贴	16,560.00	其他收益	16,560.00
江苏省 2018 年度 333 高层次人才培养工程资助 70%	15,000.00	其他收益	15,000.00
防护用品支持项目	10,000.00	其他收益	10,000.00
2020 年 1-11 月重点人群（失业）税收优惠	7,150.00	其他收益	7,150.00
集成电路产业布图设计登记证书资质奖励	7,000.00	其他收益	7,000.00
无锡市滨湖生态环境局绿色金融奖补资金	7,000.00	其他收益	7,000.00
环境污染责任保险保费补贴	5,600.00	其他收益	5,600.00
2019 年度市级现代服务业提质增效资金奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
2019 外贸稳增长金	5,000.00	其他收益	5,000.00
2019 年进博会财政补贴	200.00	其他收益	200.00
合计	127,082,612.49		127,082,612.49

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杰群电子科技（东莞）有限公司	2020 年 9 月 30 日	279,777,395.16	70	收购	2020 年 9 月 30 日	取得控制权	168,213,760.81	6,730,380.82

其他说明：无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	杰群电子科技（东莞）有限公司
--现金	279,777,395.16
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	279,777,395.16
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	278,157,340.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,620,054.59

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	杰群电子科技（东莞）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,483,831,078.21	1,400,172,185.52
货币资金	61,703,922.75	61,703,922.75
应收款项	913,194,292.34	913,194,292.34
存货	128,409,910.35	127,320,718.60
其他流动资产	3,781,803.10	3,781,803.10
固定资产	267,497,605.85	198,965,537.61
在建工程	67,080,050.69	68,406,205.97
无形资产	13,981,435.85	
长期待摊费用	28,182,057.28	26,799,705.15
负债：	1,086,463,448.83	1,073,735,135.34
借款		
应付款项	1,058,819,846.07	1,058,618,270.38
应付职工薪酬	12,426,955.66	12,426,955.66
应交税费	2,689,909.30	2,689,909.30
递延所得税负债	12,526,737.80	
净资产	397,367,629.38	326,437,050.18
减：少数股东权益	119,210,288.81	97,931,115.05
取得的净资产	278,157,340.57	228,505,935.13

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司依据经评估的被购买方于评估基准日的资产、负债的评估价值，作为购买日可辨认资产、负债的公允价值，各项可辨认资产负债的计税基础与入账价值之间的差异确认为递延所得税负债。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
杰群电子科技（东莞）有限公司	135,984,502.43	143,463,028.51	7,478,526.08	资产基础法	

其他说明：无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司全资子公司华润微集成电路（无锡）有限公司已于 2020 年 10 月 15 日召开董事会和股东会同意吸收合并全资子公司华润矽威科技（上海）有限公司和全资子公司华润半导体（深圳）有限公司，吸收合并日为 2020 年 11 月 30 日，吸收合并后，华润微集成电路（无锡）有限公司继续存续。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
无锡华润上华科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		100.00	收购
华润微集成电路(无锡)有限公司	江苏无锡	江苏无锡	设计		100.00	收购
华润微电子(重庆)有限公司	重庆	重庆	制造		52.69	划转
无锡华润安盛科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		100.00	收购
华润赛美科微电子(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	制造		100.00	收购
无锡华润华晶微电子有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		99.662	收购
华润微电子控股有限公司	上海	上海	投资管理		100.00	设立
无锡华润微电子有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		100.00	收购
重庆润芯微电子有限公司	重庆	重庆	投资管理		50.90	设立
矽磐微电子(重庆)有限公司	重庆	重庆	制造		38.72	设立
无锡迪思微电子有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造		100.00	设立
华润矽威科技(上海)有限公司	上海	上海	设计		100.00	收购
无锡华润芯功率半导体设计有限公司	江苏无锡	江苏无锡	设计		100.00	收购
华润半导体(深圳)有限公司	深圳	深圳	设计		100.00	收购
无锡华晶综合服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	服务		100.00	收购
润科投资管理(上海)有限公司	上海	上海	投资管理		51.00	设立
InPower Semiconductor Company Limited	中国香港	中国香港	投资股控		100.00	收购
CSMC Asia Limited	中国香港	中国香港	贸易平台	100.00		收购
CSMC Manufacturing Co. Ltd	中国香港	英属维京群岛	贸易平台	100.00		收购
China Resources Semiconductor International Limited	中国香港	中国香港	贸易平台		100.00	收购
China Resources Microelectronics (HongKong) Limited	中国香港	中国香港	贸易平台		100.00	收购
Wuxi China Resources Microelectronics (Holdings) Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100.00		收购
CRC Microelectronics Company Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100.00		收购

Well-Known Property Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100.00		收购
Firststar Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100.00		收购
Semico Microelectronics (BVI) Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100.00	收购
Well-Known (Hong Kong) Property Limited	中国香港	中国香港	投资股控		100.00	收购
DIS Microelectronics (HongKong) Limited	中国香港	中国香港	投资股控		100.00	收购
Bold Team Management Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100.00		收购
Advanced Microelectronics Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控	100.00		收购
Qualibest Enterprises Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100.00	收购
Huajing Microelectronics Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100.00	收购
Logic Semiconductor Manufacturing Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100.00	收购
Micro Assembly Technologies Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100.00	收购
Advanced Semiconductor Limited	英属维京群岛	英属维京群岛	投资股控		100.00	收购
杰群电子科技（东莞）有限公司	广东东莞	广东东莞	制造业		70.00	收购
杰铨电子（东莞）有限公司	广东东莞	广东东莞	服务业		70.00	收购
Great Team Backend Foundry, (HK) Limited	中国香港	中国香港	贸易平台		70.00	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华润微电子（重庆）有限公司	47.31%	120,390,166.30		972,456,698.88
杰群电子科技（东莞）有限公司	30.00%	2,019,114.25		135,397,112.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆华微	1,498,427,914.52	1,172,964,164.96	2,671,392,079.48	574,170,412.21	41,722,409.43	615,892,821.64	1,070,159,388.90	1,185,196,130.80	2,255,355,519.70	440,920,024.09	13,407,102.92	454,327,127.01
杰群电子	333,384,348.53	377,797,434.16	711,181,782.69	245,284,260.65	14,573,814.04	259,858,074.69						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆华微	1,390,102,615.86	254,470,865.15	254,470,865.15	471,142,822.68	1,073,182,660.21	244,634,571.15	244,634,571.15	148,858,423.42
杰群电子	617,677,536.98	31,054,051.73	31,054,051.73	140,048,100.40				

其他说明：无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海	上海	投资基金		27.4248	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	
流动资产	110,044,942.41		297,985,468.71	
非流动资产	600,262,123.98			

资产合计	710,307,066.39	297,985,468.71
流动负债	105,347,758.17	30,764.00
非流动负债		
负债合计	105,347,758.17	30,764.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	165,908,880.36	81,713,481.86
调整事项	24,599,696.51	-151.49
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	24,599,696.51	-151.49
对联营企业权益投资的账面价值	190,508,576.87	81,713,330.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	8,004,603.51	-1,045,295.29
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,004,603.51	-1,045,295.29
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险性及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	6,865,693,381.17			6,865,693,381.17
交易性金融资产		901,191,461.19		901,191,461.19
应收票据	303,832,938.04			303,832,938.04
应收款项融资			525,446,921.08	525,446,921.08
应收账款	966,048,018.34			966,048,018.34
其他应收款	12,390,836.36			12,390,836.36
其他流动资产	18,850,280.91			18,850,280.91

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,930,674,620.44			1,930,674,620.44
交易性金融资产		507,535,344.46		507,535,344.46
应收票据	190,955,453.14			190,955,453.14
应收款项融资			484,906,398.42	484,906,398.42

应收账款	815,007,869.96		815,007,869.96
其他应收款	12,957,740.46		12,957,740.46
其他流动资产	43,806,238.01		43,806,238.01

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		6,006,416.66	6,006,416.66
交易性金融负债			
应付票据		74,896,015.65	74,896,015.65
应付账款		1,052,826,675.67	1,052,826,675.67
其他应付款		943,310,435.86	943,310,435.86
长期借款		1,442,242,704.86	1,442,242,704.86

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		99,818,520.32	99,818,520.32
应付账款		748,638,825.07	748,638,825.07
其他应付款		535,826,262.58	535,826,262.58
长期借款		1,506,112,961.12	1,506,112,961.12

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

（三）流动性风险

管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关，本公司综合运用多种融资手段、金融工具以减少浮动利率对公司的影响，有效地控制了利率风险。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注(七、82)、外币货币性项目说明。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。本公司报告期末持有交易性权益工具投资和可供出售权益工具，因此不存在权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		901,191,461.19		901,191,461.19
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		901,191,461.19		901,191,461.19
(1) 债务工具投资		901,191,461.19		901,191,461.19
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				

1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			525,446,921.08	525,446,921.08
持续以公允价值计量的资产总额		901,191,461.19	525,446,921.08	1,426,638,382.27
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。公司计入交易性金融资产核算的为银行理财产品，该类项目风险低，到期收回金额包括本金以及按协议约定的预期收益；该类项目公允价值以协议所确定的产品预计收益率最佳估计数作为估值技术的重要参数。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
华润集团（微电子）有限公司	英属维尔京群岛	控股公司	1,597,228,020.80	72.29	72.29

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是中国华润有限公司

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

详见本节九、3、在合营企业或者联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
PEPINNOVATIONPTE.LTD	公司子公司矽磐微电子(重庆)有限公司的股东
江苏新科电子集团有限公司	公司子公司无锡华润华晶微电子有限公司的股东
北京华润大厦有限公司	同一最终控制方
北京华润曙光房地产开发有限公司	同一最终控制方
成都优高雅建筑装饰有限公司	同一最终控制方
广东润联信息技术有限公司	同一最终控制方

华润（保定）白洋淀管理培训学院	同一最终控制方
华润（集团）有限公司	同一最终控制方
华润（深圳）有限公司罗湖木棉花酒店	同一最终控制方
华润股份有限公司	同一最终控制方
华润秘书服务有限公司	同一最终控制方
华润水泥投资有限公司	同一最终控制方
华润万家生活超市（浙江）有限公司	同一最终控制方
华润万家有限公司	同一最终控制方
华润网络（深圳）有限公司	同一最终控制方
华润怡宝饮料（成都）有限公司	同一最终控制方
华润怡宝饮料（肇庆）有限公司	同一最终控制方
华润知识产权管理有限公司	同一最终控制方
深圳华润资本股权投资有限公司	同一最终控制方
华润置地（成都）物业服务有限公司	同一最终控制方
华润置地（贵阳）有限公司	同一最终控制方
华润置地（上海）物业管理有限公司	同一最终控制方
润联软件系统（深圳）有限公司	同一最终控制方
深圳市润薇服饰有限公司	同一最终控制方
圣马可（珠海）实业有限公司	同一最终控制方
苏果超市有限公司	同一最终控制方
特易购乐购(中国)投资有限公司	同一最终控制方
特易购商业（浙江）有限公司	同一最终控制方
无锡华润燃气有限公司	同一最终控制方
无锡华润万家生活超市有限公司	同一最终控制方
无锡木棉花酒店有限公司	同一最终控制方
徐州米兰花酒店管理有限公司	同一最终控制方
中国华润有限公司	同一最终控制方
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	公司子公司华润微电子(重庆)有限公司的股东
华润保险顾问有限公司	同一最终控制方
珠海华润银行股份有限公司	同一最终控制方

华润知识产权有限公司	同一最终控制方
华润（保定）白洋淀管理培训学院服务有限公司	同一最终控制方
华润置地（成都）发展有限公司	同一最终控制方
华润电力（福建）销售有限公司	同一最终控制方
上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司	同一最终控制方
润联国际网络有限公司	同一最终控制方
华润置地（重庆）有限公司	同一最终控制方
华润(南京)市政设计有限公司	同一最终控制方
润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明：无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华润知识产权管理有限公司	采购商品	18,867.92	
华润知识产权有限公司	采购商品	89,970.80	
深圳市润薇服饰有限公司	采购商品	1,199,724.31	80,379.29
圣马可（珠海）实业有限公司	采购商品	466,251.33	6,617.36
无锡华润燃气有限公司	采购商品	81,065.71	26,210.35
中国华润有限公司	采购商品	287,483.48	
PEPINNOVATIONPTE. LTD	接受劳务	136,202.00	2,525,062.50
广东润联信息技术有限公司	接受劳务	2,160,070.43	1,348,488.83
华润（保定）白洋淀管理培训学院服务有限公司	接受劳务	4,593.38	
华润（集团）有限公司	接受劳务	160,246.50	
华润保险顾问有限公司	接受劳务	171,940.05	50,089.60
华润秘书服务有限公司	接受劳务	610,084.09	123,019.66
华润网络（深圳）有限公司	接受劳务	743.36	72,650.02

华润知识产权管理有限公司	接受劳务	188,679.20	333,908.64
华润知识产权有限公司	接受劳务	17,778.25	
华润置地（成都）物业服务有限公司	接受劳务	2,678,787.81	2,334,407.55
润联软件系统（深圳）有限公司	接受劳务	4,475,043.69	2,590,130.28
无锡木棉花酒店有限公司	接受劳务	64,420.38	63,495.61
中国华润有限公司	接受劳务	39,270.36	
华润万家有限公司	采购商品		115,091.20
北京华润曙光房地产开发有限公司	接受劳务		1,641.59
华润（保定）白洋淀管理培训学院	接受劳务		54,484.52
北京华润大厦有限公司	接受劳务		4,926.29
华润（深圳）有限公司罗湖木棉花酒店	接受劳务		27,433.26
珠海华润银行股份有限公司	其他-银行手续费	20,026.65	22,994.14

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供劳务	5,750,743.31	
华润水泥投资有限公司	提供劳务	415,094.34	
润联国际网络有限公司	提供劳务	97,780.39	
润联软件系统（深圳）有限公司	提供劳务	87,735.85	
华润保险顾问有限公司	提供劳务	1,291.50	
华润置地（贵阳）有限公司	销售商品	4,985,324.13	1,844,173.18
华润置地（重庆）有限公司	销售商品	1,608,374.57	
华润置地（成都）发展有限公司	销售商品	1,439,367.60	
无锡木棉花酒店有限公司	销售商品	1,009,810.66	1,423,741.96
PEP INNOVATION PTE.LTD	销售商品	263,282.31	
成都优高雅建筑装饰有限公司	销售商品	265,794.00	648,598.97
华润电力（福建）销售有限公司	销售商品	13,716.81	
上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司	销售商品	9,520.64	

无锡华润万家生活超市有限公司	销售商品	32,610.62	44,373.71
华润水泥投资有限公司	销售商品		2,490,566.04
华润怡宝饮料（成都）有限公司	销售商品		1,082,297.00
华润置地（成都）物业服务有限公司	销售商品		287,655.69
华润万家生活超市（浙江）有限公司	销售商品		159,588.83
特易购乐购（中国）投资有限公司	销售商品		95,764.69
华润怡宝饮料（肇庆）有限公司	销售商品		35,560.55
华润置地（上海）物业管理有限公司	销售商品		25,443.00
华润网络（深圳）有限公司	销售商品		7,064.83
徐州米兰花酒店管理有限公司	销售商品		4,810.77
特易购商业（浙江）有限公司	销售商品		2,300.88
华润万家有限公司	销售商品		-130,327.47
苏果超市有限公司	销售商品		-141,063.16
珠海华润银行股份有限公司	其他-利息收入	12,156,804.58	3,429,754.68
华润股份有限公司	其他-利息收入		3,025,858.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：采购商品/接受劳务情况表中公司与 PEPINNOVATION.LTD 的交易情况

2020 年度，矽磐微电子向 PEPINNOVATION.LTD 支付的服务费金额为 13.62 万元，2019 年度，矽磐微电子向 PEPINNOVATION.LTD 支付的服务费金额为 252.51 万元，2018 年度，矽磐微电子向 PEPINNOVATION.LTD 支付的服务费金额为 257.37 万元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无锡木棉花酒店有限公司	房产	551,666.64	551,666.64
无锡华润万家生活超市有限公司	房产	16,457.14	
合计		568,123.78	551,666.64

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	房产	1,367,454.00	1,584,708.40
合计		1,367,454.00	1,584,708.40

关联租赁情况说明

适用 不适用

无

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

无

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,038.66	2,303.50

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司在珠海华润银行股份有限公司的存款余额为人民币 951,324,637.55 元,2020 年度累计确认利息收入 12,156,804.58 元,2020 年度累计确认手续费 20,026.65 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华润置地（贵阳）有限公司	2,640,081.43		764,689.18	
应收账款	华润水泥投资有限公司	440,000.00		1,320,000.00	
应收账款	成都优高雅建筑装饰有限公司	422,433.93	85,087.18	373,433.43	114,234.72
应收账款	华润置地（成都）发展有限公司	336,774.32			
应收账款	无锡木棉花酒店有限公司	154,876.04		130,082.85	
应收账款	华润置地(重庆)有限公司	54,523.90			
应收账款	华润置地（成都）物业服务有限公司	44,961.15	22,480.58	66,888.39	11,478.81

应收账款	无锡华润万家生活超市有限公司	31,655.00	1,582.75		
应收账款	华润电力（福建）销售有限公司	15,500.00			
应收账款	上海华润帕瑟菲克餐饮管理有限公司	2,976.00			
应收账款	华润置地（上海）物业管理有限公司	433.85	216.93	433.85	
应收账款	华润怡宝饮料（成都）有限公司			856,096.93	
应收账款	苏果超市有限公司			20,000.00	20,000.00
应收利息	珠海华润银行股份有限公司			6,214,794.52	
其他应收款	无锡华润万家生活超市有限公司			32,129.00	1,606.45
其他应收款	重庆西永微电子产业园区开发有限公司	816,996.30	494,655.99	816,996.30	63,791.84
预付款项	无锡华润燃气有限公司	599,470.00		12,800.00	
预付款项	华润（南京）市政设计有限公司	17,300.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	润联软件系统（深圳）有限公司	1,636,386.62	2,089,020.98
应付账款	广东润联信息技术有限公司	754,514.43	525,518.24
应付账款	圣马可（珠海）实业有限公司	281,428.00	
应付账款	华润置地（成都）物业服务服务有限公司	573,726.83	418,205.90
应付账款	中国华润有限公司	25,306.12	290,987.82
应付账款	华润秘书服务有限公司	47,636.82	
应付账款	深圳市润薇服饰有限公司		90,828.60
应付股利	江苏新科电子集团有限公司	578,258.43	578,258.43
其他应付款	华润股份有限公司	200,000,000.00	
其他应付款	中国华润有限公司	75,918.36	
其他应付款	深圳华润资本股权投资有限公司	14,806.00	14,806.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	向特定对象发行 A 股股票 1,320,091,861 股，每股 48 元人民币 股本增加：87,562,499.44 元； 资本公积增加 4,900,311,700.45 元； 银行存款增加 4,987,874,199.89 元		
重要的对外投资	收购重庆西永微电子产业园区开发有限公司所持有的华润微电子重庆公司的 47.31% 的股份 银行存款减少：1,444,091,953.92 元； 少数股东权益减少：989,471,339.71 元； 资本公积减少：454,620,614.21 元		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过了《关于拟收购华润微电子（重庆）有限公司股权的议案》，公司全资子公司华润微电子控股有限公司与重庆西永微电子产业园区开发有限公司签订《产权交易合同》。截至本财务报表批准对外报出日，华微控股以 144,409.195392 万元人民币收购重庆西永

所持有的华润微电子（重庆）有限公司 94,100.0012 万元人民币股权，收购资金来源于公司首次公开发行股票的超额募集资金和行使超额配售选择权对应的募集资金及自有资金。本次交易完成后，重庆华微成为公司全资子公司。

2、公司向特定对象发行 A 股股票的申请已于 2021 年 2 月 4 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，2021 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕843 号）。截至本财务报表批准对外报出日，本次向特定对象发行 A 股股票已实施完毕。公司已收到本次发行所募集资金净额人民币 4,987,874,199.89 元，其中增加股本人民币 87,562,499.44 元，增加资本公积人民币 4,900,311,700.45 元。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	97,330,372.91
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7373 元（含税），预计派发现金红利总额为 97,330,372.91 元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.10%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2020 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	IC 设计分部	圆晶代工分部
----	---------	--------

	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	693,876,056.17	591,350,922.21	2,434,031,857.72	2,251,931,507.03
二、分部间交易收入	34,596,086.63	5,749,972.21	1,085,942,876.29	715,188,660.15
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	-5,520,240.40	-7,152,418.27	-1,685,362.17	12,630,400.73
五、信用减值损失	-512,700.50	2,586,208.89	859,088.89	810,097.00
六、折旧费和摊销费	8,418,693.42	10,263,959.44	296,890,722.62	313,432,733.78
七、利润总额（亏损总额）	15,921,454.91	9,070,894.06	551,792,697.12	318,805,650.28
八、所得税费用		2,545,217.90	1,206,248.50	-1,138,843.65
九、净利润（净亏损）	15,921,454.91	6,525,676.16	550,586,448.62	319,944,493.93
十、资产总额	553,185,056.77	809,166,381.92	6,405,802,809.41	6,438,351,168.25
十一、负债总额	291,215,811.62	413,468,462.87	3,103,398,585.92	5,225,801,056.39
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	4,677,194.18	4,097,023.03	432,919,156.38	291,304,384.33

续上表

项目	封装测试分部		分立器件分部	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	1,047,009,167.27	808,986,407.78	2,378,711,866.75	1,924,311,139.32
二、分部间交易收入	97,664,744.94	56,740,326.58	24,335,675.25	4,665,564.20
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损失	-9,033,388.46	-628,468.02	4,981,156.33	-40,869,314.00
五、信用减值损失	1,976,515.08	668,826.36	350,918.71	26,663,379.61
六、折旧费和摊销费	160,304,240.21	127,707,315.23	213,317,268.83	192,349,888.02
七、利润总额（亏损总额）	47,220,122.79	33,381,131.94	320,821,463.82	238,072,152.34
八、所得税费用	3,651,850.30	-4,395,248.94	666,564.45	-1,183,976.32
九、净利润（净亏损）	43,568,272.49	37,776,380.88	320,154,899.37	239,256,128.66
十、资产总额	2,154,033,857.84	1,709,851,893.99	3,633,860,598.48	3,302,549,447.90

十一、负债总额	881,078,871.42	559,737,969.88	993,058,684.14	773,485,888.08
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,190,858,421.64	219,977,374.35	318,597,945.59	141,138,828.29

续上表

项目	配套支持分部		抵消	
	本期	上期	本期	上期
一、对外交易收入	378,000,062.84	122,602,524.03		
二、分部间交易收入	1,271,940,084.85	736,472,951.38	-2,514,479,467.96	-1,518,817,474.52
三、对联营和合营企业的投资收益	11,212,908.93	-286,669.63		
四、资产减值损失		-554,085.65		
五、信用减值损失	-1,689,765.50	152,874.09		
六、折旧费和摊销费	52,713,923.50	65,506,703.38	1,665,946.74	
七、利润总额（亏损总额）	-187,748,799.86	437,049,887.91	337,645,208.11	-530,426,912.59
八、所得税费用	20,410,081.73	-2,300,893.43	8,914.09	
九、净利润（净亏损）	-208,158,881.59	439,350,781.34	337,636,294.02	-530,426,912.59
十、资产总额	23,952,326,187.60	16,207,797,251.52	-20,166,712,743.13	-18,372,428,493.24
十一、负债总额	8,167,464,074.57	6,443,566,980.81	-8,704,483,829.05	-9,711,594,692.03
十二、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	190,508,576.87	81,713,330.37		
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	50,056,415.30	61,339,971.58	1,522,679.24	2,007,668.61

续上表

项目	合计	
	本期	上期
一、对外交易收入	6,931,629,010.75	5,699,182,500.37
二、分部间交易收入		

三、对联营和合营企业的投资收益	11,212,908.93	-286,669.63
四、资产减值损失	-11,257,834.70	-36,573,885.21
五、信用减值损失	984,056.68	30,881,385.95
六、折旧费和摊销费	733,310,795.32	709,260,599.85
七、利润总额（亏损总额）	1,085,652,146.89	505,952,803.94
八、所得税费用	25,943,659.07	-6,473,744.44
九、净利润（净亏损）	1,059,708,487.82	512,426,548.38
十、资产总额	16,532,495,766.97	10,095,287,650.34
十一、负债总额	4,731,732,198.62	3,704,465,666.00
十二、其他重要的非现金项目		
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用		
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	190,508,576.87	81,713,330.37
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,998,631,812.33	719,865,250.19

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

其他

适用 不适用

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,476.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	127,082,612.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,478,526.08	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,266,217.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,112.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,964,312.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-28,636,483.11	

少数股东权益影响额	-19,688,887.47
合计	110,513,886.94

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.3388	0.8362	0.8362
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.1531	0.7403	0.7403

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：陈小军

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用